

UCC25661x 系列 针对轻负载效率进行优化的 750kHz 宽 V_{IN}/V_{OUT} 范围 LLC 控制器

1 特性

- 满载开关频率：50kHz 至 750kHz
- 适用于宽 LLC 的输入功率比例控制 (IPPC)
- 增强型轻载管理 (优化待机功耗与可闻噪声)：
 - 高频及可闻频率脉冲跳频
 - 低频突发模式 (除 UCC256616 之外的所有器件)
 - 集成式 PFC 开/关功能 (UCC256614)UCC256614
 - 突发模式软进入与软退出 (UCC256610)
- 内部谐振电容器电压合成器保障信号可靠性和高频启动
- 零电流开关 (ZCS) 规避, 可消除容性区运行
- 自适应软启动, 可大幅降低浪涌电流, 并消除启动时的反向恢复
- 集成式栅极驱动器: +0.6/-1.2A
- 集成高电压启动 (UCC25661x 系列, UCC256613 除外)
- X 电容器放电 (UCC256610、UCC256611、UCC256614)
- 扩展增益范围 (UCC256610 和 UCC256614)
- 50ns 过流保护 (OCP), 逐周期电流限制
- 过压保护 (OVP)、OVP 锁存器 (UCC256611、UCC256616)
- 内部和外部 OTP
- 具有内部 19V VCCP 钳位的输入和 VCCP UVLO
- 独立配置的 OCP 和过载保护 (OLP/OPP) (UCC25661x 系列, UCC256616 除外)
- SOIC-14 封装, 移除了用于高压间隙的引脚

2 应用

- 电视 SMPS 电源
- 工业交流/直流适配器
- 电动工具
- 医疗电源
- 多功能打印机
- 企业和影院投影仪
- PC 电源
- 游戏机电源
- 照明

3 说明

UCC25661x 系列是可实现输入功率比例控制 (IPPC) 方案的高频 LLC 控制器, 具有增强的轻负载管理和多种保护功能。IPPC 拓宽了 LLC 转换器的控制范围, 简化了 LED 驱动器、电池充电器等宽输入或输出电压范围应用的设计。IPPC 可以在没有 PFC 的情况下工作, 适用于非通用输入应用。

UCC25661x 系列改进了增强型轻负载管理, 可提高效率, 同时可更大程度地降低可闻噪声。为更大程度地降低待机功耗, UCC25661x 系列在突发模式下运行时可直接禁用 PFC 控制器。

自动电容区规避方案以及具有反向恢复规避方案的自适应软启动功能, 可确保器件不会在可能损坏 FET 的模式下工作。自动电容区规避方案使得该控制器非常适合预偏置负载。

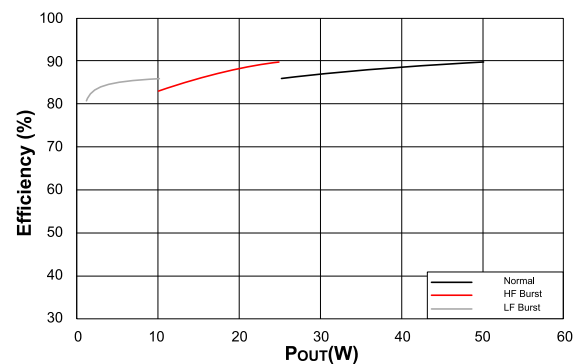
UCC25661x 系列附带强大的保护功能, 可帮助用户设计可靠的电源。UCC25661x 系列具有支持高压启动、X 电容器放电、OVP 和扩展增益范围 (EGR) 的选项。请参阅[器件比较表](#), 了解详细信息。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
UCC25661x 系列	DDB (SOIC, 16)	9.9mm × 3.9mm

(1) 有关所有可用封装, 请参阅[节 11](#)。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值, 并包括引脚 (如适用)。



典型效率曲线



内容

1 特性	1	7.4 保护功能	28
2 应用	1	7.5 器件功能模式	31
3 说明	1	8 应用和实施	42
4 器件比较表	3	8.1 应用信息	42
5 引脚配置和功能	4	8.2 典型应用	42
6 规格	6	8.3 电源相关建议	53
6.1 绝对最大额定值.....	6	8.4 布局	54
6.2 ESD 等级.....	6	9 器件和文档支持	58
6.3 建议运行条件.....	7	9.1 文档支持.....	58
6.4 热性能信息.....	7	9.2 接收文档更新通知.....	58
6.5 电气特性.....	7	9.3 支持资源.....	58
6.6 开关特性.....	11	9.4 商标.....	58
6.7 典型特性.....	12	9.5 静电放电警告.....	58
7 详细说明	16	9.6 术语表.....	58
7.1 概述.....	16	10 修订历史记录	58
7.2 功能方框图.....	18	11 机械、封装和可订购信息	60
7.3 特性说明.....	18	11.1 机械数据.....	62

4 器件比较表

特性	UCC256610	UCC256611	UCC256612	UCC256613	UCC256614	UCC256616
集成式高压启动	●	●	●		●	●
集成 X 电容器放电	●	●			●	
扩展增益范围 (EGR)	●				●	
输出 - 电压 (OVP) 锁存		●				●
突发模式保留	●					
软开/关突发模式	●					
OCP/OLP 去耦	●	●	●	●	●	
LF 突发期间的 PFC 开/关					●	
OLP 检测时间	100ms	100ms	100ms	100ms	100ms	100ms

5 引脚配置和功能

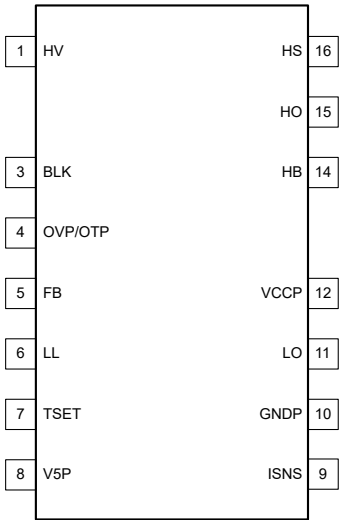


图 5-1. DDB 封装，16 引脚 SOIC；移除了引脚 2 和 13（顶视图）

表 5-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
	2	—	缺少。用于高压引脚和低压引脚之间爬电距离的 HV 垫片
	13	不适用	缺少引脚。用于高压引脚和低压引脚之间爬电距离的高压垫片。
BLK	3	I	用于前馈控制的大容量直流电压检测和输入。 通过大容量电容器的正极端子和 GNDP 之间的电阻分压器连接 BLK，以设置 LLC 转换器的启动和停止电压阈值。有关更多详细信息，请参阅 节 7.3.5.1 。
FB	5	I	反馈控制输入。 将 FB 连接到隔离式反馈网络中光耦合器的集电极引脚。有关更多详细信息，请参阅 节 7.3.3 。
GNDP	10	P	接地基准引脚。将 GNDP 连接至初级侧大容量电容器负端子。
HB	14	P	高侧栅极驱动器偏置输入。在 HB 和 HS 引脚之间连接一个电容器（最小 0.1μF，最大 5μF）。有关更多详细信息，请参阅 节 8.3.2 。
HO	15	O	高侧开关栅极驱动器输出。连接到高侧开关栅极端子，尽可能减小栅极驱动电路回路面积。
HS	16	P	高侧栅极驱动器返回路径和开关节点连接输入。在 LLC 转换器中连接至半桥结构的开关节点。此引脚上的电压用于确定自适应死区时间。有关更多详细信息，请参阅 节 7.3.4 。
HV	1	I	高压 (HV) 启动和 X 电容器放电。 HV 引脚用来执行 HV 启动。启动完成后，HV 引脚用于交流存在性检测和 X 电容器放电。该引脚连接至整流交流线路（适用于 UCC256610、UCC256611、UCC256614、UCC256616）或输入大容量电容器（适用于 UCC256612 和 UCC256613）。

表 5-1. 引脚功能 (续)

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
ISNS	9	I	谐振电路电流检测输入。 将 ISNS 引脚通过串联差分电容器连接到谐振电容器，以及将电流检测电阻器连接到 GNDP。 该引脚可检测差动谐振电容器电压。此信号在内部用于： • 生成控制信号 • OCP 和逐周期电流限制 • 容性区域规避 有关更多详细信息，请参阅 节 8.2.2.17。
LL	6	I	轻负载运行和突发模式阈值设置输入。 将 LL 连接到 V5P 和 GNDP 之间电阻分压器的中心节点。LL 引脚的阻抗和电压用于为高频和低频突发模式运行选择阈值。有关更多详细信息，请参阅 节 7.5.3。
LO	11	O	低侧开关栅极驱动器输出。连接到低侧开关栅极端子，尽可能减小栅极驱动电路回路面积。
OVP/OTP	4	I	过压保护和外部过热保护输入。 通过 NTC 电阻器将 OVP/OTP 连接到 GNDP，并通过齐纳二极管连接到 VCCP。有关更多详细信息，请参阅 节 7.3.5.3。
TSET	7	I/O	VCR 合成器时间常数设置输入和 PFC 开/关输出 (UCC256614)。 TSET 用于在 IPPC 模式下设置最小 VCR 时间常数和最小开关频率，方法是使用 节 8.2.2.18 中定义的电阻分压器。它还兼具双重功能：对于 UCC256614 作为 PFC 禁用引脚；对于 UCC256610 作为强制实现低频突发模式的输入引脚。有关详细信息，请参阅 节 8.2.2.18。
V5P	8	P	5V 内部稳压器输出。 在 V5P 至 GNDP 之间连接一个去耦电容器 (推荐 1μF 至 4.7μF)。将此电容器放置在靠近 V5P 的位置。根据应用需求来选择电介质。
VCCP	12	P	IC 电源电压引脚。 在 VCCP 和 GNDP 之间连接一个低 ESR 陶瓷 2.2μF 去耦电容器。此外，通常还使用储能电解电容器和滤波电容器的并联组合。 对于在 LLC 变压器上包含辅助偏置绕组的应用，VCCP 引脚通过二极管连接至偏置绕组。对于禁用 HV 启动的应用，VCCP 由辅助偏置电源供电。 VCCP 引脚在内部被钳位至 19V。

(1) I = 输入、O = 输出、P = 电源、I/O = 双向、N/A = 不适用

更多详细信息，请参阅[节 8.2](#)。

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风工作温度范围内（除非另有说明），所有电压均以 GND 为基准，进入指定端子的电流为正电流，从指定端子流出的电流为负电流。⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
输入电压	HV, HB	-0.3	700	V
	ISNS	-6.5	6.5	V
	BLK, LL, TSET	-0.55	5.5	V
	HB - HS	-0.3	25	V
	VCCP	-0.55	30	V
	OVP/OTP	-0.55	5.5	V
5V	DC	-0.55	5.5	V
HO 输出电压	DC	HS - 0.3	HB + 0.3	V
	瞬态, 小于 100ns	HS - 2	HB + 0.3	
LO 输出电压	DC	-0.3	VCCP + 0.3	V
	瞬态, 小于 100ns	-2	VCCP + 0.3	
悬空接地压摆率	dV _{HS} /dt	-200	200	V/ns
HO、LO 脉冲电流	I _{OUT_PULSED}	-0.6	1.2	A
结温范围	T _J	-40	150	°C
存储温度范围, T _{stg}	T _{stg}	-65	150	
引线温度	焊接, 10 秒		300	
	回流焊		260	

(1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。

6.2 ESD 等级

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/ JEDEC JS-001, HV、HO、HS、HB 引脚 ⁽¹⁾	±1000	V
		人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/ JEDEC JS-001, 其他所有引脚 ⁽¹⁾	±2000	
		充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101, 所有引脚 ⁽²⁾	±500	

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全地进行生产。

(2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

6.3 建议运行条件

所有电压均以 GND 为基准， $-40^{\circ}\text{C} < T_J = T_A < 125^{\circ}\text{C}$ ，进入指定端子的电流为正电流，从指定端子流出的电流为负电流，除非另有说明。

		最小值	标称值	最大值	单位
HV, HS	输入电压			640	V
V _{VCCP}	电源电压		15	18.5	V
HB - HS	驱动器自举电压	10	14	17.5	V
C _B	从 HB 到 HS 的陶瓷旁路电容器	0.1		5	μF
C _{VCCP}	VCCP 引脚去耦电容器	33		470	μF
I _{VCCP} MAX	VCCP 的最大输入电流			100	mA
T _A	工作环境温度	-40		125	°C

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		UCC25661x	单位
		D (SOIC)	
		14 引脚	
R _{θJA}	结至环境热阻	74.7	°C/W
R _{θJC(top)}	结至外壳 (顶部) 热阻	30.7	°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	31.8	°C/W
Ψ _{JT}	结至顶部特征参数	4.4	°C/W
Ψ _{JB}	结至电路板特征参数	31.4	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标应用手册](#)。

6.5 电气特性

所有电压均以 GND 为基准， $-40^{\circ}\text{C} < T_J < 125^{\circ}\text{C}$ ，VCC = 15V，进入指定端子的电流为正电流，从指定端子流出的电流为负电流，除非另有说明。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压					
VCC _{Short}	低于该阈值时，使用减低启动电流	0.6	1	1.4	V
VCC _{ReStartJfet}	低于该阈值时，重新启用 JFET。		10.2		V
VCC _{ReStart}	在启动阶段，当 VCC 低于此水平时，将重新启用 HV 启动	12.5	13	13.5	V
VCC _{StartSelf}	当 VCC 高于此水平时启动	13.5	14	14.5	V
VCC _{StartExt}	当 VCC 高于此水平时启动	10.5	10.9	11.3	V
VCC _{StopSwitching}	低于此阈值时停止开关	9	9.5		V
VCC _{UVLOr}	VCC 欠压锁定电压 (上升)	7.25	7.5	7.82	V
VCC _{UVLOf}	VCC 欠压锁定电压迟滞	6.5	6.8	7.1	V
VCC _{Hold_r}	启动编程阶段的 Jfet 停止电压	7.9	8.2	8.5	V
VCC _{Hold_f}	启动编程阶段的 Jfet 启动电压	7.65	7.9	8.15	V
VCC _{Shunt}	VCC 内部钳位电压		19		V
IVCC _{Clamp}	VCC 内部钳位电流		15		mA
VCC _{OV}	VCC OVP 阈值		20.5		V
电源电流					

6.5 电气特性 (续)

所有电压均以 GND 为基准, $-40^{\circ}\text{C} < T_J < 125^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 15\text{V}$, 进入指定端子的电流为正电流, 从指定端子流出的电流为负电流, 除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$I_{CCSleep}$	突发关闭周期期间从 V_{CC} 电压轨获取的电流			800		μA
I_{CCRun}	栅极开关时从 V_{CC} 引脚获取的电流。不包括栅极电流	死区时间 = $1\mu\text{s}$ 最大死区时间		8		mA
$I_{CCLatchFault}$	锁存故障状态下从 V_{CC} 引脚汲取的电流 ⁽¹⁾	仅适用于 UCC256611			1	mA
稳压电源						
V5P	稳压电源电压 ⁽¹⁾	空载	4.75	5	5.25	V
	稳压电源电压	10mA 负载	4.75	5	5.25	V
V5P _{UVLO}	V5P 欠压锁定电压 ⁽¹⁾			4		V
$I_{V5PStartupCurrLimit}$	当 $V_{CCP} < V_{CCStartSelf}$ 时可从该引脚上汲取的最大电流 ⁽¹⁾	$V_{CCP} = 15\text{V}$		6		mA
$I_{V5PCurrLimit}$	$I_{V5P} = 15\text{mA}$ 时的 V5P	$V_{CCP} = 15\text{V}$	10.2			mA
高压启动						
$I_{VCC_Charge_Low}$	来自 HV 引脚的减低 V_{CCP} 充电电流	$V_{HV} = 20\text{V}$, $V_{CC} = 0\text{V}$ (UCC256610、UCC256611、 UCC256612、UCC256614、 UCC256616)	0.23	0.44	0.65	mA
$I_{VCC_Charge_High}$	全 V_{CCP} 充电电流	$V_{HV} = 20\text{V}$, $V_{CC} = 4\text{V}$ (UCC256610、UCC256611、 UCC256612、UCC256614、 UCC256616)	7.5	10	13.8	mA
I_{HVZCD}	最高交流过零检测测试电流	UCC256610、UCC256611、 UCC256614		0.625		mA
$I_{XCAPDischarge}$	X 电容放电电流	UCC256610、UCC256611、 UCC256614	8.7	11.5	14.3	mA
$V_{zero-crossing}$	检测到过零的 HV 引脚电压阈值	UCC256610、UCC256611、 UCC256614	8	9	11	V
$t_{XCAPZCD}$	第一个四测试电流级的交流过零检测窗口长度 ⁽¹⁾	UCC256610、UCC256611、 UCC256614	10	12	14	ms
$t_{XCAPZCDLast}$	最后一个测试电流级的交流过零检测窗口长度 ⁽¹⁾	UCC256610、UCC256611、 UCC256614		36		ms
$t_{XCAPIdle}$	交流过零检测空闲周期长度 ⁽¹⁾	UCC256610、UCC256611、 UCC256614		700		ms
$t_{XCAPDischarge}$	X 电容放电电流处于活动状态的时间 ⁽¹⁾	UCC256610、UCC256611、 UCC256614	327	360	390	ms
$t_{XCAPJFETON}$	JFETON 之后首次 X 电容检测的时间 ⁽¹⁾	UCC256610、UCC256611、 UCC256614		12		ms
I_{XCAP_I0}	X 电容测试电流 I0	UCC256610、UCC256611、 UCC256614		125		μA
I_{XCAP_I1}	X 电容测试电流 I1	UCC256610、UCC256611、 UCC256614		125		μA
I_{XCAP_I2}	X 电容测试电流 I2	UCC256610、UCC256611、 UCC256614		250		μA
I_{XCAP_I3}	X 电容测试电流 I3	UCC256610、UCC256611、 UCC256614		375		μA
恒压电压感应						
$V_{BLKStartHys}$	BLK 电压比较器迟滞 ⁽¹⁾	UCC256610、UCC256614	0.04	0.05	0.06	V

6.5 电气特性 (续)

所有电压均以 GND 为基准, $-40^{\circ}\text{C} < T_J < 125^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 15\text{V}$, 进入指定端子的电流为正电流, 从指定端子流出的电流为负电流, 除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{BLKStartHys}$	BLK 电压比较器迟滞 ⁽¹⁾	适用于 UCC256611、UCC256612、UCC256613、UCC256616	0.09	0.1	0.11	V
$V_{BLKStop}$	强制 LLC 停止运行的 BLK 电压		0.98	1	1.02	V
I_{BLKHys}	BLK 迟滞电流 (批量欠压灌电流)	UCC256610、UCC256614		1		μA
I_{BLKHys}	BLK 迟滞电流 (批量欠压灌电流)	适用于 UCC256611、UCC256612、UCC256613、UCC256616		5		μA
反馈引脚						
$R_{FBInternal}$	内部下拉电阻阻值	适用于 UCC256610、UCC256611、UCC256614、UCC256616	85	100	115	$k\Omega$
$R_{FBInternal}$	内部下拉电阻阻值	UCC256612、UCC256613	42.5	50	57.5	$k\Omega$
I_{FB}	FB 内部电流源	适用于 UCC256610、UCC256611、UCC256614、UCC256616	68	80	92	μA
I_{FB}	FB 内部电流源	UCC256612、UCC256613	136	160	184	μA
V_{FB}	当 FB 引脚灌电流处于 ($I_{FB} - 50\mu\text{A}$) 时的 FB 引脚电压	$I_{lopto} = 0.37 \times I_{FB}$	3.3	3.5	3.7	V
ΔV_{FB}	当 FB 引脚灌电流范围为 ($I_{lopto} = 0.37 \times I_{FB}$ 至 $I_{lopto} = 0.94 \times I_{FB}$) 时的 FB 引脚电压变化				0.6	V
ΔV_{clamp}	当 FB 引脚灌电流范围为 ($I_{lopto} = 0.94 \times I_{FB}$ 至 ($I_{lopto} = 1.06 \times I_{FB}$) 时的 FB 引脚电压变化	($I_{lopto} = 0.94 \times I_{FB}$) 至 ($I_{lopto} = 1.06 \times I_{FB}$)	0.3			V
$I_{FBclamp}$	当 FB 被钳位时的最大 FB 内部电流源	适用于 UCC256610、UCC256611、UCC256616	75	87.5	100	μA
$I_{FBclamp}$	当 FB 被钳位时的最大 FB 内部电流源	对于 UCC256612、UCC256613、UCC256614	150	175	200	μA
$\Delta V_{FBclamp}$	当 FB 引脚灌电流范围为 ($I_{lopto} = 1.06I_{FB}$) 至 ($I_{lopto} = I_{FB} + 0.94 I_{FBclamp}$) 时的 FB 引脚电压变化	($I_{lopto} = 1.06I_{FB}$) 至 ($I_{lopto} = I_{FB} + 0.94 I_{FBclamp}$)			0.5	V
f_{-3dB}	反馈链 -3dB 截止频率 ⁽²⁾	VFBReplica 从 4.5V 至 0.5V	1			MHz
V_{FBOLP}	OLP 保护 ⁽¹⁾			4.75		V
$TOLP_{Fault}$	OLP 保护时间 ⁽¹⁾			100		ms
谐振电流检测						
V_{ISNS_OCP}	稳定状态期间的 OCP 阈值	适用于 UCC25616, TSET 选项 > 2.5V ⁽¹⁾	3.9	4	4.1	V
V_{ISNS_OCP}	稳定状态期间的 OCP 阈值	适用于 UCC256616, TSET 选项 < 2.5V	3.4	3.5	3.6	V
V_{ISNS_OCP}	稳定状态期间的 OCP 阈值	适用于 UCC256610、UCC256611、UCC256612、UCC256613、UCC256614	3.4	3.5	3.6	V
$V_{ISNS_OCP_SS}$	软启动期间的 OCP 阈值		2.9	3	3.1	V
n_{OCP}	触发 OCP 故障前的 OCP 周期数 ⁽¹⁾			7		
n_{OCP_SS}	启动时触发 OCP 故障前的 OCP 周期数 ⁽²⁾			50		
$V_{IpolarityHyst}$	ISNS 极性比较器迟滞			40		mV
V_{ISNS_ZCS}	软启动后的 ZCS 比较器 +Ve 阈值	对于 UCC256616		100		mV
V_{ISNS_ZCSn}	软启动后的 ZCS 比较器 -Ve 阈值	对于 UCC256616		-100		mV

6.5 电气特性 (续)

所有电压均以 GND 为基准， $-40^{\circ}\text{C} < T_J < 125^{\circ}\text{C}$ ， $V_{CC} = 15\text{V}$ ，进入指定端子的电流为正电流，从指定端子流出的电流为负电流，除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{ISNS_ZCS}	软启动后的 ZCS 比较器 +Ve 阈值	适用于 UCC256610、UCC256611、UCC256612、UCC256613、UCC256614		150		mV
V_{ISNS_ZCSn}	软启动后的 ZCS 比较器 -Ve 阈值	适用于 UCC256610、UCC256611、UCC256612、UCC256613、UCC256614		-150		mV
$V_{ISNS_MINCUR_R_SS}$	软启动期间的+Ve ISNS 阈值			50		mV
$V_{ISNS_MINCUR_R_SSn}$	软启动期间的-Ve ISNS 阈值			-50		mV
t_{leb}	ZCS 和 OCP 比较器的前沿消隐 ⁽¹⁾			250		nS
$TZCS_{Fault}$	当 ZCS 事件在指定时间内持续存在时检测到的故障 ⁽²⁾	ZCS 事件持续存在		10		mS
栅极驱动器						
V_{LOL}	LO 输出低电压	$I_{sink} = 20\text{mA}$			0.12	V
$V_{RVCC} - V_{LOH}$	LO 输出高电压	$I_{source} = 20\text{mA}$			0.3	V
$V_{HOL} - V_{HS}$	HO 输出低电压	$I_{sink} = 20\text{mA}$			0.12	V
$V_{HB} - V_{HOH}$	HO 输出高电压	$I_{source} = 20\text{mA}$			0.35	V
$V_{HB-HSUVLOFall}$	高侧栅极驱动器 UVLO 下降阈值		6.4	7.25	8	V
$V_{HB-HSUVLOHys}$	高侧栅极驱动器 UVLO 阈值迟滞		0.78	0.9	1.05	V
$I_{source_pk_HO}$	HO 峰值拉电流 ⁽²⁾	在 $V_{CCP} = 12\text{V}$ 时		-0.6		A
$I_{source_pk_LO}$	LO 峰值拉电流 ⁽²⁾	在 $V_{CCP} = 12\text{V}$ 时		-0.6		A
$I_{sink_pk_HO}$	HO 峰值灌电流 ⁽²⁾	在 $V_{CCP} = 12\text{V}$ 时		1.2		A
$I_{sink_pk_LO}$	LO 峰值灌电流 ⁽²⁾	在 $V_{CCP} = 12\text{V}$ 时		1.2		A
自动加载						
$I_{BOOT_QUIESC_ENT}$	(HB - HS) 静态电流	HB - HS = 12V		60	70	μA
I_{BOOT_LEAK}	HB 至 GND 漏电流	$V_{HB} = 600\text{V}$		0.045	20	μA
$t_{ChargeBoot}$	电荷引导状态的长度 ⁽¹⁾		230	265	300	μs
软启动						
$SSRamp$	软启动斜坡时间 ⁽¹⁾			25		ms
OVP/OTP						
V_{clamp_otp1}	0mA 时的钳位电压 ⁽¹⁾	在 0mA 时流经钳位的电流	1.35	1.5	1.65	V
V_{clamp_otp2}	1mA 时的钳位电压 ⁽¹⁾	在 1mA 时流经钳位的电流	2.9	3.5	4.1	V
I_{OTP}	BW/OTP 引脚上的电流源			100		μA
V_{OVPpos}	输出电压 OVP - 上升阈值			3.5		V
V_{OTP_Neg}	OTP - 阈值下降			0.8		V
$OTP_{CompHys}$	OTP 比较器迟滞		60	90	130	mV
$OVP_{CompHys}$	OVP 比较器迟滞		60	100	145	mV
$OTPBlanking_{startup}$	启动时的 OTP 消隐时间			50		ms
$TOTP_{Fault}$	OTP 故障检测时间			330		μS

6.5 电气特性 (续)

所有电压均以 GND 为基准, $-40^{\circ}\text{C} < T_J < 125^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 15\text{V}$, 进入指定端子的电流为正电流, 从指定端子流出的电流为负电流, 除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
TOVP _{Fault}	OVP 故障检测时间 ⁽²⁾			40		uS
TSET						
I _{TSETPrgm}	用于编程的 TSET 引脚源电流			10		uA
LL						
I _{LLPrgm}	用于突发模式转换阈值编程的 LL 引脚拉电流 ⁽²⁾			10		uA
t _{LLPrgm}	突发模式转换阈值编程时间 ⁽²⁾			2		ms
自适应死区时间						
dV _{HS} /dt	可检测的压摆率 (下降斜率) ⁽²⁾		0.1		200	V/ns
故障恢复						
t _{PauseTimeOut}	暂停计时器 ⁽¹⁾			1		s
热关断						
T _{J_r}	热关断温度 ⁽¹⁾	温度上升	125	150		°C
T _{J_H}	热关断迟滞 ⁽¹⁾			20		°C

(1) 未经量产测试。根据特征确定

(2) 未经量产测试。根据设计确定

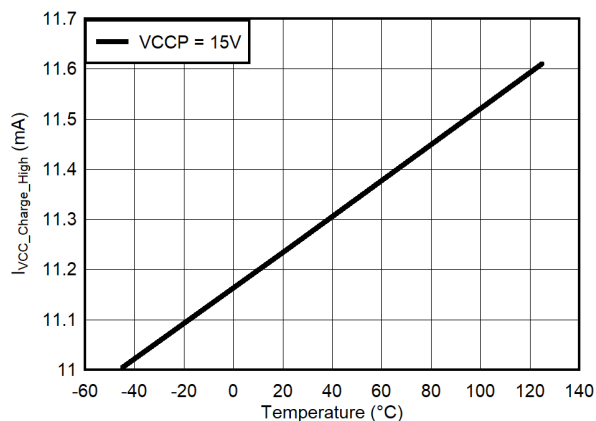
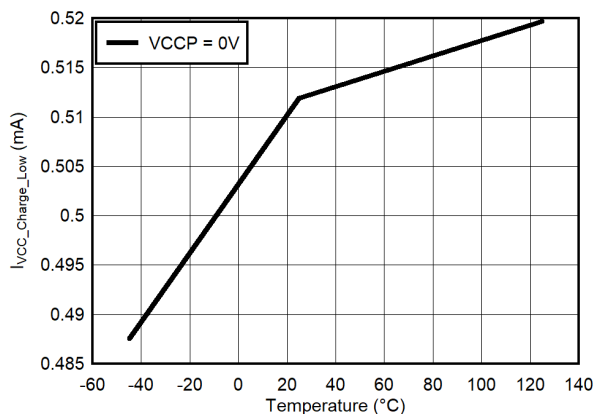
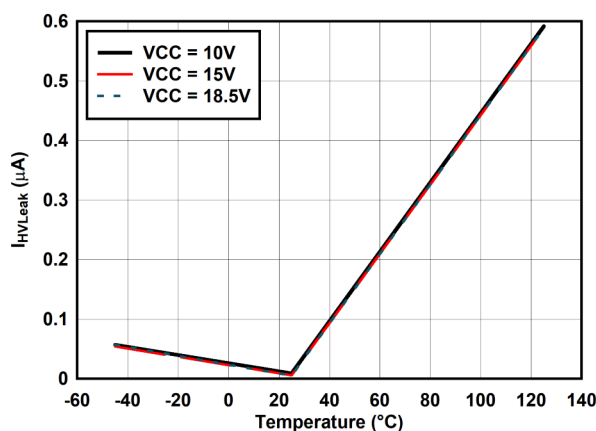
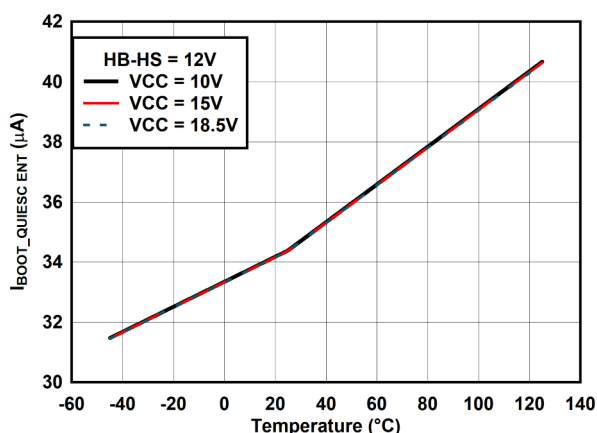
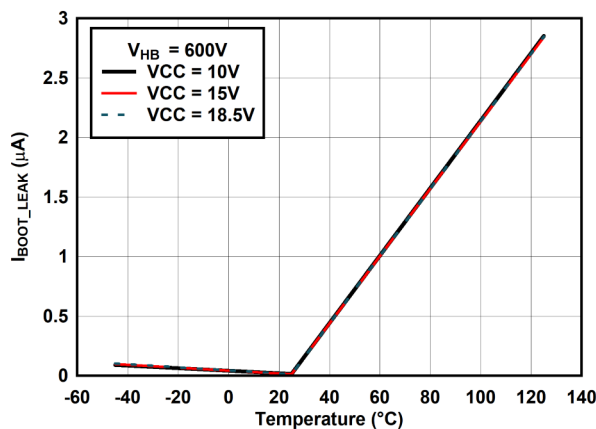
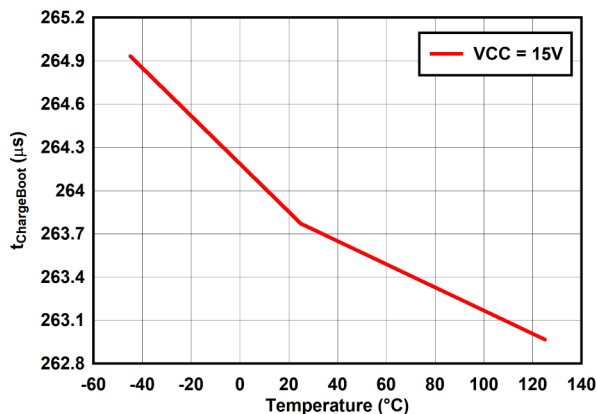
6.6 开关特性

所有电压均以 GND 为基准, $-40^{\circ}\text{C} < T_J = T_A < 125^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 15\text{V}$, 进入指定端子的电流为正电流, 从指定端子流出的电流为负电流, 除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
t _{r(LO)}	上升时间	10% 至 90%, 1nF 负载		30	60	ns
t _{f(LO)}	下降时间	10% 至 90%, 1nF 负载		20	30	ns
t _{r(HO)}	上升时间	10% 至 90%, 1nF 负载		30	60	ns
t _{f(HO)}	下降时间	10% 至 90%, 1nF 负载		15	50	ns
t _{DT(min)}	最小死区时间 ⁽¹⁾			50		ns
t _{DT(max)}	最大死区时间 (死区时间故障) ⁽¹⁾	未检测到 ZCS 阈值		1		μs
t _{DT(max_ZCS)}	最大死区时间 (死区时间故障) ⁽¹⁾	检测到 ZCS 阈值		1.1		μs
t _{ON(min)}	最小栅极打开时间			250		ns
t _{ON(max)}	最大栅极打开时间			10		μs
t _{ipol(ZCS)}	结束之后可使用 IPOL 信号来终止 DT 的消隐时间	检测到 ZCS 阈值		500		ns

(1) 未经量产测试。根据设计确定

6.7 典型特性

图 6-1. $I_{VCC_Charge_High}$ 与温度间的关系图 6-2. $I_{VCC_Charge_Low}$ 与温度间的关系图 6-3. I_{HVLeak} 与温度间的关系图 6-4. $I_{BOOT_QUIESCENT}$ 与温度间的关系图 6-5. I_{BOOT_LEAK} 与温度间的关系图 6-6. $t_{ChargeBoot}$ 与温度间的关系

6.7 典型特性 (续)

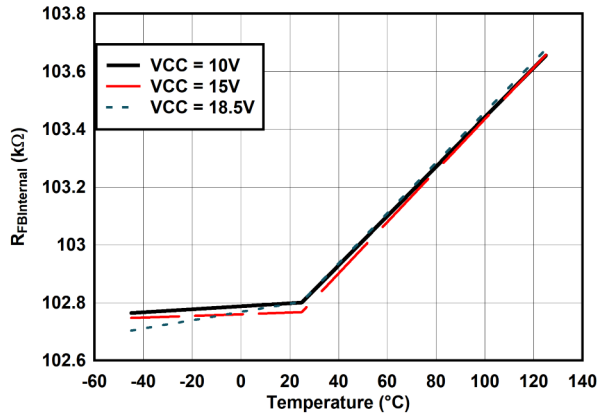


图 6-7. $R_{FBInternal}$ 与温度间的关系

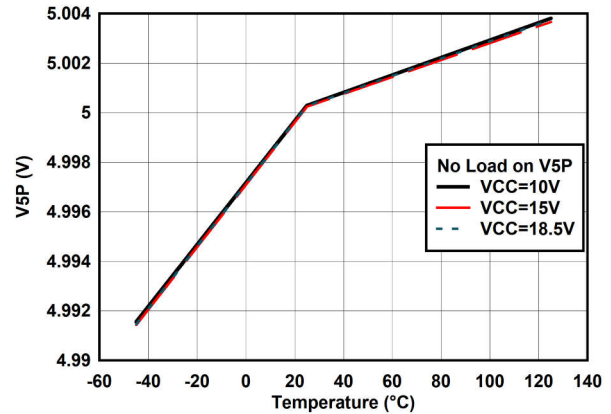


图 6-8. V5P (空载) 与温度间的关系

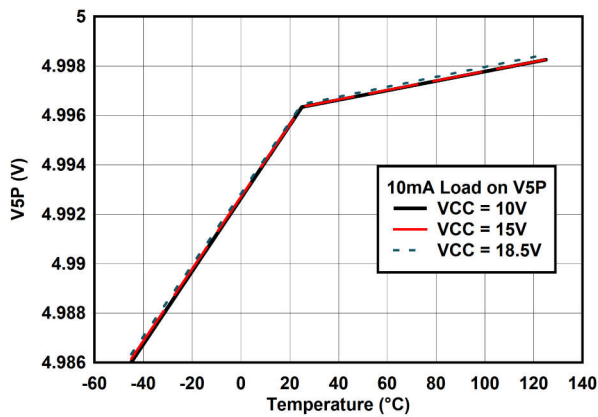


图 6-9. V5P (10mA 负载) 与温度间的关系

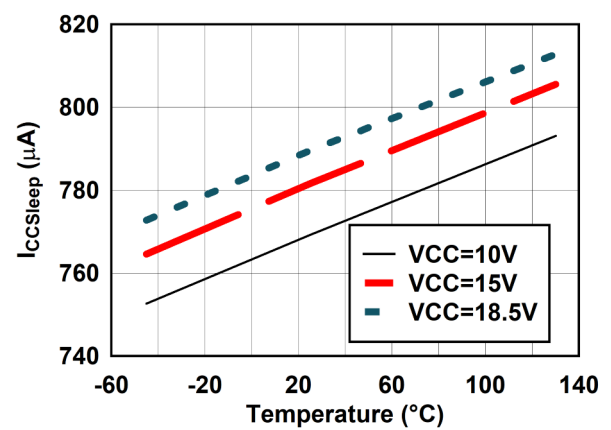


图 6-10. $I_{CCSleep}$ 与温度间的关系

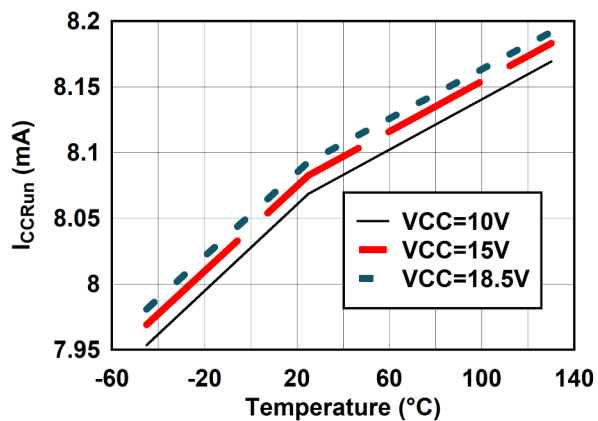


图 6-11. I_{CCRun} 与温度间的关系

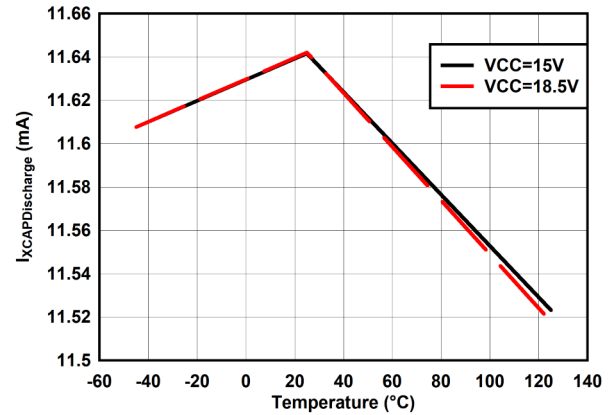
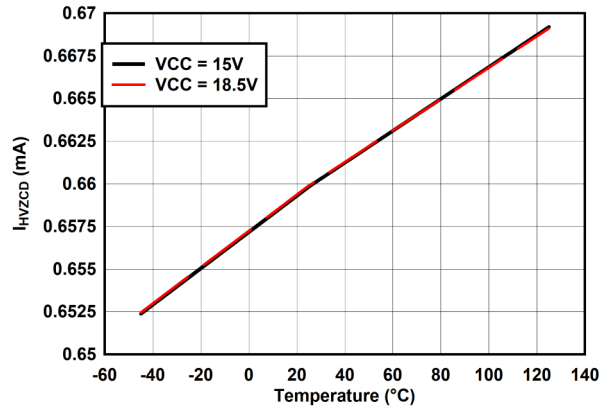
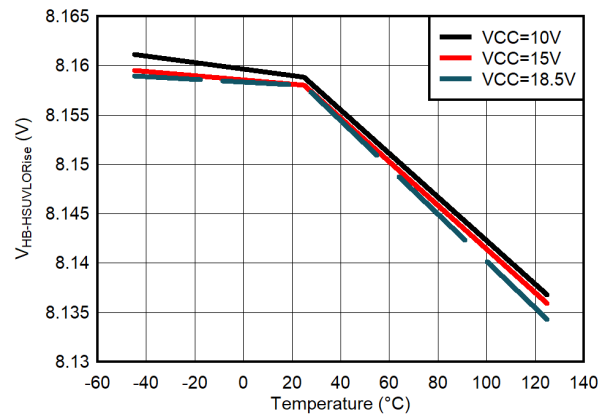
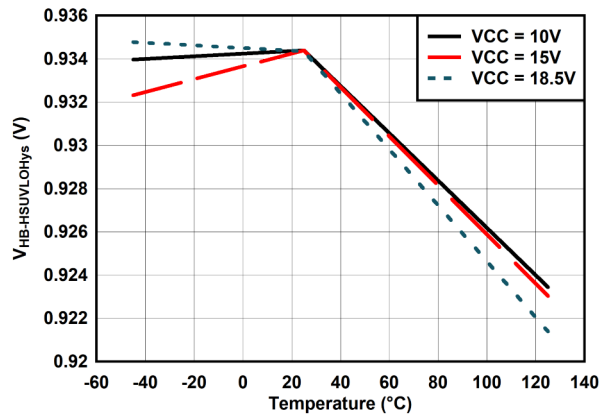
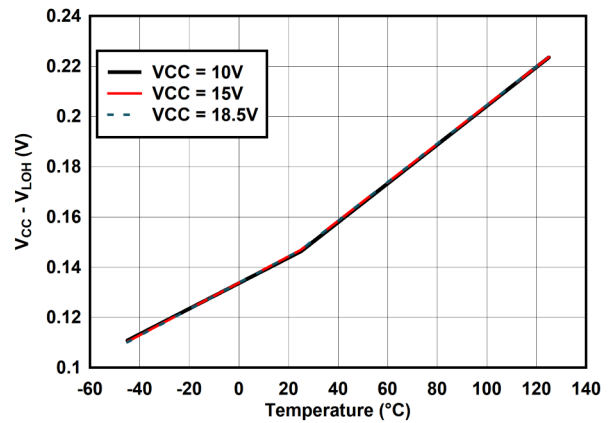
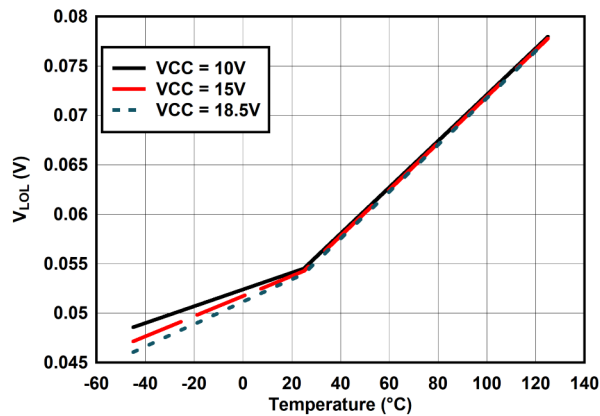
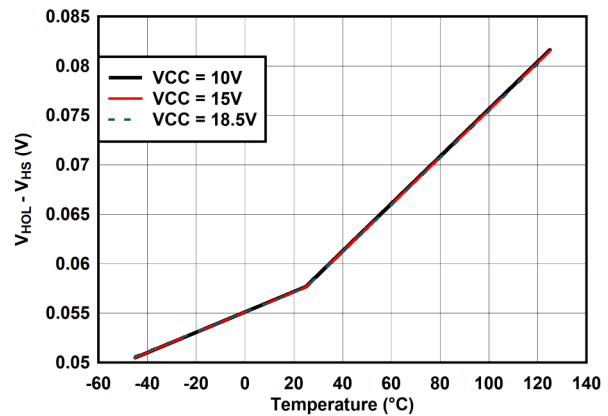


图 6-12. $I_{XCAPDischarge}$ 与温度间的关系

6.7 典型特性 (续)

图 6-13. I_{HVZCD} 与温度间的关系图 6-14. $V_{HB-HSUVLORise}$ 与温度间的关系图 6-15. $I_{HB-HSUVLOHys}$ 与温度间的关系图 6-16. $(V_{RVCC} - V_{LOH})$ 与温度间的关系图 6-17. V_{LOL} 与温度间的关系图 6-18. $(V_{HOL} - V_{HS})$ 与温度间的关系

6.7 典型特性 (续)

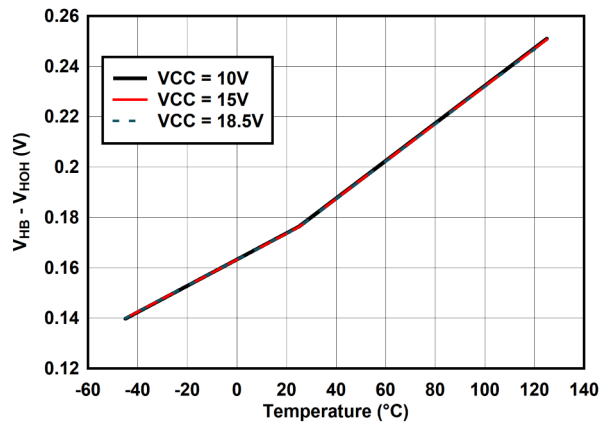


图 6-19. ($V_{HB} - V_{HOH}$) 与温度间的关系

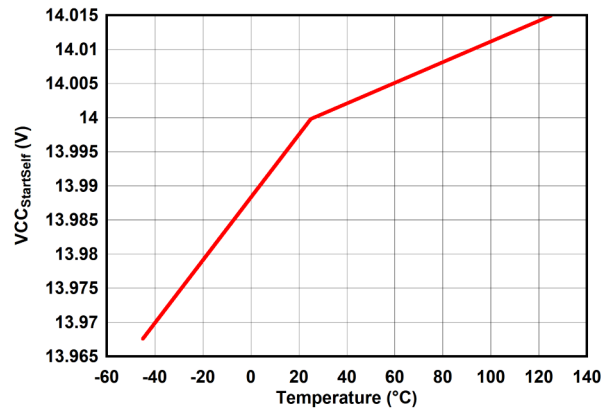


图 6-20. $V_{CCStartSelf}$ 与温度间的关系

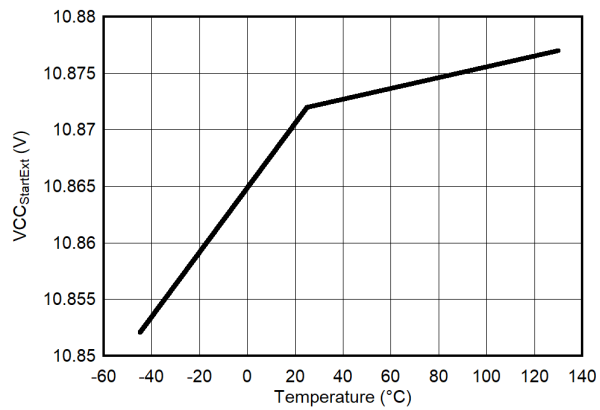


图 6-21. $V_{CCStartEXT}$ 与温度间的关系

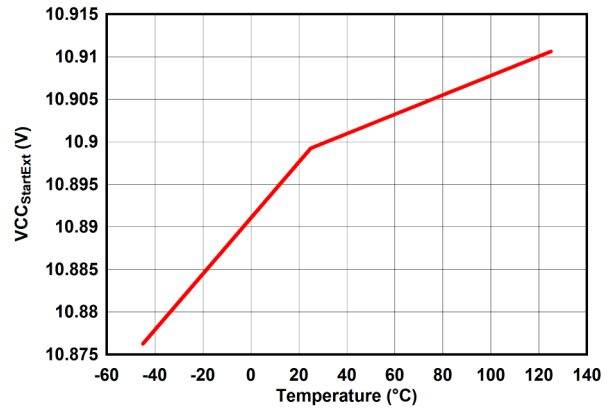


图 6-22. $V_{CCStartExt}$ 与温度间的关系

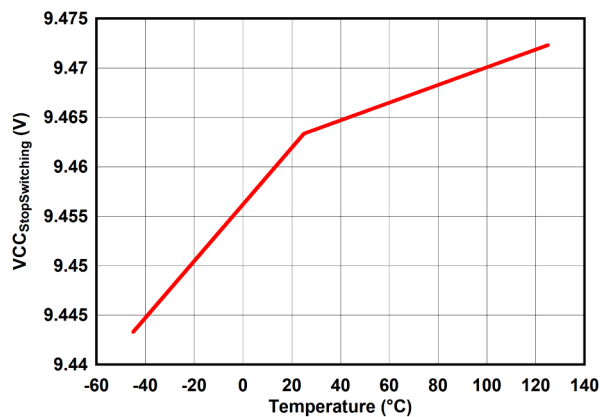


图 6-23. $V_{CCStopSwitching}$ 与温度间的关系

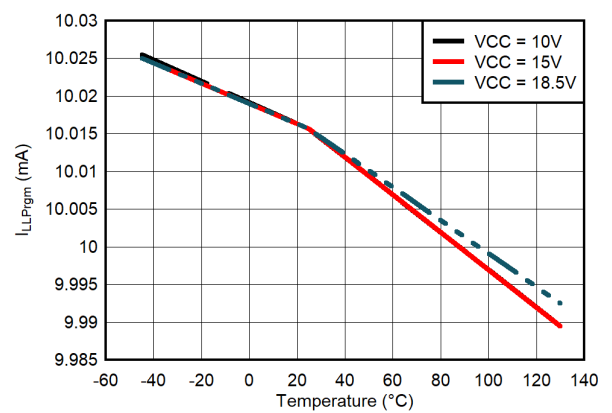


图 6-24. I_{LLPgm} 与温度间的关系

7 详细说明

7.1 概述

UCC25661x 系列是一款适用于隔离式电源的全功能 LLC 谐振控制器。UCC25661x 系列融合了高集成度和多种设计特性，可适应宽输入和输出电压运行、高功率密度以及更高的 LLC 功率级可靠性。

该器件采用新颖的控制方案输入功率比例控制 (IPPC)，可以提供电流模式控制所固有的出色瞬态性能，同时在宽输入和输出电压变化范围内，使输入功率和控制信号之间实现一种线性关系。IPPC 控制可在宽输入和输出电压变化范围内，实现一致的轻负载、突发模式高性能运行。

UCC25661x 系列的一些新特性如下所述：

- IPPC 控制可在宽输入/输出电压运行情况下，实现更稳定的突发模式和动态响应
- 全新的运行模式，可提高轻负载效率，同时降低可闻噪声
 - 高频 (HF) 脉冲跳跃，可提高轻负载效率
 - 低频 (LF) 突发模式，用于降低待机功耗
 - 用于平衡输出纹波和效率的可编程轻型负载/突发模式阈值
 - 自适应突发模式阈值调整，可适应输入电压变化
 - 宽突发模式迟滞，可防止在突发模式下振荡
 - 软输入和软退出突发模式，可进一步降低可闻噪声，并提供强制保持突发模式的选项
- 满载开关频率可实现高功率密度设计：高达 750kHz
- 谐振电流检测与内部控制电压生成相结合，提高了控制稳健性
- 输入电压前馈
- 扩展增益范围 (EGR) 的优点包括：
 - 除 IPPC 外，还能更好地支持输入/输出电压范围更宽的应用
 - 提高在宽输入电压范围内可提供的最小功率（例如当禁用 PFC 时）
 - 通过在轻负载条件下在持续供电的同时禁用 PFC，有助于提高系统效率
- 集成保护功能包括：
 - 快速逐周期电流限制：50ns
 - OCP 故障保护（在短路情况下）
 - 过功率保护 (OPP)，可限制峰值输入功率
 - 零电流开关 (ZCS) 规避方案，可消除容性区运行
 - 自适应软启动，可降低浪涌电流，并消除启动时的反向恢复
 - 外部 OVP/OTP 保护
 - 输入和偏置电源 (VCCP) UVLO
 - 输入电压前馈
 - OCP/OLP 去耦允许独立设置的保护阈值

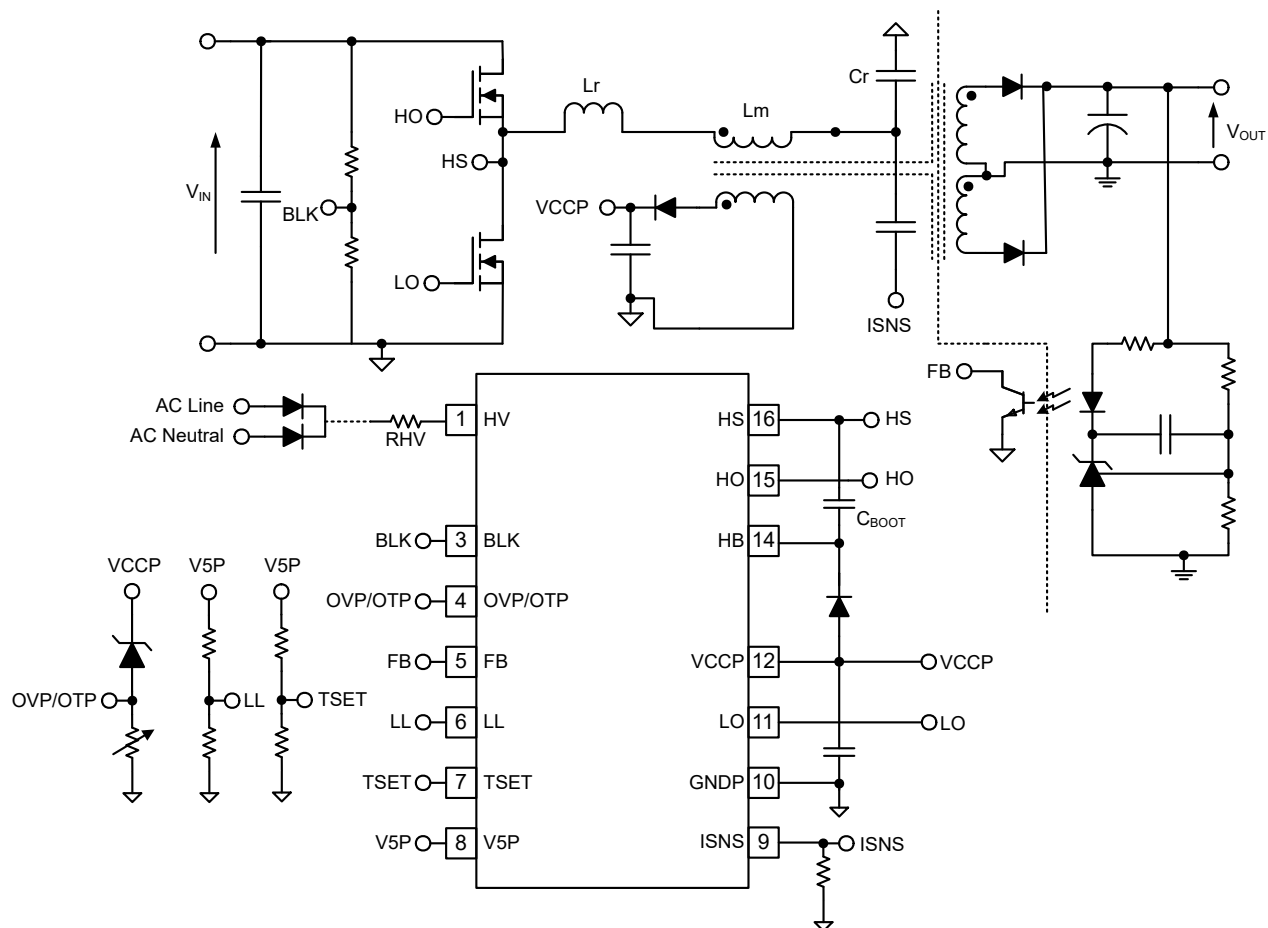


图 7-1. 简化版应用原理图

7.2 功能方框图

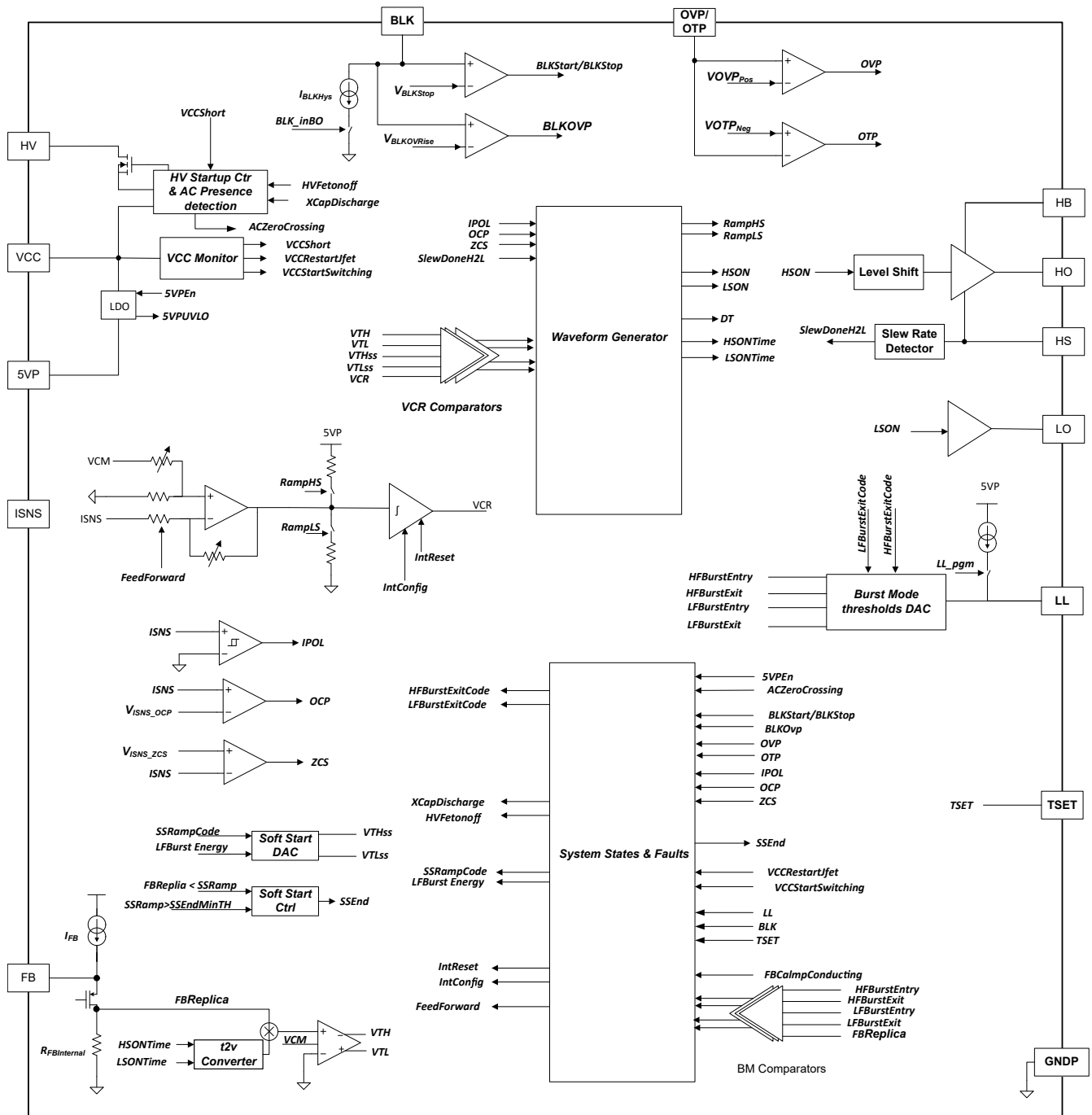


图 7-2. 功能方框图

7.3 特性说明

7.3.1 输入功率比例控制

上一代 TI LLC 控制器使用一种称为混合迟滞控制 (HHC) 的充电控制版本。在 UCC25661x 系列 LLC 控制器中，使用了一种名为输入功率比例控制 (IPPC) 的 HHC 改进版本。传统直接频率控制的控制信号与开关频率成正比，与之相比，传统的充电控制方法在简化补偿器设计的同时可提供更快的瞬态响应，这是因为功率级传递函数变成

了一阶系统。在传统充电控制中，输入电流和开关频率共同决定控制信号。IPPC 显著降低控制信号对开关频率的依赖，从而更大限度减小输入和输出电压变化的影响。

IPPC 可以带来以下优势：

- 使控制信号与输入功率成比例
- 在宽 LLC (WLLC) 运行应用中实现一致的突发模式和过载性能
- 保持更快的负载瞬态性能并提高线路瞬态性能

在 ISNS 引脚上，UCC25661x 系列通过由电容器 C_{ISNS} 和电阻器 R_{ISNS} 形成的外部微分器来测量谐振回路电流。ISNS 引脚上的电压在 VCR 合成器块中积分，形成内部 VCR 信号 V_{CR_synth} 。VCR 合成器块根据 BLK 引脚电压应用前馈增益，并应用斜坡补偿，从而生成补偿后的内部 VCR 信号。然后，补偿后的内部 VCR 信号与两组阈值进行比较，从而控制高侧开关关断 (V_{TH}) 和低侧开关关断 (V_{TL})。阈值 V_{TH} 和 V_{TL} 由内部控制信号 FBReplica，以及前半个开关周期中的高侧和低侧开关导通时间来生成。在软启动期间，会根据内部软启动斜坡生成 V_{TH} 和 V_{TL} 阈值，以尽可能地减小启动期间的谐振回路浪涌电流。

在图 7-3 中，系统根据内部 VCR 信号以及比较器阈值 V_{TH} 和 V_{TL} 来控制高侧和低侧开关。当 VCR 高于 V_{TH} 时，高侧开关关断。当 VCR 低于 V_{TL} 时，低侧开关关断。

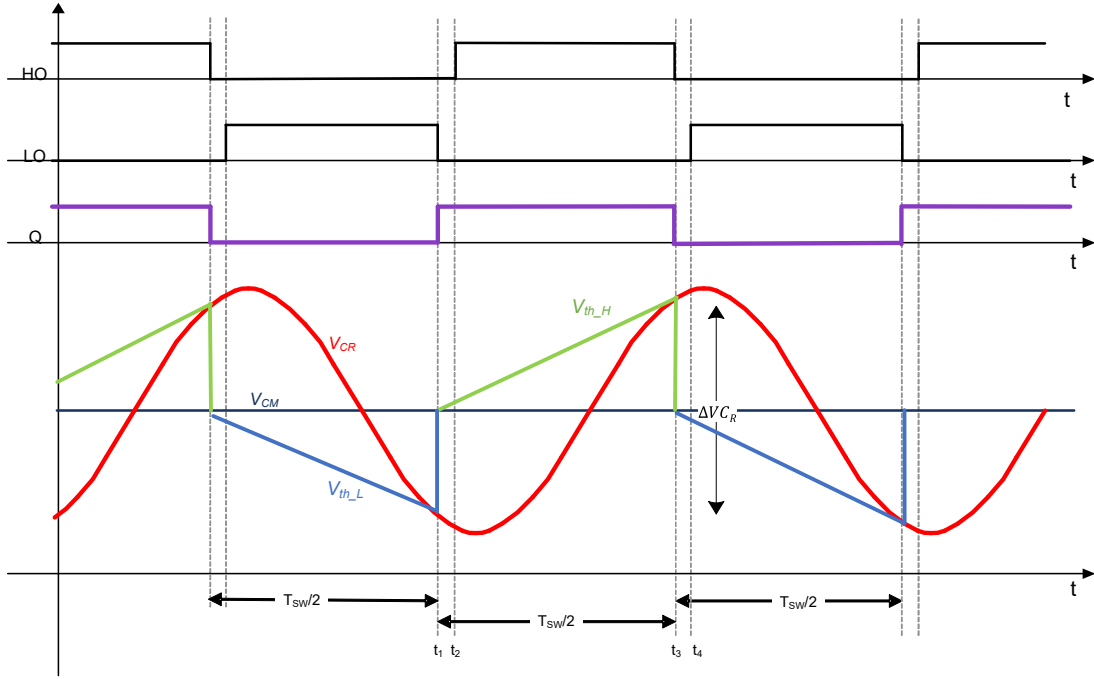


图 7-3. IPPC 基本波形

使用下面的公式，计算比较器阈值 V_{TH} 和 V_{TL} 。FBReplica 是反馈引脚 (FB) 电流的内部电压表示。节 7.3.3 定义了反馈链。

- T_{sw} = 一个开关周期的时长
- k = 常数

$$V_{TH} = (V_{CM} + k \times FBReplica \times T_{sw} \div 2) \quad (1)$$

$$V_{TL} = (V_{CM} - k \times FBReplica \times T_{sw} \div 2) \quad (2)$$

$$V_{TH} - V_{TL} = \Delta V_{CR} = k \times FBReplica \times T_{sw} \quad (3)$$

7.3.1.1 电压前馈

通过实现输入电压前馈，FBReplica 与输入功率成正比，与谐振回路电容的幅度成反比。在应用输入电压前馈的情况下重写 [方程式 4](#)。

$$\text{FBReplica} = \frac{2}{C_r} \times K_1 \times \text{Pin}_{\text{avg}} + K_2 \times I_{\text{RAMP}} \quad (4)$$

其中 K_1 和 K_2 是内部合成器增益。在 **BLK** 引脚上定期检测 **LLC** 功率级的输入电压。然后，使用输入电压的周期性平均值来调节前馈增益，使控制信号与输入功率成比例。更多详细信息，请参阅节 7.3.2。

7.3.2 VCR 合成器

UCC25661x 系列会部署一个 VCR 合成器，其中集成了谐振回路电流，从而形成谐振电容器电压的内部表示。通过在内部实现 VCR 合成器，UCC25661x 系列能够做到通过受控浪涌电流和前馈增益级来支持非常高频的启动。内部 VCR 合成器还使控制器不易受 ISNS 引脚上拾取的外部噪声影响，从而使控制器更加强健。

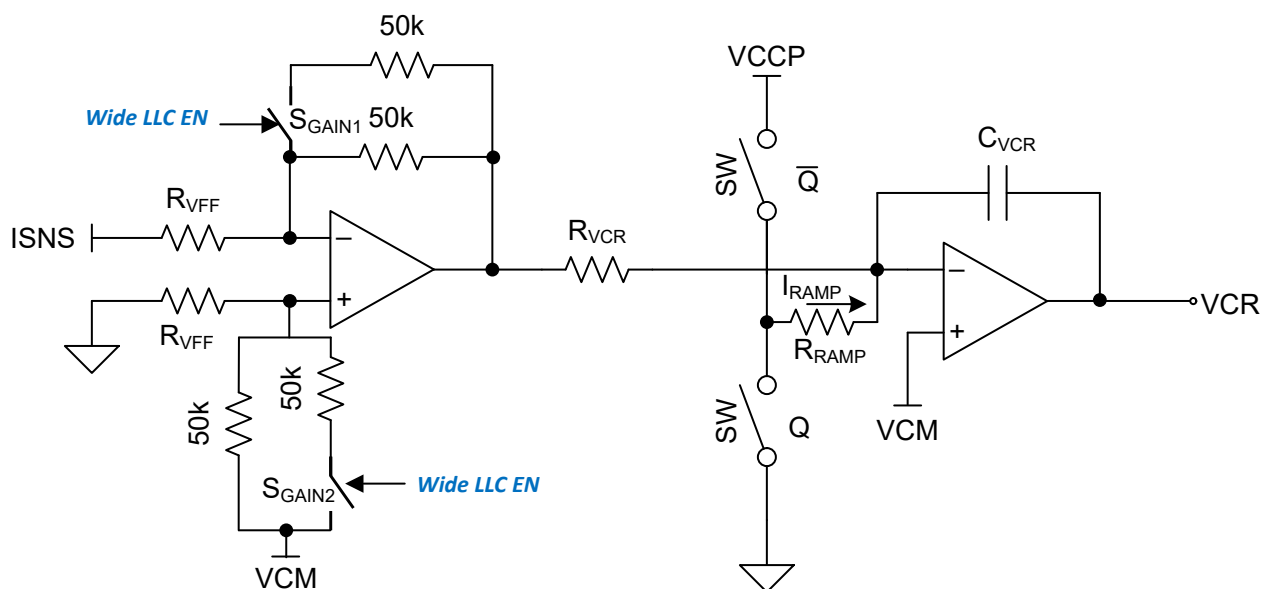


图 7-4. VCR 合成器方框图

VCR 合成器的第一级包含一个可编程增益级，用于实现输入电压前馈功能。UCC256610 和 UCC256614 支持扩展的增益范围 (EGR)。当 LLC 的输入电压在宽范围 (3:1) 内变化时，EGR 功能有助于减少 FBReplica 的变化。该波动减小是通过工厂编程开关 S_{GAIN1} 和 S_{GAIN2} 来降低 VCR 合成器可编程增益级的增益来实现的。

第二级包含一个具有斜坡补偿功能的可编程积分器。为了适应 LLC 功率级的宽频率范围，积分器的时间常数可在启动时从外部进行配置，从而满足使用 TSET 引脚的设计需求。在启动期间，通过 V5P 和 GNDP 之间连接的外部电阻分压器完成 TSET 编程。将外部分压器的中心节点连接到 TSET 引脚。在编程阶段，恒定电流 $I_{TSETPrm}$ 会被馈送到 TSET 引脚，通过 ADC (V_{TSETA}) 测量所产生的电压。在 $T_{TSETPrm}$ 关断之后，并测量 TSET 电阻分压器的电压 (V_{TSETR})。

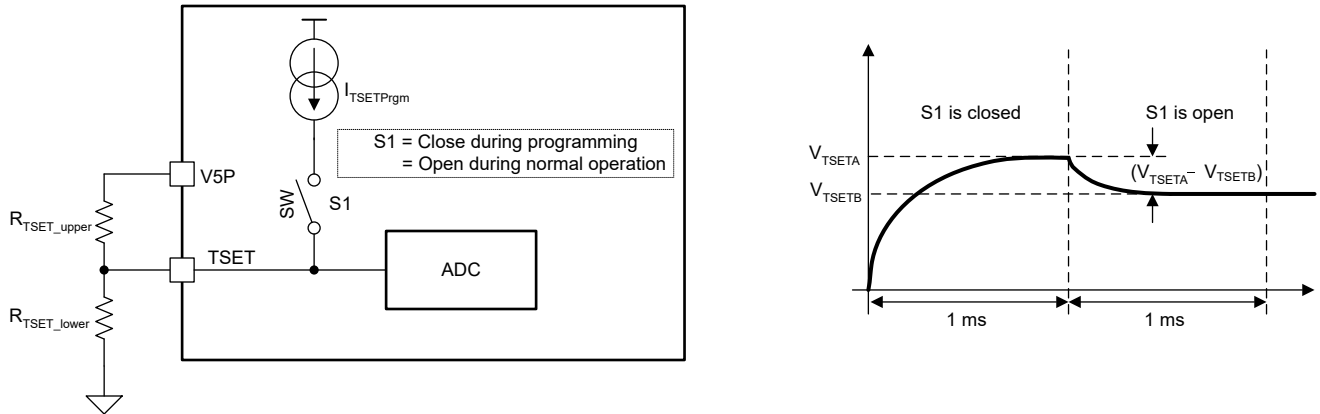


图 7-5. TSET 引脚编程

7.3.2.1 TSET 编程

通过为 VTSETB 电压编程的电压可配置 IPPC 运行的最小工作频率和最大死区时间。在该表中，TSET 电压值为标称值。每个 TSET 设置使用的最大和最小范围均与额定电压值相差 $\pm 48\text{mV}$ 以内。

表 7-1. 通过 TSET 编程选项选择 IPPC 运行的最小频率

TSET 选项编号	TSET 电压 (V_{TSETB}) (V) 用于 3.5V OCP	IPPC 运行所需的最低频率 (kHz)	最大死区时间 (μs)
17	2.295	698.6	0.5
16	2.168	591.6	0.5
15	2.041	501	0.5
14	1.914	424.3	0.5
13	1.787	359.3	1
12	1.66	304.3	1
11	1.533	256.7	1
10	1.416	218.2	1
9	1.299	184.8	1
8	1.182	156.5	1
7	1.074	132.5	1
6	0.967	112.2	1
5	0.850	95	1
4	0.742	80.5	1
3	0.644	68.1	1
2	0.547	57.7	1
1	0.450	48.9	1
X ⁽¹⁾	< 0.392	—	—

(1) 不推荐使用。

VTSETA 和 VTSETB 之间的差异配置了用于为给定功率输出设置 FBReplica 幅度的积分器时间常数，从而能够设置过载功率 (OLP) 阈值。

表 7-2. 通过 TSET 编程选项选择积分器时间常数

TSET 选项编号	TSET 电压 ($V_{\text{TSETA}} - V_{\text{TSETB}}$) (V)，用于 3.5V OCP	积分器时间常数 (ns)
17	2.295	68
16	2.168	80
15	2.041	93

表 7-2. 通过 TSET 编程选项选择积分器时间常数 (续)

TSET 选项编号	TSET 电压 ($V_{TSETA}-V_{TSETB}$) (V), 用于 3.5V OCP	积分器时间常数 (ns)
14	1.914	112
13	1.787	132
12	1.66	156
11	1.533	184
10	1.416	214
9	1.299	257
8	1.182	304
7	1.074	359
6	0.967	424
5	0.850	490
4	0.742	588
3	0.644	694
2	0.547	820
1	0.450	968
X ⁽¹⁾	< 0.392	X

1. 不推荐使用。

7.3.2.2 UCC256616 的 TSET 编程

对于 UCC256616, 仅 V_{TSETB} 电压配置 TSET 设置。根据 V_{TSETB} , 不仅可以选择时间常数, 还可以选择 OCP 阈值。一旦选择时间常数, 还需要配置最大死区时间。节 7.3.2.2 中第 2 列表示维持 IPPC 运行所要求的最低频率。低于此频率时, 控制器仍保持闭环操作, 并在传统电流模式控制下工作。

在 UCC256616 的 TSET 编程选项表中, TSET 电压值为标称值。每个 TSET 设置使用的最大和最小范围均与额定电压值相差 $\pm 48\text{mV}$ 以内。

表 7-3. UCC256616 的 TSET 编程选项表

TSET 选项编号	TSET 电压 (V) 用于 3.5V OCP	TSET 电压 (V) 用于 4V OCP	IPPC 运行所需的最低频率 (kHz)	积分器时间常数 (ns)	最大死区时间 (μs)
17	2.295	2.675	698.6	68	0.5
16	2.168	2.802	591.6	80	0.5
15	2.041	2.929	501	93	0.5
14	1.914	3.056	424.3	112	0.5
13	1.787	3.183	359.3	132	1
12	1.66	3.310	304.3	156	1
11	1.533	3.427	256.7	184	1
10	1.416	3.554	218.2	214	1
9	1.299	3.681	184.8	257	1
8	1.182	3.798	156.5	304	1
7	1.074	3.906	132.5	359	1
6	0.967	4.013	112.2	424	1
5	0.850	4.130	95	490	1
4	0.742	4.238	80.5	588	1
3	0.644	4.336	68.1	694	1
2	0.547	4.433	57.7	820	1
1	0.450	4.532	48.9	968	1

表 7-3. UCC256616 的 TSET 编程选项表 (续)

TSET 选项编号	TSET 电压 (V) 用于 3.5V OCP	TSET 电压 (V) 用于 4V OCP	IPPC 运行所需的最低频率 (kHz)	积分器时间常数 (ns)	最大死区时间 (μs)
X ⁽¹⁾	< 0.392	> 4.589	—	X	—

(1) 不推荐使用。

7.3.3 反馈链 (控制输入)

输出电压控制由位于隔离栅次级侧的电压稳压器电路提供。来自次级侧稳压器电路的需求信号使用光耦合器穿过隔离栅。

VCCP 电压产生一个恒定电流源 I_{FB} ，并连接到 FB 引脚。电阻 RFB 也会与 PMOS 串联连接到此恒定电流源。在正常运行期间，PMOS 始终导通，因此 FB 引脚电压等于齐纳二极管基准电压加上 PMOS 源极至栅极上的压降。

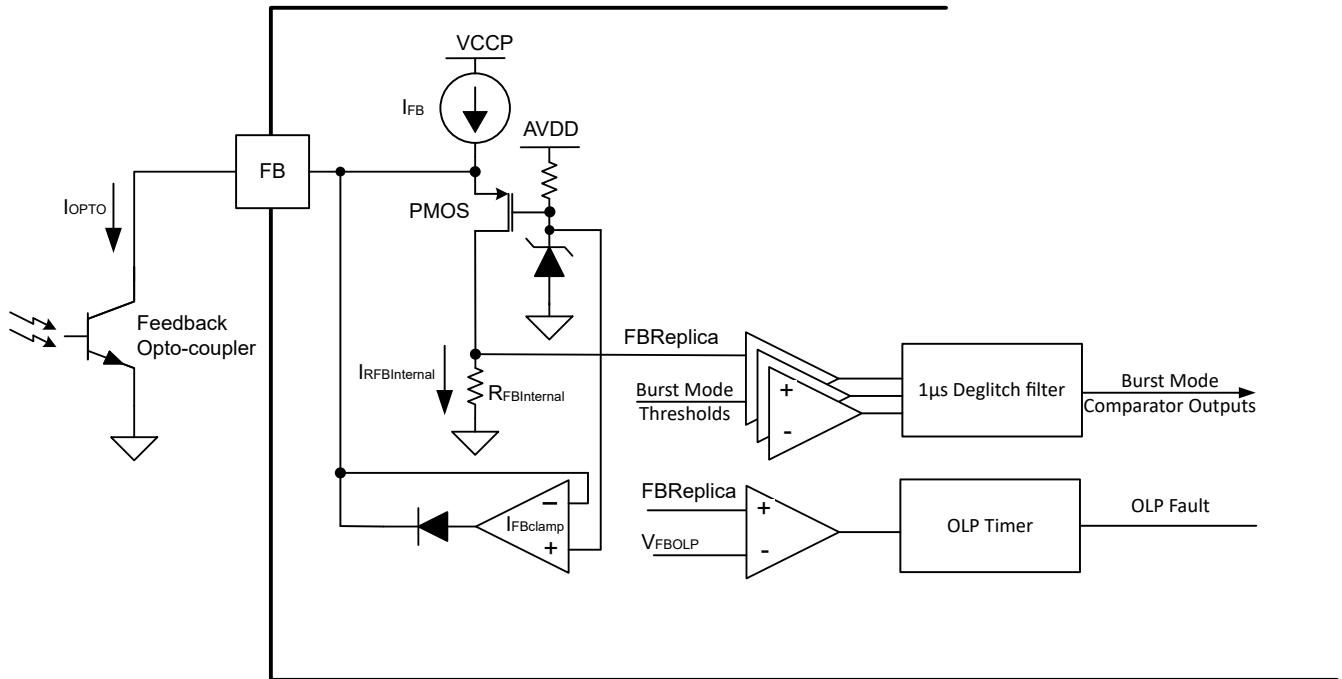


图 7-6. 反馈链方框图

$$I_{RFBInternal} = I_{FB} - I_{OPTO} \quad (5)$$

控制信号 $FBReplica$ 使用 [方程式 6](#) 表示。

$$FBReplica = I_{RFBInternal} \times R_{FBInternal} \quad (6)$$

由 [方程式 6](#) 可知， I_{OPTO} 增加会导致 $I_{RFBInternal}$ 降低，进而降低 $FBReplica$ 。这样，控制信号就会反转。当 I_{OPTO} 继续增加并达到 I_{FB} 的值时，FB 引脚电压开始下降，这是因为没有足够的电流经过 PMOS。FB 引脚拉低会影响系统瞬态响应，这是由于对光耦合器的寄生电容器充电以拉高 FB 引脚电压时，会引入额外延迟。FB 引脚电压钳位电路可用于防止这种情况。当 FB 引脚电压降至 FB 引脚钳位电压阈值以下时，会导通一个额外电流源，对 FB 电压进行钳位。钳位强度为 $I_{FBClamp}$ 。从轻负载变为重负载时，FB 引脚钳位电路可提高系统瞬态性能。FB 引脚钳位的运行如下图所示。

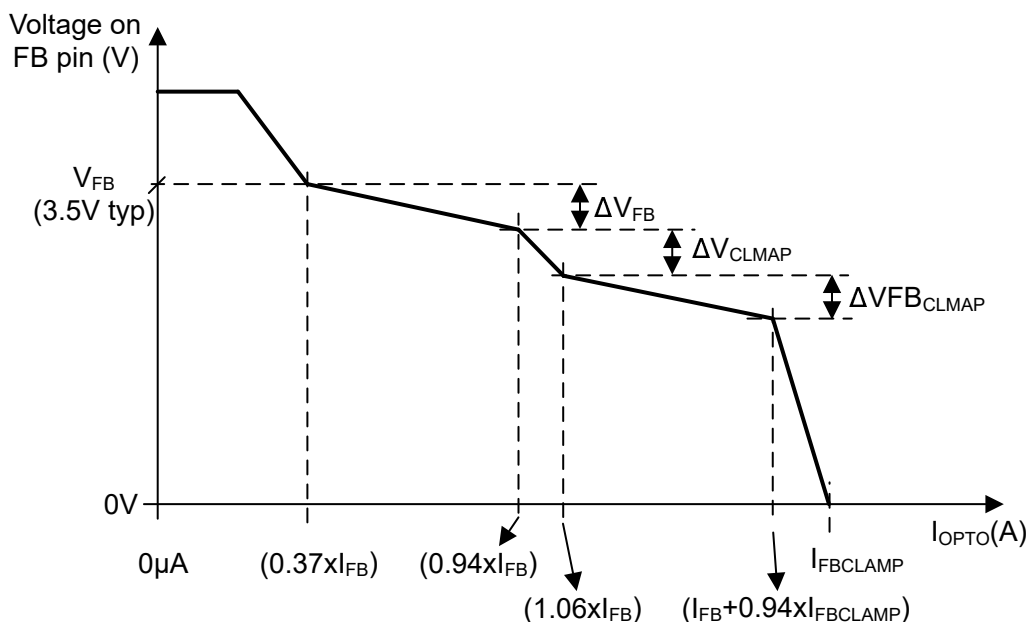


图 7-7. FB 引脚电压与 FB 引脚电流间的关系

7.3.4 自适应死区时间

UCC25661x 系列实现有一个高速低延迟压摆率检测块，用于优化高侧和低侧脉冲之间的死区时间。自适应死区时间块可调整死区时间，防止发生击穿和体二极管过度导通。

自适应死区时间块的核心是压摆率检测器块，该检测器块能够检测高达 200V/ns 的压摆率，这使得 UCC25661x 系列非常适合用于高频谐振转换器。

在突发模式下的 ZCS 预防运行期间，或在压摆率可能较慢的功率级中，谐振回路电流极性信号 (Ipolarity 比较器输出) 用于增强压摆率检测器。

利用 LLC 的自然对称操作，压摆率检测器仅确定高侧开关关断和低侧开关导通之间的死区时间。此死区时间会被复制，然后应用于低侧 MOSFET 关断和高侧 MOSFET 导通之间的死区时间。有一些例外情况，此时死区时间不会被复制。下面列出了这些情况：

- 在之前的高至低转换中缺少压摆率检测器信号
- 上一周期中的 ZCS 检测

在上述情况下，将使用基于 ISNS 信号的 Ipolarity 比较器，调整低高转换期间的死区时间。

7.3.5 输入电压检测

BLK 引脚输入电压检测用于实现下面列出的多种功能：

- 输入电压过压保护和欠压保护
- 输入前馈 (在节 7.3.1 中说明)
- 输入电压 OVP

7.3.5.1 过压和欠压阈值以及选项

UCC25661x 系列提供可编程的过压和欠压保护阈值。当 BLK 引脚上的电压降至 $V_{BLKStop}$ 以下时，控制器将进入欠压保护状态并停止开关。在欠压保护状态下，会额外导通一个电流阱，以便从 BLK 引脚汲取 I_{BLKHys} 。通过更改从外部连接到引脚的等效电阻，对实际欠压保护电压进行编程。

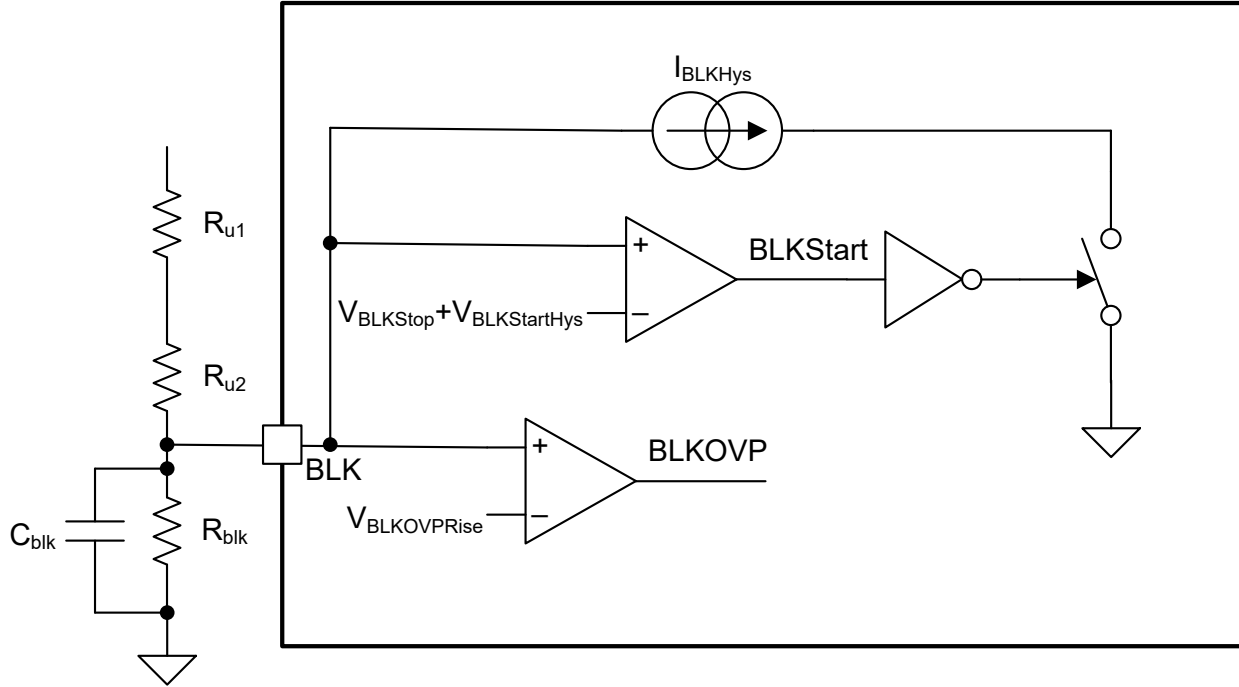


图 7-8. BLK 引脚输入电压检测架构

当检测到欠压保护时，控制器将停止开关。如果 BLK 电压上升到过压保护电压以上，则控制器会立即开始软启动，而不会等待故障空闲时间结束。

7.3.5.2 交流输入过零检测

仅当为 BLK 引脚检测选择交流欠压保护选项时，才会启用输入过零检测。使用该选项时，BLK 引脚会通过电阻分压器检测 HV 引脚电压。预期波形是经过分频的整流交流电压。下面显示了一个示例，其中在 70Vac 输入和 265Vac 输入下使用了 8MΩ 和 100kΩ 作为 BLK 电阻分压器。

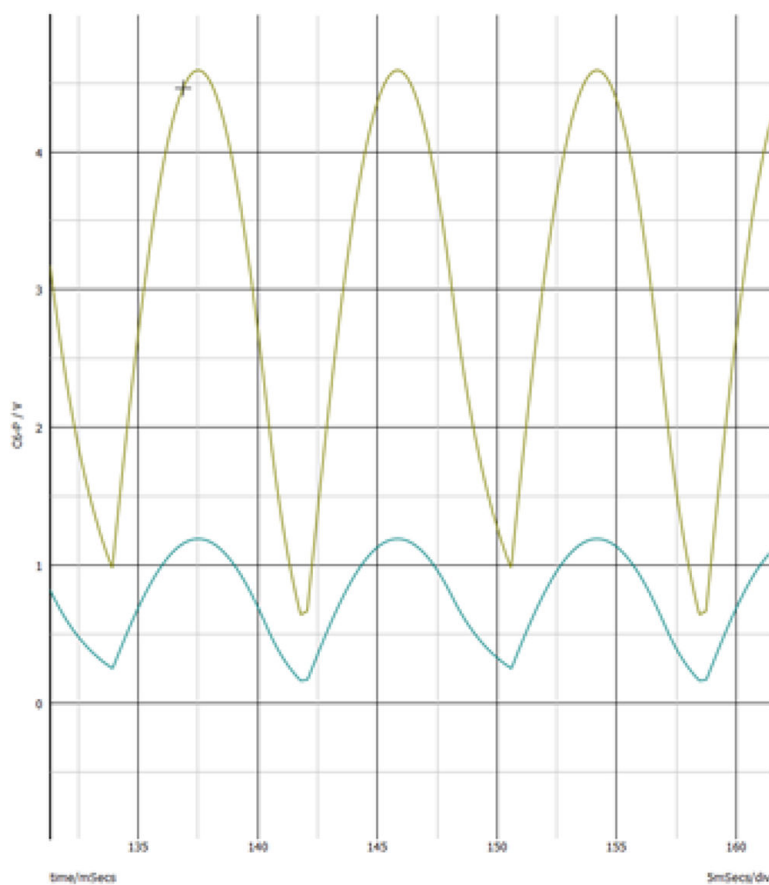


图 7-9. 采用 BLK 引脚的输入交流过零检测

用来确定是否存在交流的方法会使用一个比较器，该比较器将查看瞬时 BLK 电压和 $\frac{1}{2}$ BLK 峰值检测器输出。如果瞬时 BLK 电压降至 $\frac{1}{2}$ 峰值 BLK 电压以下，然后升至 $\frac{1}{2}$ BLK 峰值电压（具有迟滞）以上，则会检测到存在交流。实际上，X 电容器放电算法是在 BLK 比较器输出 (blk_zcd) 上寻找上升沿，以检测是否存在交流电。

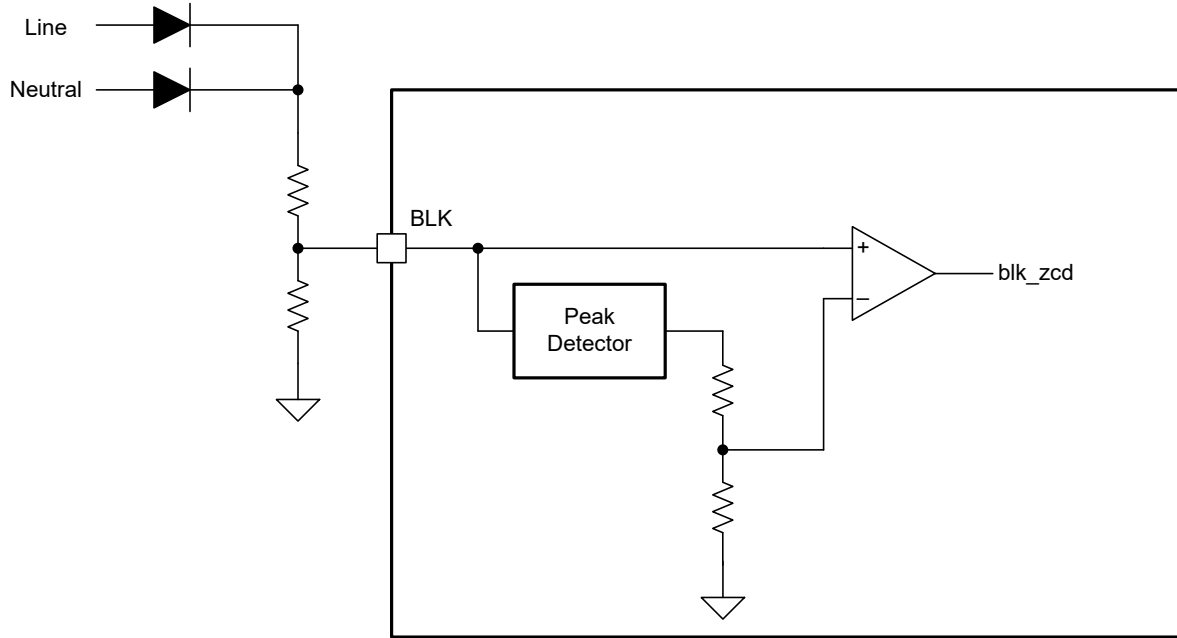


图 7-10. BLK ZCD 检测方框图

7.3.5.3 输出 OVP 和外部 OTP

UCC25661x 系列使用一个多功能引脚 (OVP/OTP) 来监测是否出现输出过压和外部过热情况。偏置绕组上的反射电压和电源电压 VCCP 用于监测输出电压。

VCCP 和 OVP/OTP 引脚之间连接一个齐纳二极管。在正常工作条件下，齐纳二极管不导通，OVP/OTP 引脚电压由 NTC 电阻和 I_{OTP} 拉电流产生。如果 VCCP 升高到足以超过齐纳二极管击穿电压的水平，则 OVP/OTP 引脚上的电压会因齐纳二极管电流而被拉高。如果 OVP/OTP 上的电压超过 $VOVP_{pos}$ 阈值的时间达到 40us，则控制器将检测到故障并停止开关。

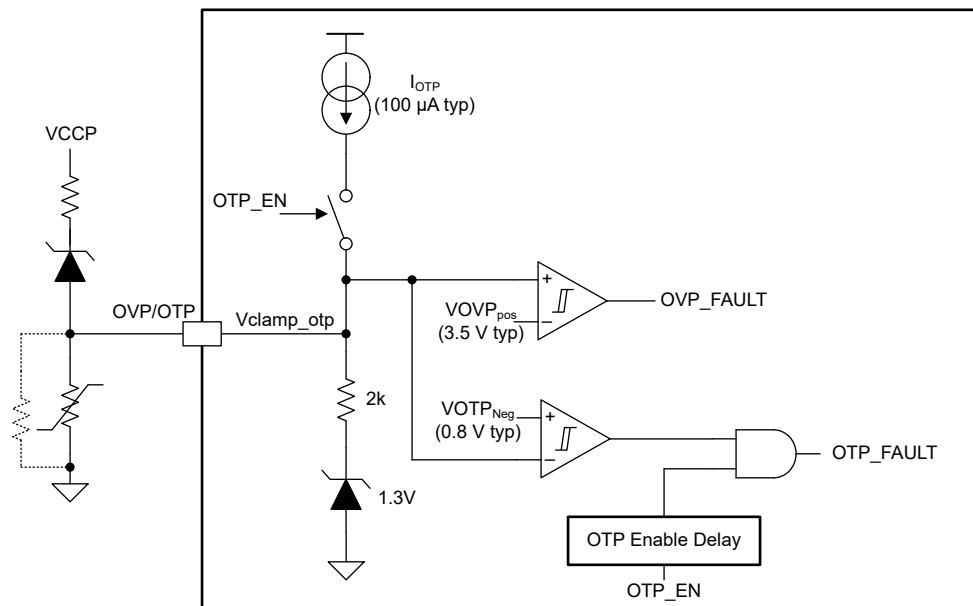


图 7-11. OVP/OTP 保护架构

一个 NTC 从 OVP/OTP 连接到 GNDP。内部电流源 I_{OTP} 从 OVP/OTP 引脚流出并流入 NTC 电阻器。根据 NTC 的温度，引脚上产生的电压会与 V_{OTP_Neg} 进行比较，以便确定是否发生外部过热故障。一旦检测到外部过热保护，UCC25661x 系列就会进入故障状态。在 1s 等待期后，UCC25661x 系列会检查 OVP/OTP 引脚电压。如果 OVP/OTP 引脚电压高于 V_{OVP_Pos} ，UCC25661x 系列会尝试重新启动。如果无法重新启动，UCC25661x 系列将继续在故障空闲状态下等待。在突发模式期间，过热保护会被禁用，以更大限度地减小静态电流。从突发模式转换为正常开关时，OTP 功能将重新启用。

7.3.6 谐振回路电流检测

ISNS 引脚会通过微分器检测谐振回路电流。除了充当过流保护引脚外，ISNS 引脚还是控制功能的必要组成部分。

ISNS 引脚具有以下功能

- 向产生控制电压的积分器输入，用于 IPPC 控制
- OCP (逐周期) 保护
- 谐振电流极性检测
- ZCS 预防和死区时间管理
- 启动时避免反向恢复

7.4 保护功能

7.4.1 零电流开关 (ZCS) 保护

ZCS 保护是 LLC 转换器避免交越进入容性运行区域的一项必要功能。在电容区，MOSFET 可能会因二极管的反向恢复而损坏，这允许两个开关短暂地传导电流。此外，增益与频率关系会在容性区域反转，可能导致转换器完全失去对功率级的调节。ZCS 保护的目标是确保 MOSFET 可以在电流反转之前关断，从而消除 MOSFET 体二极管硬反向恢复的可能性。这可以提高功率级的可靠性。最小关断电流应设置为一定的阈值，这样可以增加在该情况下实现 ZVS 开关或近 ZVS 开关的机会。结合会同时关注压摆完成信号和 IPOL 信号的死区时间引擎，用户可以确认对向 MOSFET 在 V_{DS} 电压的谷点导通，从而实现极低的开关损耗。

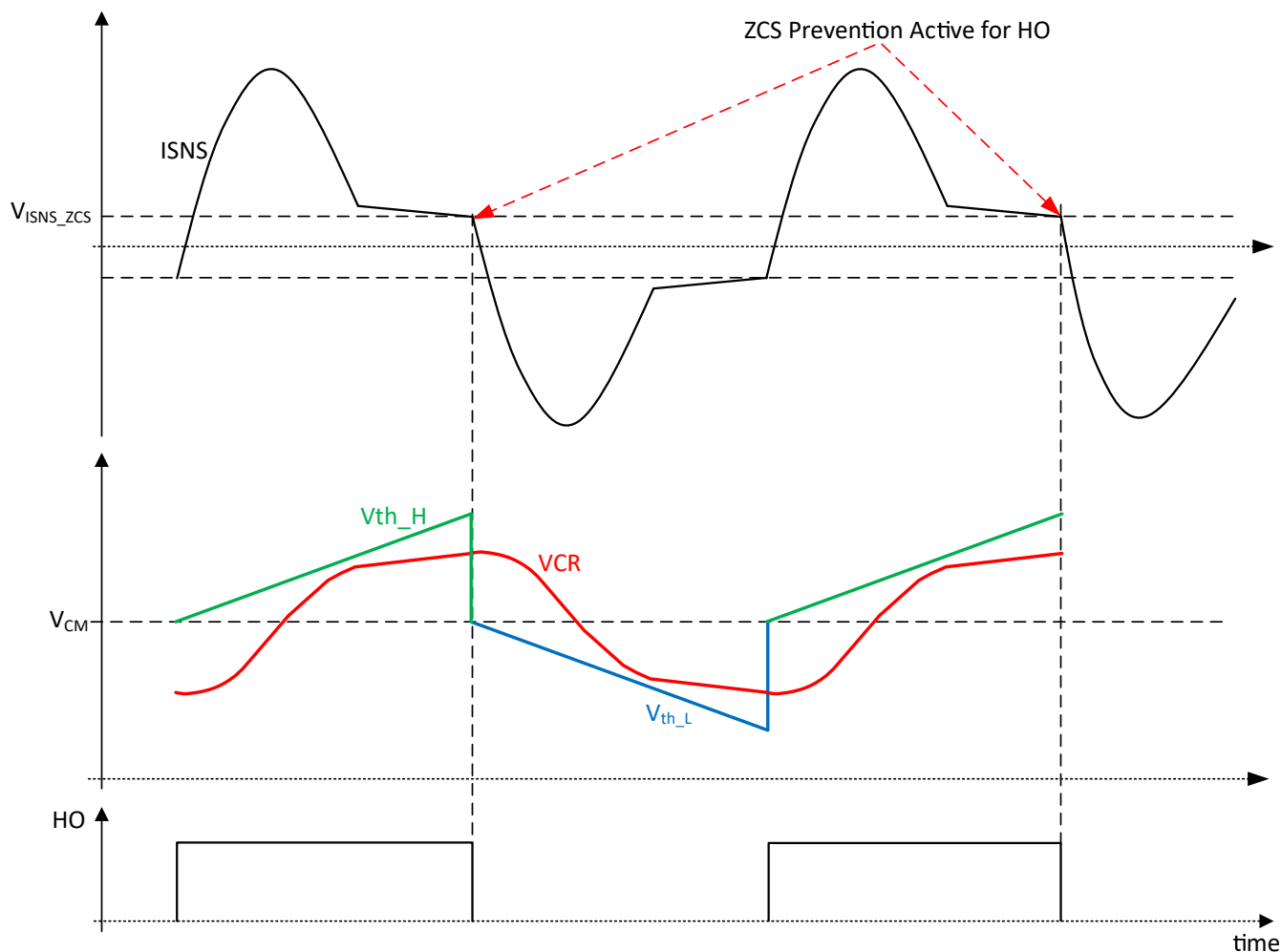


图 7-12. ZCS 保护

当运行接近电感/电容边界时，谐振电流会在栅极关断之前减小。如果 $ISNS$ 波形小于 V_{ISNS_ZCS} 阈值，则栅极脉冲 HO 会提前终止，而不是等待 VCR 波形越过 V_{TH} 边界。这种提前栅极终止方案能够在栅极关断沿产生足够的谐振电流，以便在死区时间内驱动 ZVS 转换。类似的说明同样适用于 LO 栅极脉冲。

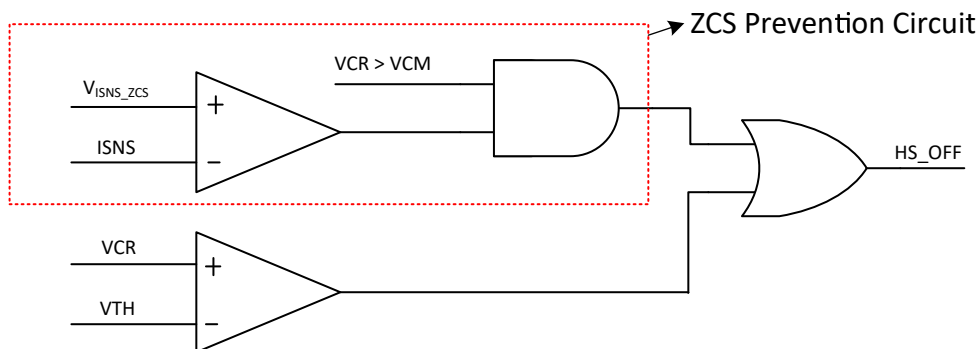


图 7-13. 高侧 MOSFET 导通时的 ZCS 预防方案

谐振电流的形状远低于谐振频率，会对检测谐振电流波形的正确下降沿造成一些挑战。UCC25661x 系列实现有额外的逻辑，用于确保检测 $ISNS$ 信号的正确下降沿，从而避免误跳。为了提高抗噪声稳健性， $ISNS$ ZCS 比较器会在 HO 或 LO 栅极的上升沿被消隐。VCR 比较器和 $ISNS$ ZCS 比较器使用相同的消隐时间。检测到 ZCS 事件

时，内部软启动斜坡电压会缓慢降低。当内部软启动斜降时，开关频率也会被强制增加，从而强制转换器退出容性区域。如果在 **TZCSFault** 期间出现持续 **ZCS** 情况，则 **UCC25661x** 系列控制器会停止开关并进入故障状态。

7.4.2 软启动期间的最小电流关断

启动期间，在前几个开关周期内，初级侧上的 **MOSFET** 可能会经历体二极管反向恢复和硬开关。有这样的经历主要是因为在启动时，谐振电容器的直流偏置电压可能与稳态工作电压 $V_{in}/2$ 偏离。这会导致启动时谐振回路电流不对称。在前几个周期中，不对称可能足够高，以至于开关关断点的电流极性错误。

例如，请参阅图 7-14。

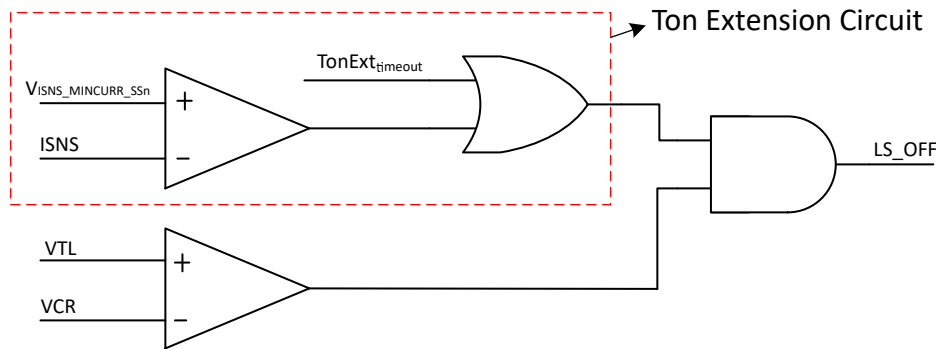


图 7-14. Ton 延长方案

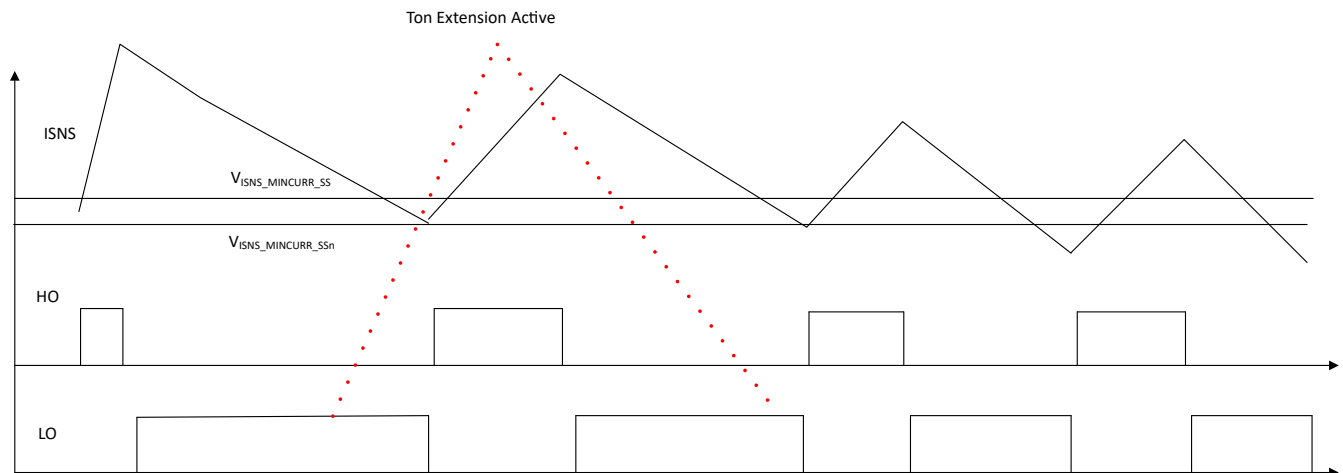


图 7-15. 启动期间的 ZCS 预防

7.4.3 逐周期电流限制和短路保护

UCC25661x 系列中的 **OCF** 和逐周期电流限制功能可针对短路进行快速 ($<50\text{ns}$) 响应。逐周期保护有助于限制功率级中的峰值应力。当 **ISNS** 电压变成大于 V_{ISNS_OCP} 时，当前 **HO** 栅极脉冲将被终止。相应地，在第二半个周期内，当检测到相应的过流限时，当前 **LO** 脉冲将被终止。如果连续 7 个开关周期 (n_{OCP}) 检测到 **OCF**，则器件将进入故障状态。在启动期间，如果在 50 个连续开关周期 (n_{OCP_ss}) 检测到 **OCF** 条件，则器件将进入故障状态。

7.4.4 过载 (OLP) 保护

带有前馈的 **IPPC** 在 **Pout** 与内部控制信号 **FBReplica** 之间建立了很强的相关性。

当 **FBReplica** 高于 V_{FBOLP} (例如， I_{opto} 减少到 $0\mu\text{A}$) 时，系统开始限制输入功率，并且 **OLP** 计时器计数会增加。如果 **FBReplica** 持续高于 V_{FBOLP} 的时间 $>(T_{OLP})$ ，则会检测到 **OLP** 故障，并且系统进入故障重启序列。

7.4.5 VCC OVP 保护

VCCP 引脚上的内部限流钳位可保护 VCCP 引脚，当施加到 VCCP 引脚的电压超过最大建议电压时，可以对栅极驱动输出电压进行钳位。该钳位具有最大灌电流 I_{VCC_Clamp} 。如果通过 VCC Shunt 的电流超过 I_{VCC_Clamp} ，会导致 VCCP 引脚电压进一步升高至超过 VCC_OV。如果发生这种情况，UCC25661x 会进入故障状态，并在 1 秒故障空闲时间后重试。

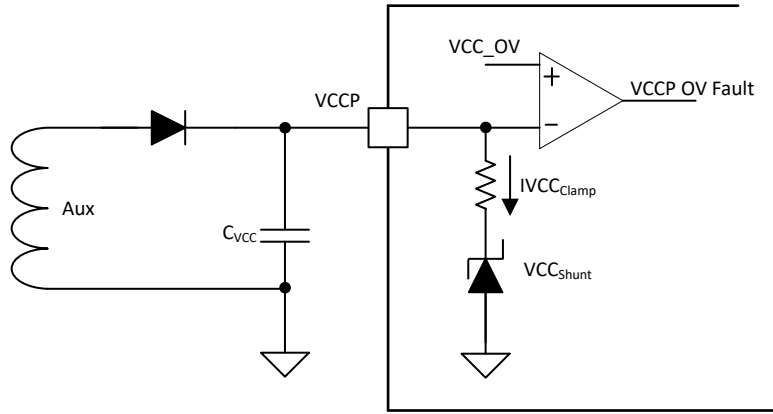


图 7-16. VCC 钳位

7.5 器件功能模式

7.5.1 启动

7.5.1.1 具有 HV 启动

7.5.1.1.1 首次启动序列

1. 当插入交流电源时，会在 HV 引脚上施加电压。如果 VCCP 电压低于 V_{CC_Short} ，VCCP 引脚通过 $I_{VCC_Charge_Low}$ 充电。如果 VCCP 电压高于 V_{CC_Short} ，VCCP 引脚通过 $I_{VCC_Charge_High}$ 充电。
2. 当 VCCP 电压高于 V_{CC_UVLOr} 时，内部 LDO 会调节 V5P 电压，直到完成器件初始化。
3. 建立 V5P。LL 引脚和 TSET 引脚用于突发模式和内部 VCR 合成器编程。
4. 如果启用 HV 启动选项，则 TSET 引脚会输出高电平（表示 PFC 关闭），防止 PFC 在 VCCP 完全建立之前导通。
5. 当 VCCP 高于 $V_{CC_StartSelf}$ 时，HV 充电电流会停止。LLC 启动过程开始。TSET 电压会保持在 1V 以下，以便允许 PFC 启动。
6. 在第 3 阶段和第 4 阶段，如果 VCCP 电压降至 $V_{CC_ReStartJfet}$ 以下，则 HV 充电电流会再次启用，并且会通过 $I_{VCC_Charge_High}$ 对 VCCP 进行充电。
7. 一旦 LLC 完成启动，HV 充电电流就会被禁用，直到 VCCP 降至 $V_{CC_ReStartJfet}$ 以下。
8. 在正常运行期间，如果 VCCP 电压低于 $V_{CC_StopSwitching}$ ，则会发生故障且 UCC25661x 系列关断。然后，按照正常的重启序列运行。

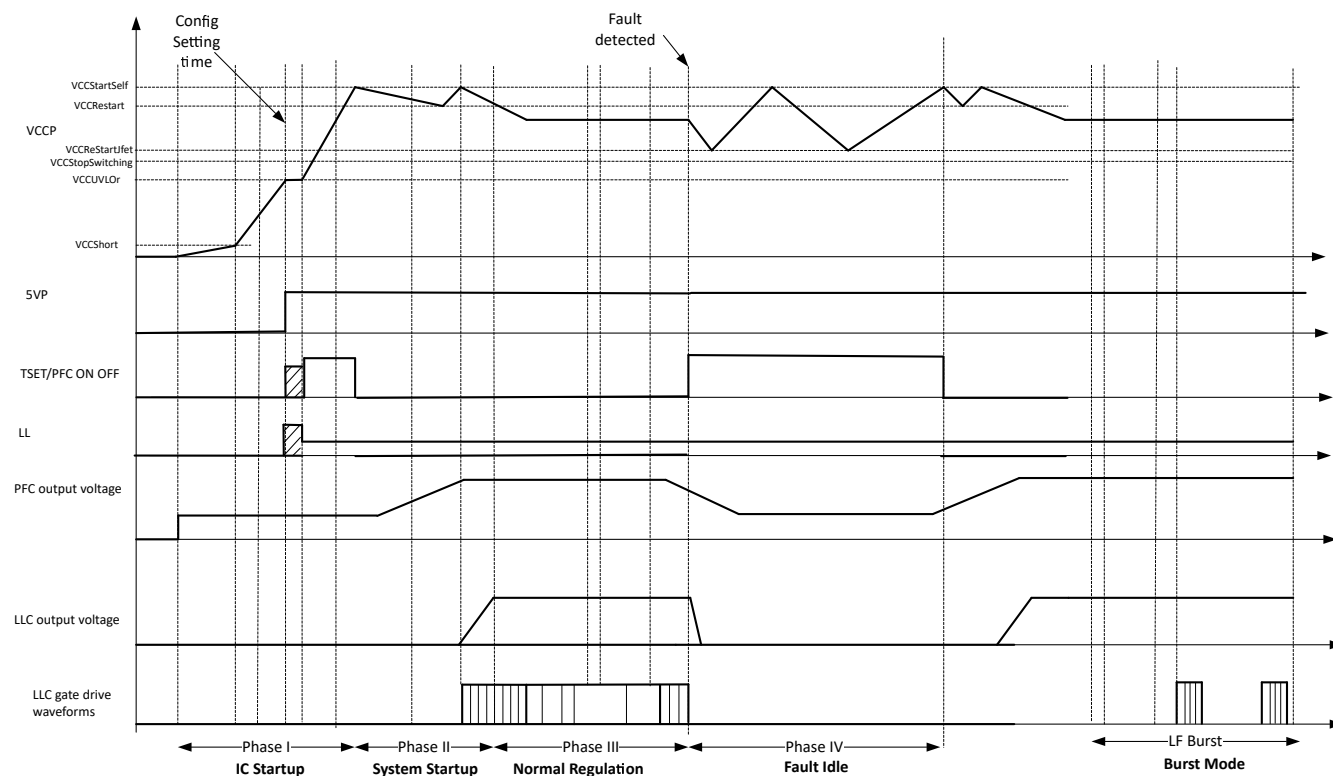


图 7-17. 启用“HV 启动”功能时的启动顺序

7.5.1.1.2 重启序列

1. 检测到故障后，UCC25661x 系列会关断。对于故障重试模式，在 1s 空闲时间后，UCC25661 会重试（当 VCCP 仍高于 VCC_{UVLOr} 时，TSET 会输出高电平）。
2. 如果 VCCP 电压低于 VCC_{Short} ，VCCP 引脚通过 $I_{VCC_Charge_Low}$ 充电。如果 VCCP 电压高于 VCC_{Short} ，VCCP 引脚通过 $I_{VCC_Charge_High}$ 充电。如果 VCCP 引脚电压高于 $VCC_{StartSelf}$ ，则不会启用 HV 启动（跳过阶段 I）。建立 5VP 并释放 LL 引脚，以用于突发模式编程。

7.5.1.2 无 HV 启动

当禁用 HV 启动时，PFC 开/关信号也会被禁用。启动序列如下：

1. 当 VCCP 电压高于 VCC_{UVLOr} 时，建立 5VP
2. LL 引脚和 TSET 引脚用于突发模式和内部 VCR 积分器编程。
3. 当 VCC 降至 VCC_{UVLOr} 以下时，5VP 关闭且系统关断。

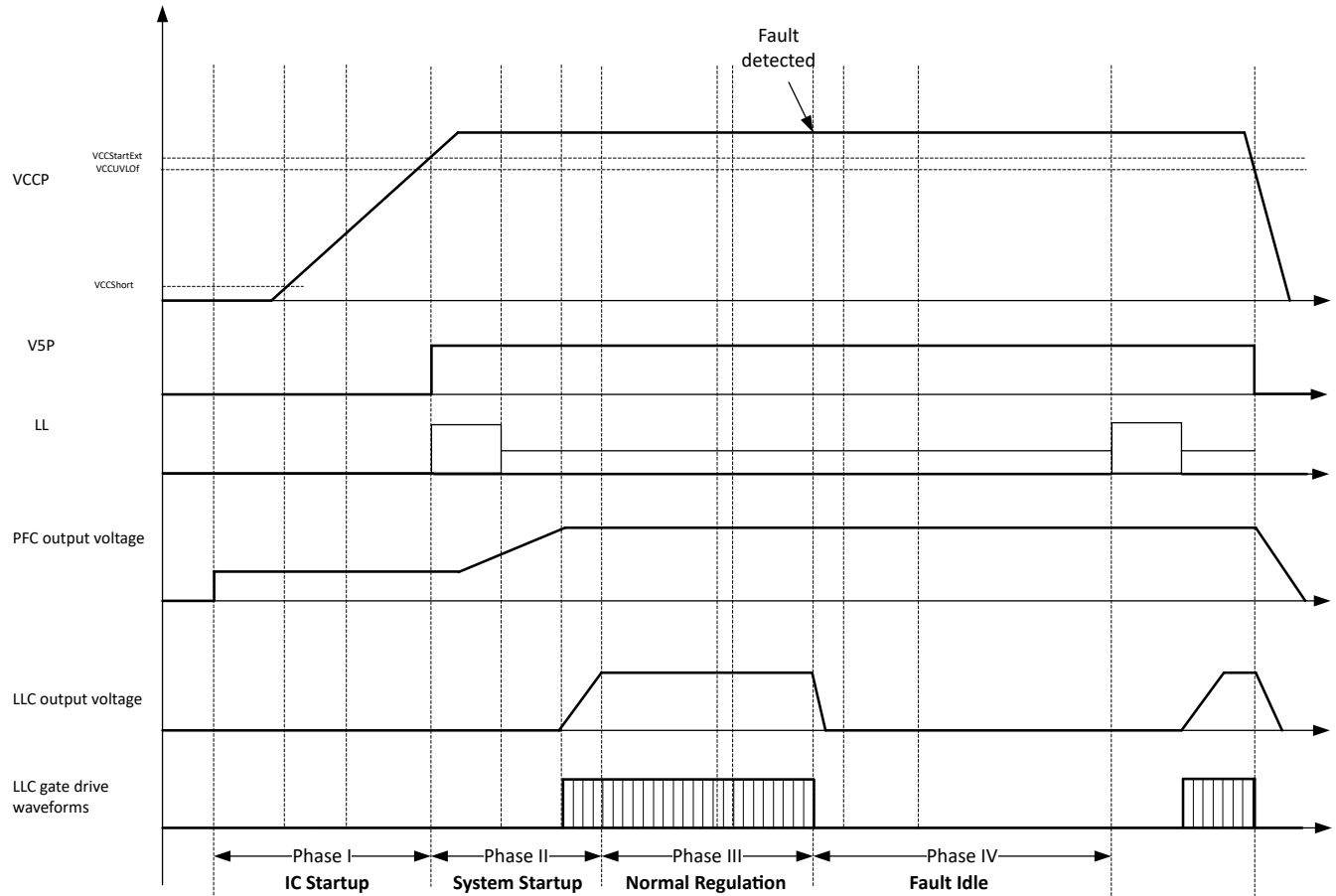


图 7-18. 禁用“HV 启动”功能时的启动顺序

7.5.2 软启动斜坡

UCC25661x 系列内部会生成软启动斜坡。内部会生成一个固定的最大软启动时间 25ms，以减少启动时的浪涌电流，同时允许输出电压快速斜升。

7.5.2.1 启动到调节的转换

UCC25661x 系列采用了新的软启动，以控制启动时的浪涌电流。新方案有助于避免任何过早软启动终止，并确保软启动和闭环调节之间的平滑过渡。

启动时，内部软启动电压 (*SSRamp*) 使用定义的斜率斜升，由于输出电压低于调节电压，因此 *FBReplica* 为高电平。选择低电平块会识别这两个信号，并使用两者中较低的信号来控制功率级开关的关断。

仅当 *SSRamp* 高于最小阈值时才会退出软启动，从而避免任何软启动过早退出问题，如图 7-19 中所示。

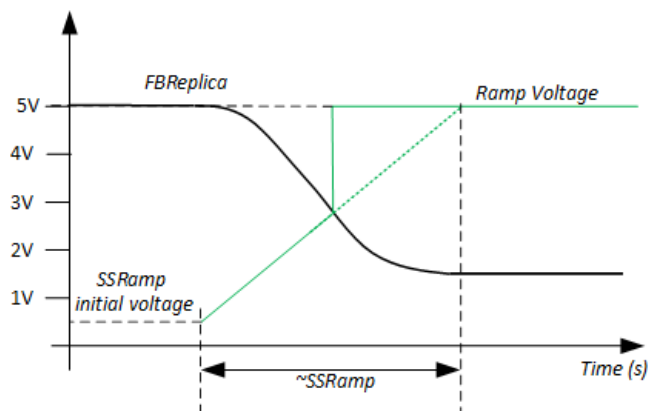


图 7-19. 软启动运行

7.5.3 轻负载管理

7.5.3.1 工作模式 (突发模式)

UCC25661x 系列突发模式算法可更大限度降低可闻噪声，同时提高轻负载效率。具体实现方式是，将突发包频率保持在可闻范围以上 ($>25\text{kHz}$)，或保持在可闻频率范围的低端 ($<400\text{Hz}$)。UCC25661x 系列采用两种突发模式：高频 (HF) 脉冲跳跃和低频 (LF) 突发。

HF 突发包中包含固定数量的 LO 和 HO 脉冲。HF 突发的目的是保持突发频率高于可闻频率范围。在下图中，开关节点第 2 个谷底上启用了低侧栅极，以开始传送下一个 HF 突发包。

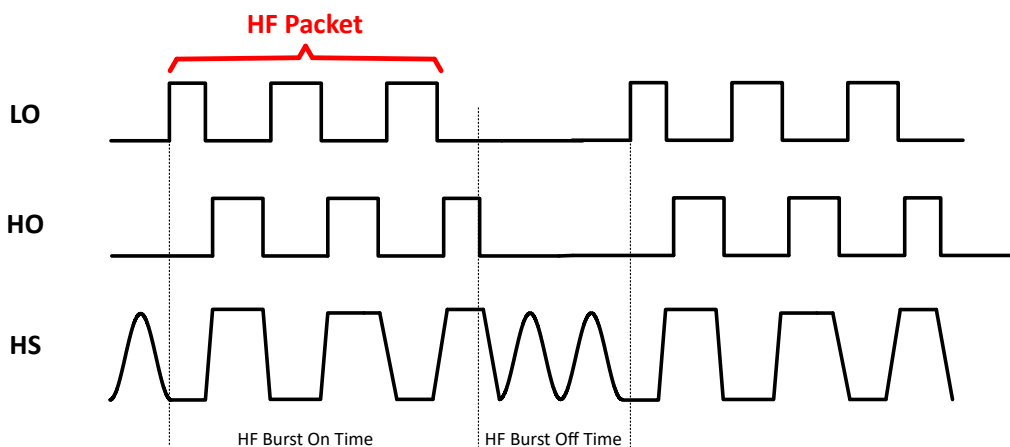


图 7-20. 高频脉冲跳跃包

LF 突发包包括多个 HF 突发包和一个 LF 突发关闭周期。

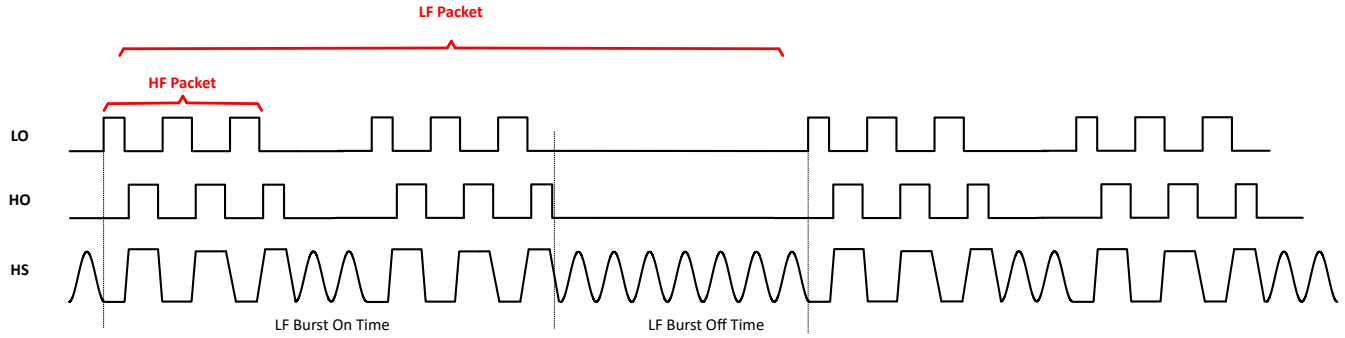


图 7-21. 低频突发包

需要计算 HF 突发包的数量，以便将 LF 突发频率保持在一定的频率范围内。内部提供了一组目标频率范围，默认选项是将 LF 突发调节在 200Hz 左右。

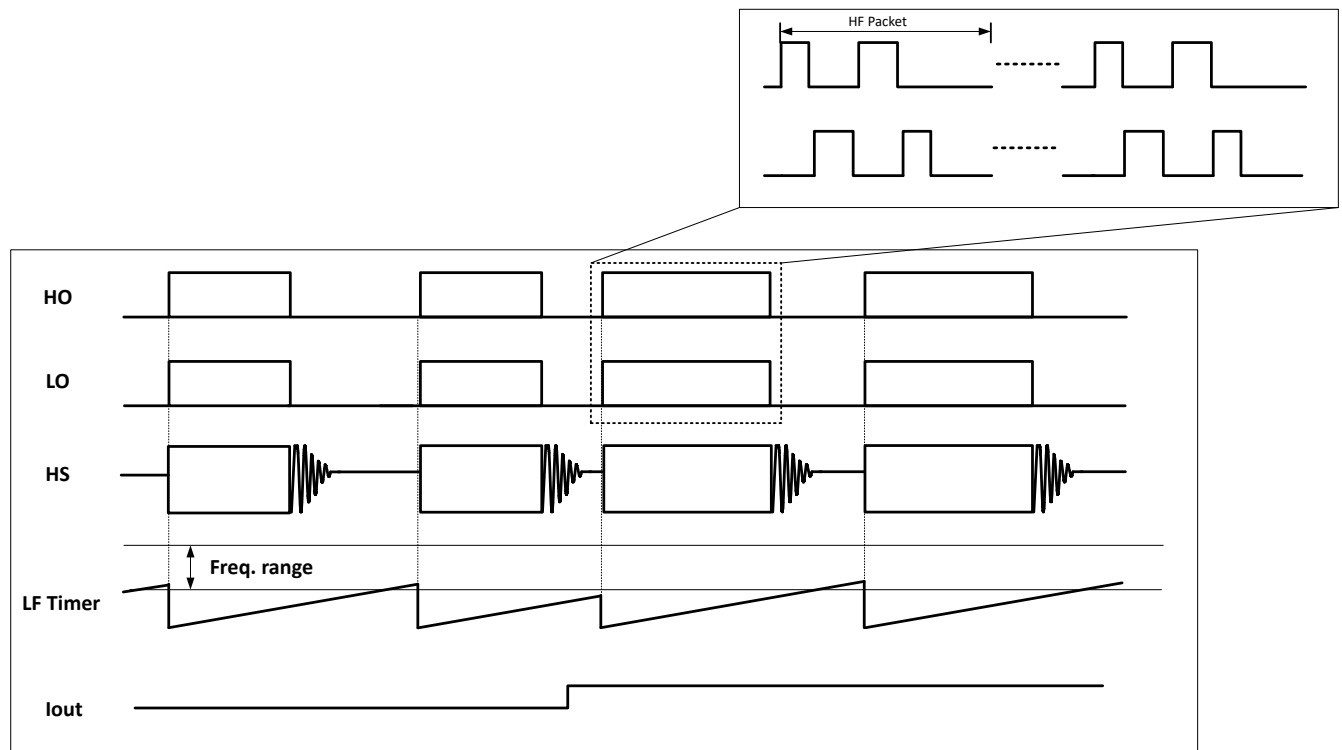


图 7-22. LF 突发中的包大小调节

7.5.3.2 模式转换管理

使用 LL 引脚，用户可以配置 UCC25661x 系列进入 HF 脉冲跳跃和 LF 突发模式时的功率级别。可以设置的两个阈值是 *HFBurstEntry* 和 *LFBurstttEntry*。有关如何配置功率级别的详细信息，请参见节 7.5.3.3。

图 7-23 描述了 UCC25661 在突发模式下的进入和退出行为。

- *HFBurstEntry* 对应所需功率级别下的 *FBReplica* 电压，此时系统会进入 HF 脉冲跳跃模式。
- *LFBurstEntry* 对应修正后的 *FBReplica* 电压，此时系统会进入 LF 突发模式。
- 当 *FBReplica* 高于 *HFBurstEntry* 时，UCC25661x 系列以正常开关状态运行。
- 当 *FBReplica* 小于 *HFBurstEntry* 但大于 *LFBurstEntry* 时，UCC25661x 系列以 HF 脉冲跳跃模式运行。在 HF 脉冲跳跃模式下，每个包中的能量仍由控制信号 *FBReplica* 控制。

- 当 $FBReplica$ 小于 $LFBurstEntry$ 时，UCC25661x 系列以 LF 突发模式运行。在 LF 突发模式下，每个包中的能量固定在 $LFBurstEntry$ 阈值。
- 在以 LF 突发模式运行时，当 $FBReplica$ 升至 $LFBurstEntry$ 阈值以上时，会启动一个新的 LF 突发段。当传送完所需数量的包并且 $FBReplica$ 低于 $PacketStop$ 阈值时，段会被终止。
- 需要计算 LF 突发段中所需的包数量，以便将 LF 突发工作频率调节在 200Hz 至 400Hz 范围内。
- 如果负载突然下降，则 LF 突发段会被立即终止，以避免出现输出过压情况。
- 进入 LFBurst 后，会连续计算 $LFBurstExit$ 和 $HFBurstExit$ 阈值。方程式 7 和方程式 8 对此进行了说明。
- 当 $FBReplica$ 升至高于 $LFBurstExit$ 时，UCC25661x 系列恢复在 HF 突发模式下的工作。
- 当 $FBReplica$ 升至高于 $HFBurstExit$ 时，UCC25661x 系列退出 HFBurst 并进入正常开关。
- 每次控制器退出 HFBurst 时，都会增加 2ms 的消隐时间，以确保控制器不会重新进入突发模式。在消隐期间，如果 $FBReplica$ 低于 $PacketStop$ 阈值，控制器会再次进入 LFBurst。

$$LFBurstExit = LFBurstEntry \times \frac{(LF \text{ Burst On Time} + LF \text{ Burst Off Time})}{(LF \text{ Burst On Time})} \quad (7)$$

$$HFBurstExit = HFBurstEntry \times \frac{(HF \text{ Burst On Time} + HF \text{ Burst Off Time})}{(HF \text{ Burst On Time})} \quad (8)$$

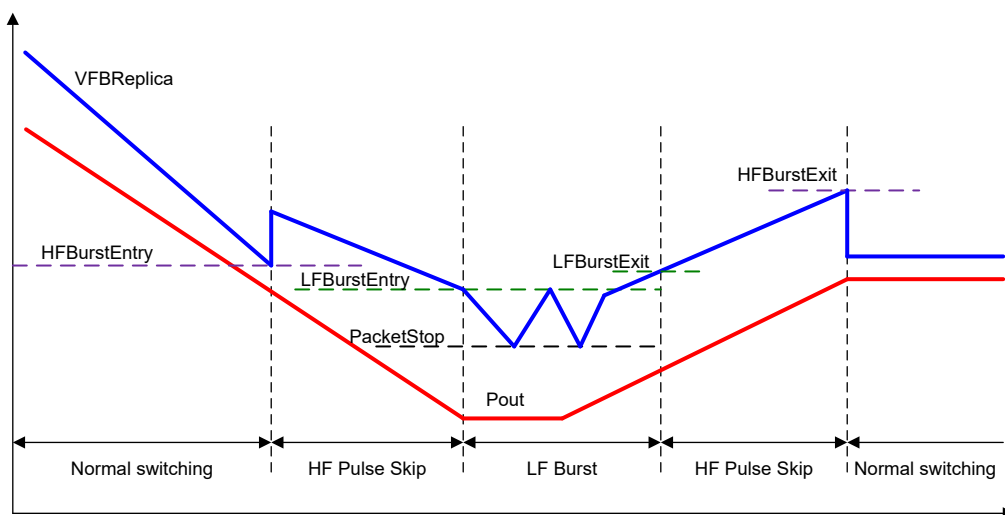


图 7-23. 通过 $FBReplica$ 比较器确定突发模式

7.5.3.3 突发模式阈值编程

突发模式阈值编程通过 V5P 与 GNDP 之间连接的外部电阻分压器进行设置。将外部分压器的中心节点连接到 LL 引脚。在编程阶段，恒定电流 I_{LLPrgm} 会被馈送到 LL 引脚，所产生的电压通过 ADC (V_{LLA}) 在 T_{LLPrgm} 时间处测量。在 T_{Prgm} 之后， I_{LLPrgm} 被关断，并测量 LL 电阻分压器的电压 (V_{LLB})。

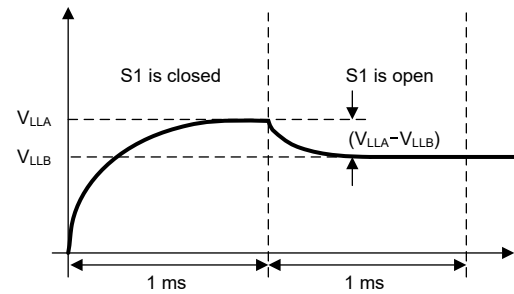
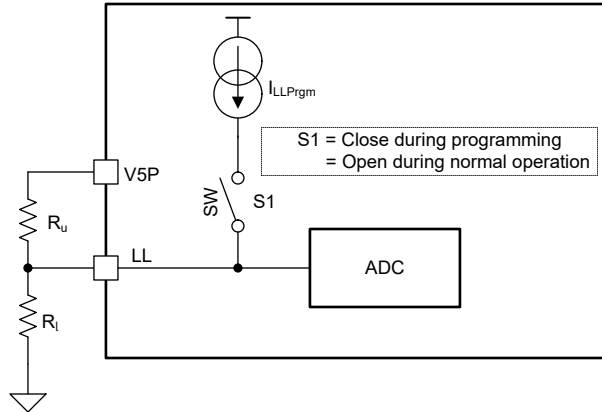


图 7-24. LL 引脚编程

开关 S1 关断后 LL 引脚上的电压 (V_{LLB}) 直接用于设置相应的输入功率，在该输入功率下，系统会停止 LF 突发段 ($PacketStop = V_{LLB}$)。

根据测得的 V_{LLB} 电压和 V_{LLA} 与 V_{LLB} 之间的电压差确定控制器进入 HF 突发时的 $FBReplica$ 电压。有关更多详细信息，请参阅[设计计算器](#)。

控制器启动 LF 突发段时的 $FBReplica$ 使用[方程式 9](#)得出。

$$LFBurstEntry = PacketStop \div 0.6 \quad (9)$$

$HFBurstexit$ 和 $LFBurstexit$ 阈值分别存在来自 $HFBurstentry$ 和 $LFBurstentry$ 的迟滞。两个迟滞不是用户定义的参数。这两个迟滞是根据转换器的工作点在内部动态估算。

通过对 ($V_{LLA} - V_{LLB}$) 进行适当编程，可以禁用突发模式功能。

表 7-4. 突发模式外部可编程设置

($V_{LLA} - V_{LLB}$) (V)	$a = (PacketStop \div HFBurstEntry)$ RATIO	注释
> 2.41	不适用	突发禁用
2.185	0.45	LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz
1.754	0.50	LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz
1.391	0.55	LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz
1.087	0.60	LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz
0.833	0.65	LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz
0.617	0.70	LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz
0.441	0.75	LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz
0.176	0.80	LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz

由于能够直接设置系统进入各种低功耗模式时的输入功率，并动态禁用突发模式，将会在系统设计上获得额外的自由度。

7.5.3.4 突发模式下的 TSET 引脚交替功能

7.5.3.4.1 PFC 开/关

在 UCC256614 中, TSET 引脚可用作 PFC 开/关逻辑。在初始编程阶段之后, TSET 将成为一个应该用于驱动小信号 MOSFET (例如 2N7002) 的逻辑输出引脚。当 UCC256614 进入 LF 突发模式时, PFC 开/关信号会变为高电平。当控制器退出 LF 突发模式时, TSET 引脚电压会变低。这可用于关断 PFC 或调整 PFC 控制器上的突发模式阈值, 以启用低待机功耗模式。

7.5.3.4.2 强制突发模式

在 UCC256610 中, 低频突发模式具有软启动和软关断波形整形。这可实现低可闻噪声待机模式。在没有强制突发模式的情况下, 若负载小幅增加, 控制器可能频繁退出突发模式、恢复正常开关操作, 随后又再次进入突发模式。由额外的软启动和软关断包导致的这种频繁的模式跳跃会增加可闻噪声。

要避免这种情况, 在 UCC256610 中, TSET 引脚在启动后用作输入引脚。通过将 TSET 下拉至低电平 (至 GND), 控制器保持低频突发模式运行, 并对突发包进行软启动和软关断整形。这样就能够的低可闻噪声模式下持续运行。一旦 TSET 引脚从下拉状态释放, 控制器就会根据负载条件恢复工作模式。

7.5.3.5 软开/关

当启用软开/关时, LF 包中的第一个和最后两个 HF 包会使用较低的电压作为开关阈值。

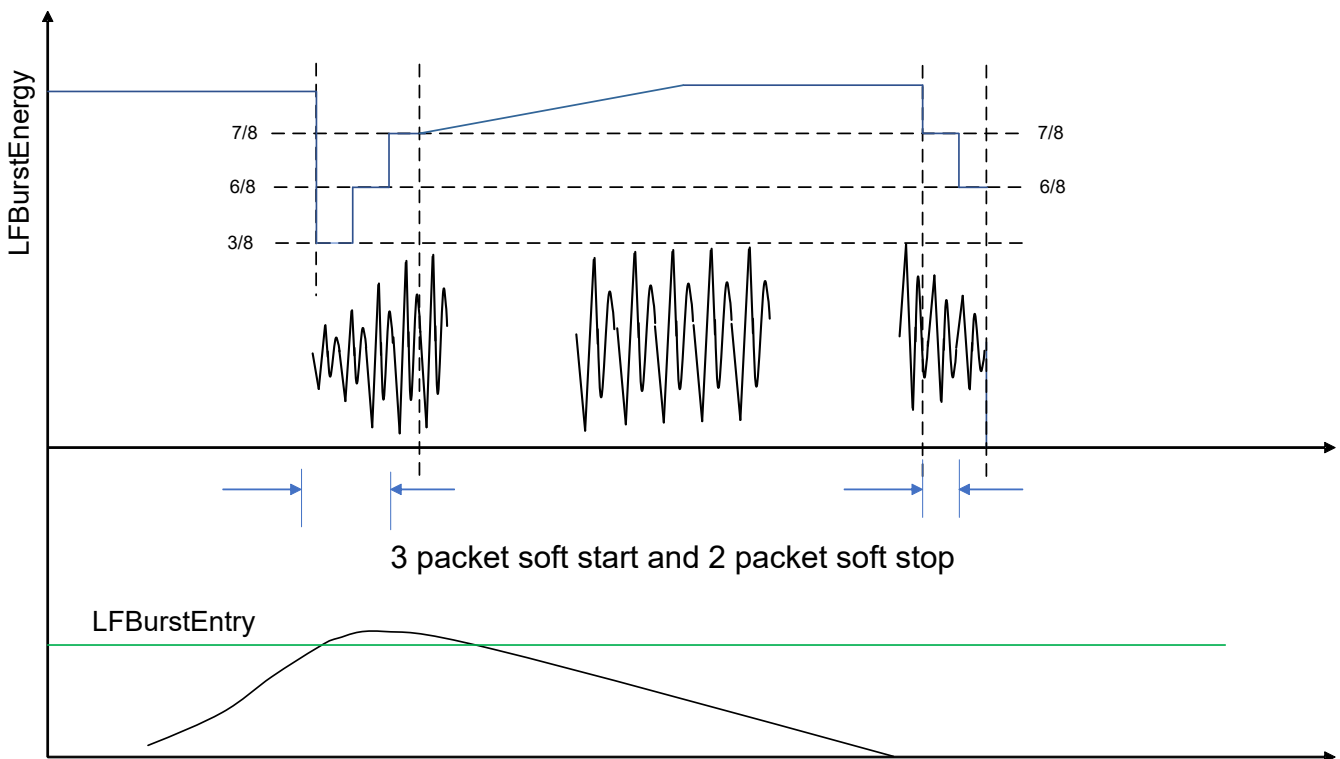


图 7-25. 软开和软关下的低频突发包

7.5.4 X 电容器放电

HV 引脚用于交流存在性检测和 X 电容器放电。

7.5.4.1 仅通过 HV 引脚进行检测

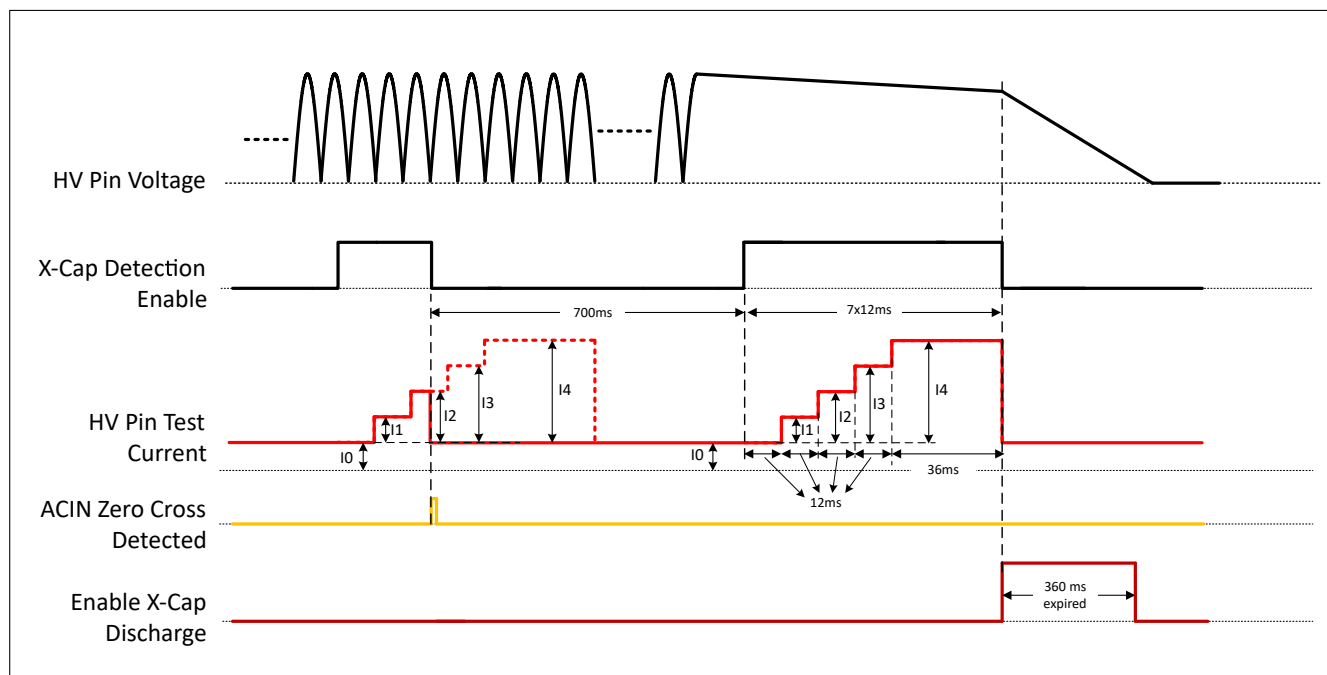


图 7-26. 过零检测序列仅 HV 引脚

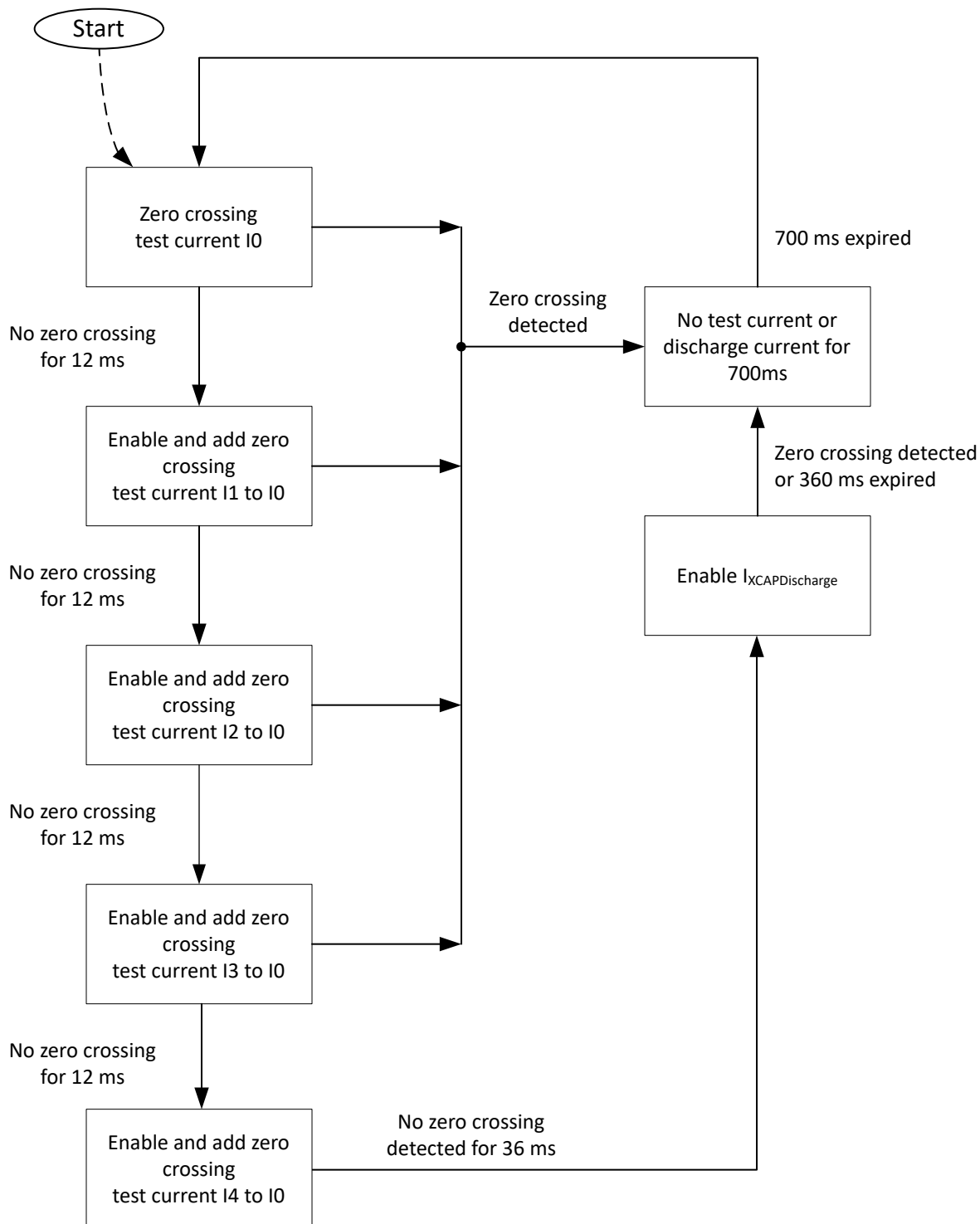


图 7-27. 交流 ZCD 和 X 电容器放电流程图

1. 每经过 700ms，HV 引脚过零检测电路就会接通一次。
2. 起初，HV 引脚测试电流为 I0，持续时间为 12ms。检查 HV 引脚电压，查看该电压是否小于 9V 阈值
3. 如果 HV 引脚电压未降至 9V 以下，则添加测试电流 I1 至 I0，然后再次检查 HV 引脚电压是否低于 9V 阈值
4. 如果 HV 引脚电压仍未降至 9V 以下，则继续增大和添加测试电流至 I2，然后将 I3、I4 添加至 I0。
5. I4 测试电流的最大导通时间为 36ms

6. 如果即使在增至 I4 之后 HV 引脚电压也未降至 9V 以下，则 X 电容器放电电路将启用 360ms。
7. 两个测试电流事件之间的最小间隔为 700ms

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

8.1 应用信息

UCC25661x 系列可用于广泛采用 LLC 拓扑的应用中。为便于使用，请使用以下物料清单演示器件的特性：

- 全功能 EVM 硬件
- Excel 设计计算器
- Simplis 模型

在接下来的部分中，将介绍一个典型的设计示例。

8.2 典型应用

图 8-1 显示了使用 UCC256611 作为控制器的典型半桥 LLC 应用。

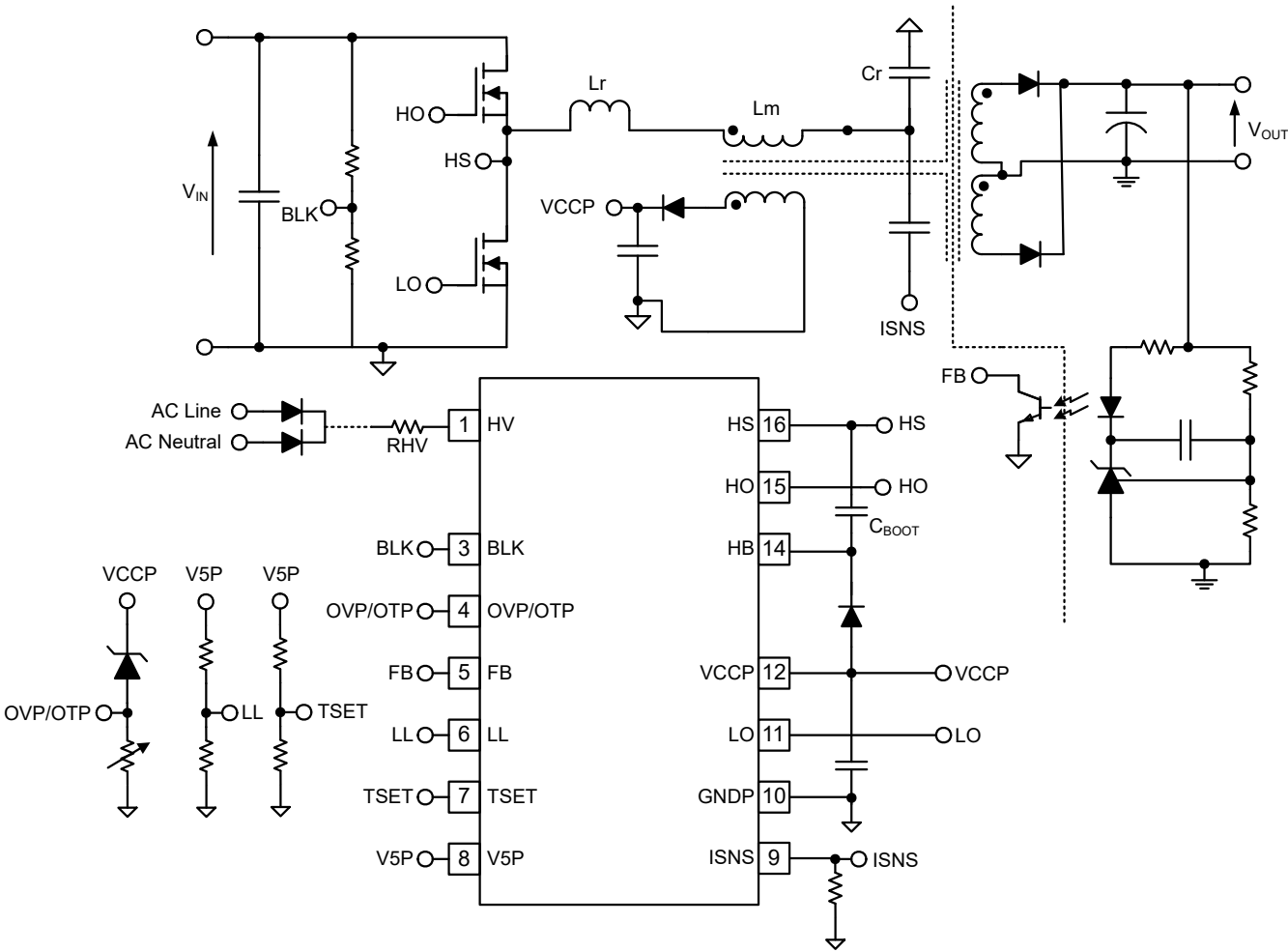


图 8-1. 典型应用图

8.2.1 设计要求

表 8-1 中概述了设计规格。

表 8-1. 系统设计规格

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入特性					
DC 电压范围		365	390	410	VDC
AC 电压范围		85		264	VAC
交流电压频率		47		63	Hz
输入直流 UVLO 导通			365		VDC
输入直流 UVLO 关断			315		VDC
输出特性					
输出电压, VOUT	无负载至满负载		12		VDC
输出负载电流, IOUT	360VDC 至 410VDC			15	A
输出电压纹波	390VDC 且满负载 = 15A		120		mVpp
系统特性					
谐振频率			100		kHz
峰值效率	390VDC		92		
工作温度	自然对流		25		°C

8.2.2 详细设计过程

8.2.2.1 LLC 功率级要求

开始设计时, 首先应设定 LLC 功率级元件值。此处概述的 LLC 功率级设计过程遵循应用手册 [设计 LLC 谐振半桥功率转换器](#) 中规定的过程。该应用手册包含对所用各个公式的来源的完整解释。下方的公式基于分析 LLC 拓扑时常用的一次谐波近似 (FHA) 方法。该方法是任何设计的一个良好起点, 但最终设计需要采用结合了 FHA 结果、电路模拟和硬件测试的迭代方法。另一种设计方法请参见 [UCC29950 的 LLC 设计应用手册](#)。

8.2.2.2 LLC 增益范围

首先, 通过标称输入和输出电压确定变压器匝数比。

$$N_{PS} = \frac{V_{IN(nom)} \div 2}{V_{OUT(nom)}} = \frac{390 \div 2}{12} = 16.25 \Rightarrow 16.5 \quad (10)$$

然后确定 LLC 增益范围 $M_{G(min)}$ 和 $M_{G(max)}$ 。假设由于其他损耗 (V_{loss}) 而存在 0.5V 损失, 如果不使用同步整流器, 整流二极管 (V_f) 中会出现 0.5V 的压降。

$$M_{G(min)} = N_{PS} \frac{V_{OUT(min)} + V_f}{V_{IN(min)} \div 2} = 16.5 \frac{12 + 0.5}{410 \div 2} = 1.006 \quad (11)$$

$$M_{G(max)} = N_{PS} \frac{V_{OUT(max)} + V_f + V_{loss}}{V_{IN(min)} \div 2} = 16.5 \frac{12 + 0.5 + 0.5}{365 \div 2} = 1.175 \quad (12)$$

8.2.2.3 选择 L_n 和 Q_e

L_N 是磁化电感和谐振电感之比。

$$L_N = \frac{L_M}{L_R} \quad (13)$$

Q_E 是谐振回路的品质因数。

$$Q_E = \frac{\sqrt{L_R \div C_R}}{R_E} \quad (14)$$

在方程式 14 中, R_E 是等效负载电阻。

选择 L_N 和 Q_E 值会产生一个 LLC 增益曲线, 该曲线将与 $M_{G(\min)}$ 和 $M_{G(\max)}$ 线迹相交。结果曲线的峰值增益大于 $M_{G(\max)}$ 。此处不讨论如何选择 L_N 和 Q_E 的详细信息, 这些信息可以在[设计计算器](#)中找到。

所选择的 L_N 和 Q_E 值是:

- $L_N = 6$
- $Q_E = 0.3$

8.2.2.4 确定等效负载电阻

通过 方程式 15 确定等效负载电阻。

$$R_E = \frac{8 \times N_{PS}^2}{\pi^2} \times \frac{V_{OUT(nom)}}{I_{OUT(nom)}} = \frac{8 \times 16.5^2}{\pi^2} \times \frac{12}{15} = 176.5\Omega \quad (15)$$

8.2.2.5 确定 LLC 谐振电路的元件参数

确定谐振回路元件参数之前, 选择标称开关频率 (谐振频率)。在此设计中, 选择 100kHz 作为谐振频率。

- $f_0 = 100\text{kHz}$

使用 方程式 16、方程式 17 和 方程式 18 计算谐振回路参数。

$$C_R = \frac{1}{2\pi \times Q_E \times f_0 \times R_E} = \frac{1}{2\pi \times 0.3 \times 100\text{kHz} \times 176.5\Omega} = 30.0\text{nF} \quad (16)$$

$$L_R = \frac{1}{(2\pi \times f_0)^2 C_R} = \frac{1}{(2\pi \times 100\text{kHz})^2 \times 30.0\text{nF}} = 84.4\mu\text{H} \quad (17)$$

$$L_M = L_N \times L_R = 6 \times 84.4\mu\text{H} = 506.4\mu\text{H} \quad (18)$$

选择初步参数后, 找到可用的最接近的实际元件值, 使用选择的参数重新评估增益曲线, 然后运行时间域仿真以验证电路运行。

以下谐振回路参数为:

$$C_R = 30\text{nF} \quad (19)$$

$$L_R = 85\mu\text{H} \quad (20)$$

$$L_M = 510\mu\text{H} \quad (21)$$

根据最终谐振回路参数, 计算谐振频率:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_R C_R}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{85\text{nF} \times 85\mu\text{H}}} = 99.7\text{kHz} \quad (22)$$

基于新的 LLC 增益曲线, 最大及最小增益下的标准化开关频率使用以下公式得出:

- $f_{N(Mgmax)} = 0.7$
- $f_{N(Mgmin)} = 1.0$

$$f_{N(Mgmax)} = 0.7 \quad (23)$$

$$f_{N(Mgmin)} = 1.0 \quad (24)$$

最大和最小开关频率为：

$$f_{SW(Mgmax)} = 69.8\text{kHz} \quad (25)$$

$$f_{SW(Mgmin)} = 99.7\text{kHz} \quad (26)$$

8.2.2.6 LLC 初级侧电流

计算初级侧电流是为了选择元件。电流计算基于 110% 过载条件。

初级侧 RMS 负载电流使用以下公式计算：

$$I_{OE} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times \frac{I_O}{n} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times \frac{1.1 \times 15\text{A}}{16.5} = 1.111\text{A} \quad (27)$$

最小开关频率下的 RMS 磁化电流使用以下公式计算：

$$I_M = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times \frac{N_{PS} V_{OUT}}{\omega L_M} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times \frac{16.5 \times 12}{2\pi \times 64.8\text{kHz} \times 510\mu\text{H}} = 0.797\text{A} \quad (28)$$

谐振回路总电流使用以下公式计算：

$$I_R = \sqrt{I_M^2 + I_{OE}^2} = \sqrt{(1.111\text{A})^2 + (0.797\text{A})^2} = 1.367\text{A} \quad (29)$$

8.2.2.7 LLC 次级侧电流

总次级侧 RMS 负载电流是指从初级侧电流 (I_{OE}) 到次级侧的电流。

$$I_{OES} = N_{PS} \times I_{OE} = 16.5 \times 1.111\text{A} = 18.327\text{A} \quad (30)$$

在此设计中，变压器次级侧采用中心抽头配置。各次级变压器绕组的电流使用以下公式计算：

$$I_{WS} = \frac{\sqrt{2} \times I_{OES}}{2} = \frac{\sqrt{2} \times 18.327\text{A}}{2} = 12.959\text{A} \quad (31)$$

相应的半波平均电流为：

$$I_{SAV} = \frac{\sqrt{2} \times I_{OES}}{\pi} = \frac{\sqrt{2} \times 18.327\text{A}}{\pi} = 8.250\text{A} \quad (32)$$

8.2.2.8 LLC 变压器

为了更大限度地提高效率，请使用偏置绕组来使用 HV 启动功能。对偏置绕组进行设计，使 VCCP 电压大于 12V。

根据以下规格构建或购买变压器：

- 匝数比：主:次:偏置 = 33:2:3
- 初级端子电压：450V_{pk}
- 初级磁化电感：L_M = 510μH
- 初级侧绕组额定电流：I_R = 1.367A
- 次级端子电压：36V_{pk}
- 次级绕组额定电流：I_{WS} = 12.959A
- 最小开关频率：69.8kHz
- 最大开关频率：99.7kHz

- 初级侧和次级侧之间的绝缘：IEC60950 增强型绝缘

一些应用作为宽输入 LLC 运行，其中 PFC 可能会在待机模式下被关断，此时在重负载关断期间，工作频率可能要更低，而 LLC 可以在恰好高于 ZCS 边界的较低频率下运行。对谐振电路、变压器电感器和谐振电感器中的磁性元件进行评级，使其在较低频率下运行。

根据匝数比，可获得高达 18V 的偏置电压。为了将控制器电压降低到 15V，在为控制器的 VCCP 供电之前在 UCC25661EVM-128 中使用一个电压稳压器电路。

8.2.2.9 LLC 谐振电感器

谐振电感器上的交流电压通过交流电压阻抗乘以电流而得出：

$$V_{LR} = \omega L_R I_R = 2\pi \times 69.8\text{kHz} \times 85\mu\text{H} \times 1.367\text{A} = 50.946\text{V} \quad (33)$$

根据以下规格来构建或购买电感器：

- 电感： $L_R = 85\mu\text{H}$
- 额定电流： $I_R = 1.367\text{A}$
- 端子交流电压：50.946V
- 频率范围：69.8kHz 至 99.7kHz

有些设计会利用变压器的漏电感作为谐振电感，不需要外部谐振电感器。

8.2.2.10 LLC 谐振电容器

LLC 谐振电容器以开关频率承载全初级电流。使用低耗散因数电容器，以防止出现过热。

谐振电容器上的交流电压通过交流电压阻抗乘以电流而得出。

$$V_{CR} = \frac{I_R}{\omega C_R} = \frac{1.367\text{A}}{2\pi \times 69.8\text{kHz} \times 30\text{nF}} = 104.0\text{V} \quad (34)$$

$$V_{CR(\text{RMS})} = \sqrt{\left(\frac{V_{IN(\text{max})}}{2}\right)^2 + V_{CR}^2} = \sqrt{\left(\frac{410}{2}\right)^2 + 104.0^2} = 229.9\text{V} \quad (35)$$

峰值电压：

$$V_{CR(\text{peak})} = \frac{V_{IN(\text{max})}}{2} + \sqrt{2}V_{CR} = \frac{410}{2} + \sqrt{2} \times 104.0 = 352.0\text{V} \quad (36)$$

谷值电压：

$$V_{CR(\text{valley})} = \frac{V_{IN(\text{max})}}{2} - \sqrt{2}V_{CR} = \frac{410}{2} - \sqrt{2} \times 104.0 = 58.0\text{V} \quad (37)$$

额定电流：

$$I_R = 1.367\text{A} \quad (38)$$

8.2.2.11 LLC 初级侧 MOSFET

每个 MOSFET 将输入电压视为最大施加电压。设定的 MOSFET 额定电压为最大体电压的 1.5 倍：

$$V_{QLLC(\text{peak})} = 1.5 \times V_{IN(\text{max})} = 615\text{V} \quad (39)$$

设定的 MOSFET 额定电流为最大初级侧 RMS 电流的 1.1 倍：

$$I_{QLLC} = 1.1 \times I_R = 1.504\text{A} \quad (40)$$

8.2.2.12 自适应死区时间的设计注意事项

在设计完谐振回路并选择初级侧 MOSFET 后，再次检查转换器的 ZVS 工作状态。只有当栅极关断沿的谐振电感中剩余足够的电能给开关节点电容放电时，或者 LI^2 大于 $C_{OSS} V^2$ 时，才能实现 ZVS。 C_{OSS} 是两个开关级 MOSFET 的有效漏极到源极电容。UCC25661 基于开关节点的转换实现自适应死区时间。转换检测电路的检测范围为 0.1V/ns 至 200V/ns。

为了检查 ZVS 操作，控制器进行了一系列时域模拟，并捕获了栅极关断边缘的谐振电流，如图 8-2 所示。

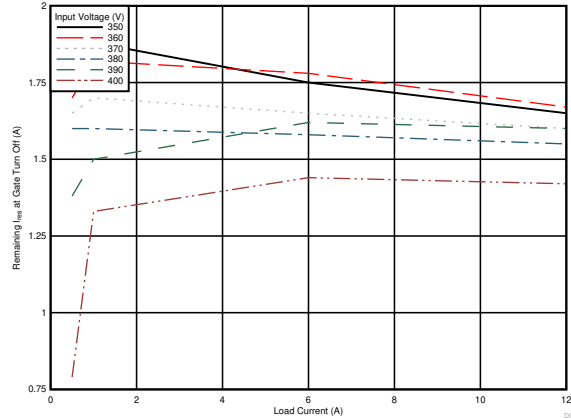


图 8-2. 自适应死区时间

上面的图 8-2 假设在 5% 负载时出现最大开关频率，且系统在 5% 负载时开始突发。

使用图 8-2 时，在感兴趣的工作范围内，油箱中剩余的最小谐振电流为 $I_{\min} = 0.8A$ 。知道初级侧开关节点寄生电容，以计算压摆率。根据 MOSFET 数据表中给出的 C_{OSS} 值估算压摆率。在本例中，总 $C_{switchnode} = 400pF$ ，因为每个 MOSFET 具有 200pF 的电容。最小压摆率由以下公式计算得出：

$$\frac{I_{\min}}{C_{switchnode}} = \frac{0.8A}{400pF} = 2V/ns \quad (41)$$

8.2.2.13 LLC 整流器二极管

输出二极管的额定电压使用以下公式计算：

$$V_{DD} = 1.2 \times \frac{V_{IN(max)}}{N_{PS}} = 1.2 \times \frac{410}{16.5} = 29.82V \quad (42)$$

输出二极管的额定电流使用以下公式计算：

$$I_{SAV} = \frac{\sqrt{2} \times I_{OES}}{\pi} = \frac{\sqrt{2} \times 18.329}{\pi} = 8.250A \quad (43)$$

8.2.2.14 LLC 输出电容器

LLC 变换器拓扑结构无需输出滤波器。使用小型第二级滤波电感器来减小输出纹波的峰峰值。假设输出电容器承载整流器的全波输出电流，则电容器额定纹波电流为：

$$I_{RECT} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} I_{OUT} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times 15 = 16.66A \quad (44)$$

对 12V 输出电压使用 20V 额定电压：

$$V_{LLCcap} = 20V \quad (45)$$

电容器的 RMS 额定电流为：

$$I_{C(out)} = \sqrt{\left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}} I_{OUT}\right)^2 - I_{OUT}^2} = \sqrt{\left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times 15\right)^2 - 15^2} = 7.251A \quad (46)$$

采用导电聚合物技术的固态铝电容器具有较高的额定纹波电流，是一个不错的选择，尤其是对于需要在较低温度下运行的设计来说。如果单个电容器的额定纹波电流不足，则并联多个电容器。

LLC 级输出的纹波电压是流经电容器的交流电流大小的函数。要估测此纹波电压，假定所有电流（包括负载中的直流电流）均流经滤波电容器。

$$ESR_{max} = \frac{V_{OUT(pk-pk)}}{I_{RECT(pk)}} = \frac{0.12V}{\frac{2\pi}{4} \times 15A} = 5.1m\Omega \quad (47)$$

电容器规格为：

- 额定电压：20V
- 额定纹波电流：7.251A
- 有效 ESR：< 5.1mΩ

8.2.2.15 HV 引脚串联电阻器

多个电阻器与 HV 引脚串联连接，以限制每个电阻器的功率耗散。带有 HV 引脚的典型串联电阻器为 5kΩ，必须为每个应用优化串联电阻器值。例如，在使用较高的总线电压时，请选择具有更高值的串联电阻器。

8.2.2.16 BLK 引脚分压器

BLK 引脚会检测 LLC 直流输入电压，并确定何时导通和关断 LLC 转换器。此外，BLK 引脚电压还用于前馈补偿。

UCC25661EVM-128 的 BLK 引脚电阻器分压器的功耗预算是 15mW。BLK 检测电阻器总值使用以下公式得出：

$$R_{BLKsns} = R_{BLKupper} + R_{BLKlower} = \frac{V_{IN(nom)}^2}{P_{BLKsns}} = \frac{390^2}{0.015} = 10M\Omega \quad (48)$$

选择 365V LLC 启动电压。然后， $V_{BLKStart}$ 与 $V_{BLKStop}$ 、 $V_{BLKStartHys}$ 、 $I_{BLKSink}$ 关系如下：

$$V_{BLKStart} = 365 \left(\frac{R_{BLKlower}}{R_{BLKupper} + R_{BLKlower}} \right) = V_{BLKStop} + V_{BLKStartHys} + I_{BLKSink} \left(\frac{R_{BLKupper} R_{BLKlower}}{R_{BLKupper} + R_{BLKlower}} \right) \quad (49)$$

如果 $V_{BLKStop} = 1V$ 、 $V_{BLKStartHys} = 0.1V$ 、 $I_{BLKSink} = 5\mu A$ ，则 $R_{BLKupper}$ 为 10MΩ， $R_{BLKlower}$ 为 35.4kΩ。

为 $R_{BLKlower}$ 选择标准值 35.4kΩ，为 $R_{BLKupper}$ 选择 3 个串联标准值 3.3MΩ。

实际启动电压使用以下公式计算

$$V_{BLKStart} \left[\frac{R_{BLKupper} + R_{BLKlower}}{R_{BLKlower}} \right] = \left[V_{BLKStop} + V_{BLKStartHys} + I_{BLKSink} \left(\frac{R_{BLKupper} R_{BLKlower}}{R_{BLKupper} + R_{BLKlower}} \right) \right] \times \left[\frac{R_{BLKupper} + R_{BLKlower}}{R_{BLKlower}} \right] \quad (50)$$

$$= 358V$$

BLK 电阻器的功耗使用以下公式计算

$$P_{BLKsns} = \frac{V_{IN(nom)}^2}{(R_{BLKupper} + R_{BLKlower})} = \frac{390^2}{(10M\Omega + 35.4k\Omega)} = 15.3mW \quad (51)$$

LLC 关断电压使用以下公式计算

$$V_{BLKStop} \left(\frac{R_{BLKupper} + R_{BLKlower}}{R_{BLKlower}} \right) = 280.6V \quad (52)$$

8.2.2.17 ISNS 引脚微分器

ISNS 引脚通过微分器来检测谐振电流。ISNS 引脚会与 TSET、BLK 引脚电阻器一起设定过载保护水平。过载保护的典型阈值电压 (V_{FBOLP}) 为 4.75V。ISNS 引脚还会设定过流保护水平 (OCP1)。OCP1 的阈值为 3.5V 或 4V，具体取决于 TSET 引脚电阻器和正在使用的型号。对于 EVM，使用 UCC256611。因此，对于该型号，OCP1 阈值为 3.5V。

满负载时的峰值谐振电感器电流

$$I_{R_PEAK} = \sqrt{2}I_R = \sqrt{2} \times 1.367 = 1.933A \quad (53)$$

先选择电流检测电容器，因为可选择的高压电容器比电阻器少：

$$C_{ISNS} = 150pF \quad (54)$$

对于本设计，使用 UCC256611。因此，对于该型号，OCP1 阈值为 3.5V。

$$OCP1_Threshold = 3.5V \quad (55)$$

然后计算所需的 ISNS 电阻器值：

$$R_{ISNS} < \frac{OCP1_Threshold \cdot C_r}{I_{R_PEAK} \cdot C_{ISNS}} = \frac{3.5V \cdot 30nF}{1.933A \cdot 150pF} = 329\Omega \quad (56)$$

$$R_{ISNS} = 226\Omega \quad (57)$$

选择了 [方程式 57](#)。

OCP1 级别峰值谐振电流由下式计算得出：

$$I_{R_PEAK_OCP1} = \frac{OCP1_Threshold \times C_r}{R_{ISNS} \times C_{ISNS}} = \frac{3.5 \times 30nF}{226 \times 150pF} = 3.097A \quad (58)$$

8.2.2.18 TSET 引脚

TSET 引脚电阻器可设置 VCR 积分器时间常数（计时器增益 $[k_s]$ 、 R_{VCR} 、 R_{RAMP} 、 C_{VCR} ）和 IPPC 模式下的最小开关频率。也可以根据给定输出功率下的 $V_{FBreplica}$ 电压来确定 TSET 引脚电阻器。

以下信息适用于启用了 OCP/OLP 去耦的器件。

根据 $f_{SW} (Mgmin)$ 和在最小输入电压和最大输出功率下的满负载工作频率，选择 V_{TSETB} 电压选项。对于本设计，由于在 365V 的最小输入电压和额定输出功率下观察到的满载工作频率为 89kHz，因此在设计计算器中选择了选项 4。对于选项 #4， V_{TSETB} 电压必须介于 0.742V 和 48mV，如 [表 7-1](#) 所示。

选择 ($V_{TSETA} - V_{TSETB}$) 电压，以设置给定输出功率下的 FBReplica 幅度。选择差分电压，以便在最大输出功率下，FBReplica 幅度低于 V_{FBOLP} ，如 [图 8-3](#) 所示，具有最坏情况下需要的裕度。此设计从 [表 7-1](#) 中选择了选项 5，以便 VCR 积分器时间常数以及所选的 ISNS 和 BLK 电阻器使 FBReplica 幅度在最大输入功率下接近 4V，并将 ($V_{TSETA} - V_{TSETB}$) 电压设置在 0.850V 和 48mV 之间。 [表 7-1](#)。

$$V_{TSETB} = \frac{R_{TSET_lower} \cdot V_{5P}}{R_{TSET_lower} + R_{TSET_upper}} \quad (59)$$

$$V_{TSETA} = V_{TSETB} + \frac{R_{TSET_lower} \cdot R_{TSET_upper}}{R_{TSET_lower} + R_{TSET_upper}} \cdot I_{TSETPrm} \quad (60)$$

通过求解方程 59 和方程 60, R_{TSET_upper} 为 $572.78k\Omega$, R_{TSET_lower} 为 $99.81k\Omega$ 。

最后, 选择 $R_{TSET_upper} = 576k\Omega$ 和 $R_{TSET_lower} = 100k\Omega$ 。

最终 V_{TSETB} 和 $(V_{TSETA} - V_{TSETB})$ 使用方程 61 和方程 62 得出:

$$V_{TSETB} = \frac{100k \cdot 5V}{100k + 576k} = 0.74V \quad (61)$$

$$(V_{TSETA} - V_{TSETB}) = \frac{100k \cdot 576k}{100k + 576k} \cdot 10\mu A = 0.852V \quad (62)$$

图 8-3 展示了相对于 LLC 输入功率的 FBReplica 电压。

为了计算 P_{in} , 以下公式中使用了 92% 效率。

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} \quad (63)$$

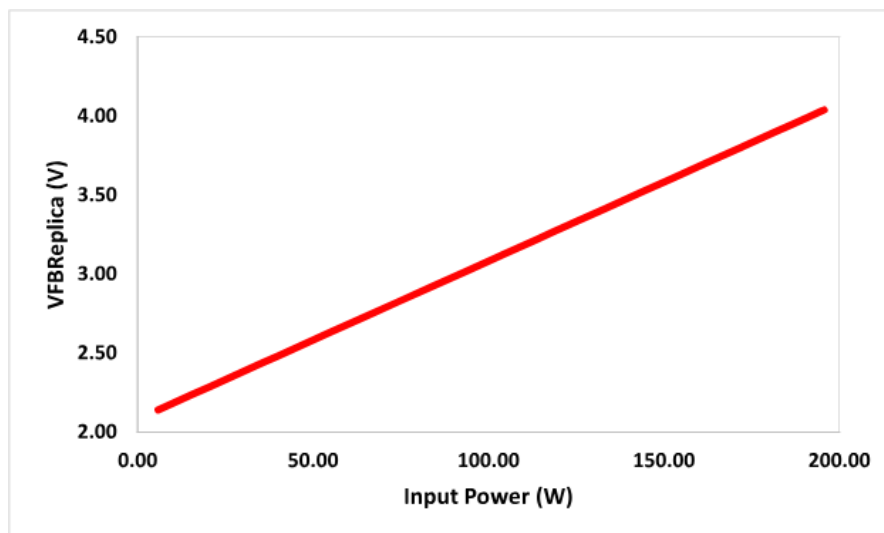


图 8-3. FBReplica 与 P_{in} 间的关系

在反馈光耦合器发射极和接地之间插入一个 $10k\Omega$ 电阻器可以测出 FBReplica 电压。假设在 $10k\Omega$ 电阻器上测得的电压是 V_{10k} 。使用方程 64 计算 FBReplica 电压:

$$FBReplica = \left(I_{FB} - \frac{V_{10k\Omega}}{10k\Omega} \right) \times R_{FBInternal} \quad (64)$$

8.2.2.19 OVP/OTP 引脚

OVP/OTP 引脚用于保护功率级免受过压影响。此外, OVP/OTP 引脚用来使用负温度系数 (NTC) 热敏电阻进行过热保护。由于偏置绕组电压是通过变压器匝数比的输出电压镜像, 因此使用齐纳二极管拉高此引脚是一种在初级侧设置 OVP 的便捷方法。在该设计中, 标称输出电压为 12V。根据输出电压与建议偏置电压的比率, 偏置绕组与次级侧绕组的匝数比为 1.5。如果存在整流二极管, 则假设压降为 0.5V (Vf)。如果使用同步整流, 则只能估算因其他损耗 (Vloss) 导致的 0.5V 压降, 因此使用以下公式计算偏置绕组的标称电压:

$$V_{BiasWindingNom} = (12 + 0.5 + 0.5) \times \frac{N_{aux}}{N_2} = (12 + 0.5 + 0.5) \times \frac{3}{2} = 19.5V \quad (65)$$

在此设计中，理想 OVP 阈值是标称值的 140%。UC25661 器件中的 OVP 阈值水平 (V_{OVPpos}) 为 3.5V。齐纳二极管所要求的额定电压随后由以下公式计算得出：

$$V_z = (1.4 \times V_{out} + V_{drop}) \times \frac{N_{aux}}{N_2} - V_{OVPpos} = (1.4 \times 12 + 0.5 + 0.5) \times \frac{3}{2} - 3.5 = 23.2V \quad (66)$$

假设使用的齐纳二极管的实际额定电压为 23V。触发 OVP 时的实际输出电压为：

$$V_{out_ovp} = (V_z + V_{OVPpos}) \times \frac{N_2}{N_{aux}} - V_{drop} = (23 + 3.5) \times \frac{2}{3} - 1 = 16.67V = 139\% \times V_{out} \quad (67)$$

正常运行期间，OVP/OTP 引脚的标准电压处于 0.8V 至 3.5V 的工作窗口内。为了实现过热保护，将 OVP/OTP 引脚下拉至 0.8V 的 OTP 阈值以下。在室温下，OVP/OTP 引脚电压视为 1.4V。在室温下，该引脚上的有效电阻值为：

$$R_{OVP/OTP_25} = \frac{1.4V}{I_{OVP_OTP}} = \frac{1.4V}{100 \times 10^{-6}A} = 14k\Omega \quad (68)$$

$$R_{OVP/OTP_25} = \frac{R_{ext} \times R_{NTC_25}}{R_{ext} + R_{NTC_25}} = 14k\Omega \quad (69)$$

R_{ext} 是与热敏电阻器并联的外部电阻器。 R_{NTC_25} 是室温下热敏电阻器的电阻值。

对于这种设计，在 110°C 上设置过热保护。根据 NTC 的可用性和温度系数，选择 [方程式 70](#)。

$$\frac{R_{NTC_110}}{R_{NTC_25}} = 0.035263 \quad (70)$$

请参阅 [B57371V2474J060](#) 数据表。这里的 R_{NTC_110} 是热敏电阻器在 110°C 下的电阻。

对于 OTP 触发，确保 OVP/OTP 引脚电压低于 0.8V。

$$R_{OVP/OTP_110} = \frac{0.8V}{I_{OVP_OTP}} = \frac{0.8V}{100 \times 10^{-6}A} = 8k\Omega \quad (71)$$

$$R_{OVP/OTP_110} = \frac{R_{ext} \times R_{NTC_110}}{R_{ext} + R_{NTC_110}} = 8k\Omega \quad (72)$$

根据 [方程式 69](#)、[方程式 70](#) 和 [方程式 72](#)， R_{NTC_25} 为 510k Ω ， R_{ext} 为 14.4k Ω 。选择了 $R_{NTC_25} = 470k\Omega$ (制造商器件型号：[B57371V2474J060](#)) 和 $R_{ext} = 15k\Omega$ 。

在室温下使用新选择的电阻器时，OVP/OTP 电压使用以下公式计算：

$$R_{OVP/OTP_25} \times I_{OVP_OTP} = \left(\frac{15k \times 470k}{15k + 470k} \right) \times 100 \times 10^{-6} = 1.454V \quad (73)$$

在 110°C 下，OVP/OTP 电压使用以下公式计算：

$$R_{OVP/OTP_110} \times I_{OVP_OTP} = \left(\frac{15k \times (470k \times 0.035263)}{15k + (470k \times 0.035263)} \right) \times 100 \times 10^{-6} = 0.78V \quad (74)$$

8.2.2.20 突发模式编程

借助 LL 引脚电压 (VLLB) 和连接至 LL 引脚的电阻分压器，用户能够设置 HFBurstEntry 和 LFBurstEntry 阈值，如下所示。

$$V_{LLB} = \frac{R_{LL_lower} \cdot V_{SP}}{R_{LL_upper} + R_{LL_lower}} \quad (75)$$

$$V_{LLA} = V_{LLB} + \frac{R_{LL_lower} R_{LL_upper}}{R_{LL_upper} + R_{LL_lower}} \cdot I_{LLPrgm} \quad (76)$$

如表 7-1 所示, ($V_{LLA} - V_{LLB}$) 电压决定 $V_{LLB}/HFBurstEntry$ 比率。

对于此设计, 请考虑 ($V_{LLB}/HFBurstEntry$) = 0.55。确认 ($V_{LLA}-V_{LLB}$) 值介于 1.087V 与 1.391V 之间。

于是, $HFBurstEntry$ 与 LL 引脚电压的关系如下所示:

$$HFBurstEntry = \frac{V_{LLB}}{0.55} = 1.818 \cdot V_{LLB} \quad (77)$$

$LFBurstEntry$ 始终与 LL 引脚电压存在以下关系:

$$LFBurstEntry = \frac{V_{LLB}}{0.6} = 1.667 \cdot V_{LLB} \quad (78)$$

根据曲线和硬件测试, 调整 V_{LLB} 和 ($V_{LLA} - V_{LLB}$) 以达到所需性能。

对于此设计, 请考虑 $V_{LLB} = 1.2V$ 和 $V_{LLA} = ([V_{LLA}-V_{LLB}] \text{ 的最大电压}) - 0.1V$ 。通过将这些值代入 [方程式 75](#)、[方程式 76](#), $R_{LLupper}$ 为 538k、 $R_{LLlower}$ 为 170k。

最后, 此设计选择了 $R_{LLupper} = 536k \Omega$ 和 $R_{LLlower} = 169k \Omega$ 。

最终突发条目的计算公式如下:

$$V_{LLB} = \frac{169k \cdot 5}{169k + 536k} = 1.199V \quad (79)$$

$$V_{LLA} = 1.199V + \frac{169k \cdot 536k}{169k + 536k} \cdot 10\mu A = 2.483V \quad (80)$$

$$V_{LLA} - V_{LLB} = 1.285V \quad (81)$$

$$HFBurstEntry = 1.818 \cdot 1.199 = 2.179V \quad (82)$$

$$LFBurstEntry = 1.667 \cdot 1.199 = 1.998V \quad (83)$$

8.2.3 应用曲线

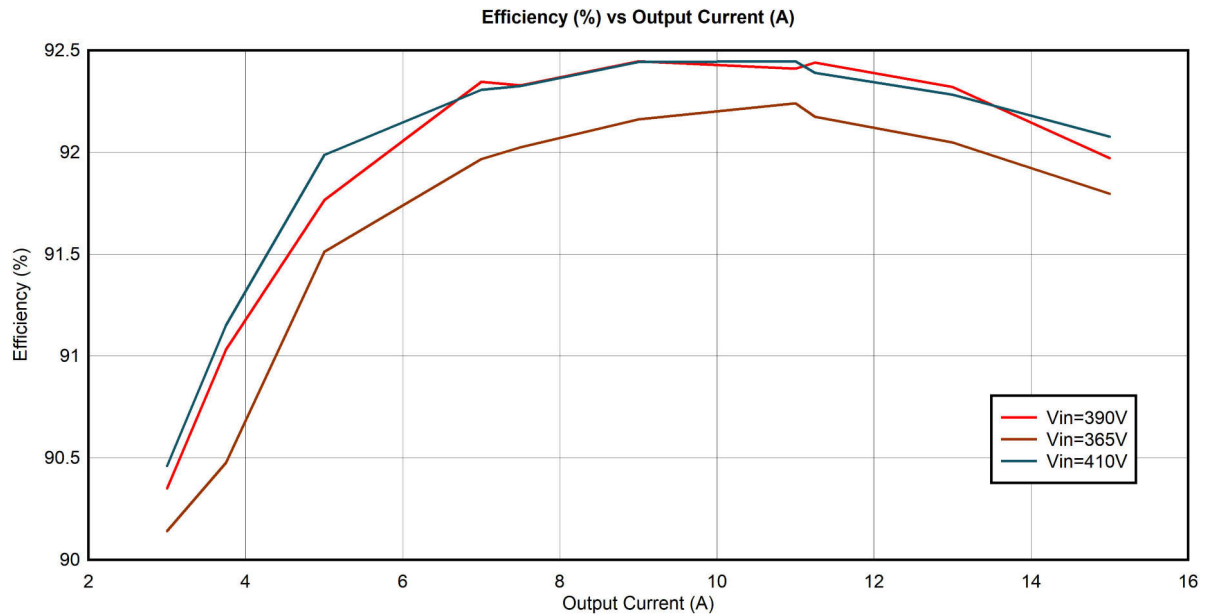


图 8-4. 效率

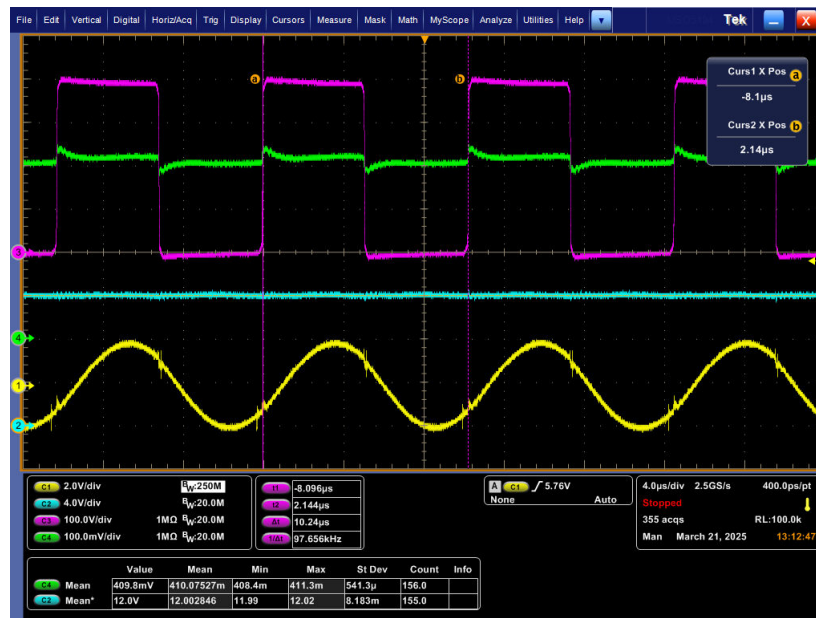


图 8-5. 15A 负载、390V 输入时的稳定状态波形 (Ch1 = ISNS ; Ch2 = Vout ; Ch3 = SW ; Ch4 = I_OPT)

8.3 电源相关建议

8.3.1 VCCP 引脚电容器

选择值足够高的 VCCP 电容器，以便在 LF 突发运行期间进行支持，从而确保 VCCP 不低于 $VCC_{StopSwitching}$ 水平。

选择一个或多个总电容不低于 100μF 的电容器。确认 VCCP 引脚上的电容器在 LF 突发运行期间提供静态电流支持，并为 VCCP 上的高频电流提供低阻抗路径。在选择电容器时，参考制造商的数据手册，考虑陶瓷电容器在直流偏置电压下的降额特性。

8.3.2 引导电容器

在 LF 突发关断周期内，HB 引脚的高侧栅极驱动器消耗的功率必须从 C_{BOOT} 获得，导致自举电容器电压衰减。在下一个突发周期开始时，C_{BOOT} 上必须剩余足够的电压，以便为高侧栅极驱动器 (HO) 供电，直到低侧栅极驱动器 (LO) 的导电周期使之通过 C_{VCCP} 获得补充。因此，在此突发关断周期内，高侧驱动器消耗的功率直接影响着必须连接到 HB 和 VCCP 的电容器大小和成本。

假设系统的最大突发关断周期为 150ms，自举二极管的正向压降为 1V。最小自举电压应定为 8V，以避免出现 UVLO 故障。引导电容器上的最大允许压降为：

$$V_{bootmaxdrop} = V_{VCCP} - V_{bootforwarddrop} - 8V = 12V - 1V - 8V = 3V \quad (84)$$

随后可以确定引导电容器的大小：

$$C_B = \frac{I_{BOOT_QUIESCENT}}{V_{bootmaxdrop}} = \frac{60\mu A \times 150ms}{3V} = 3\mu F \quad (85)$$

选择低漏电流、低 ESR 陶瓷电容器。在选择电容器时，必须参考制造商的数据手册，考虑陶瓷电容器在直流偏置电压下的降额特性。

8.3.3 V5P 引脚电容器

验证 V5P 引脚是否已连接到去耦电容器并连接至 GND。由于该引脚上的负载非常小，建议使用 0.1 μF 至 4.7 μF 之间的小型去耦电容器。

8.4 布局

8.4.1 布局指南

- 除了储能电解电容器以外，还应在 VCCP 引脚上连接一个 2.2μF 陶瓷电容器。将 2.2μF 陶瓷电容器尽可能靠近 VCCP 引脚。
- 在 VCCP 引脚上增加必要的滤波电容器，以过滤掉偏置绕组波形上的高峰值。
- 最小引导电容器 C_B 建议为 0.1μF。请按照第 8.3.2 节所述进行计算，并参考电气表中的 I_{BOOT_LEAK} (BOOT 漏电流)。
- 建议在单点处连接信号接地端和电源接地端。建议将电源接地连接到 LLC 转换器输入大容量电容器的负端子。
- 将 ISNS (100pF)、BLK (10nF)、LL (330pF)、TSET (220pF)、OVP/OTP (100pF) 的滤波器电容器尽可能靠近各自的引脚放置。
- FB 迹线应尽可能短，并使 FB 迹线远离高 dv/dt 迹线。
- 为 ISNS 电容器使用薄膜电容器或 C0G、NP0 陶瓷电容器，以实现低失真。
- 保持必要的高电压间隙和爬电距离。
- 如果 HV 引脚上需要 2kV HBM ESD 等级，则可在 HV 引脚到接地之间放置一个 100pF 电容器，用于传递高达 2kV 的 HBM ESD。

8.4.2 布局示例

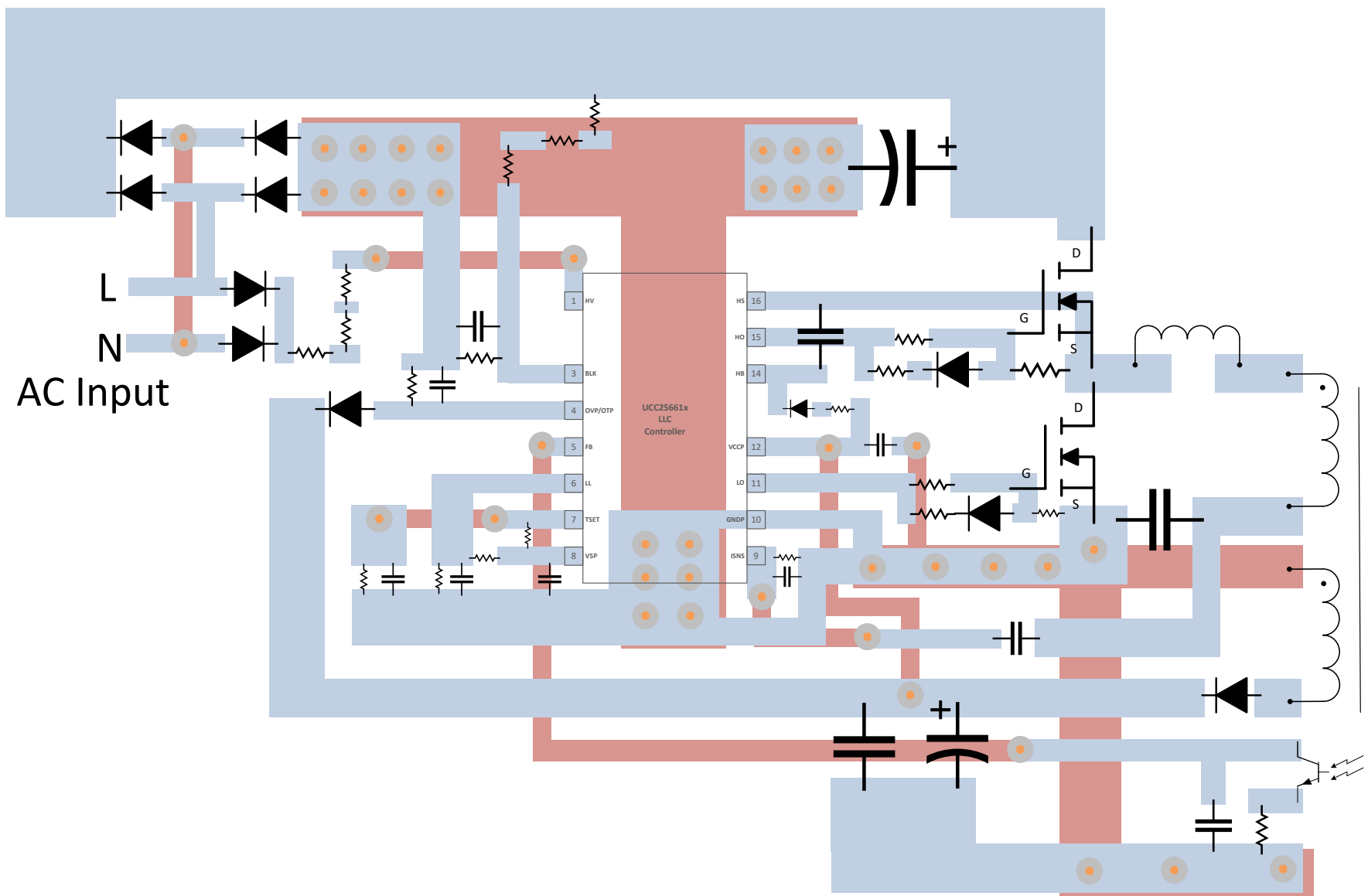


图 8-6. 2 层电路板的 UCC25661x 布局示例

8.4.2.1 原理图

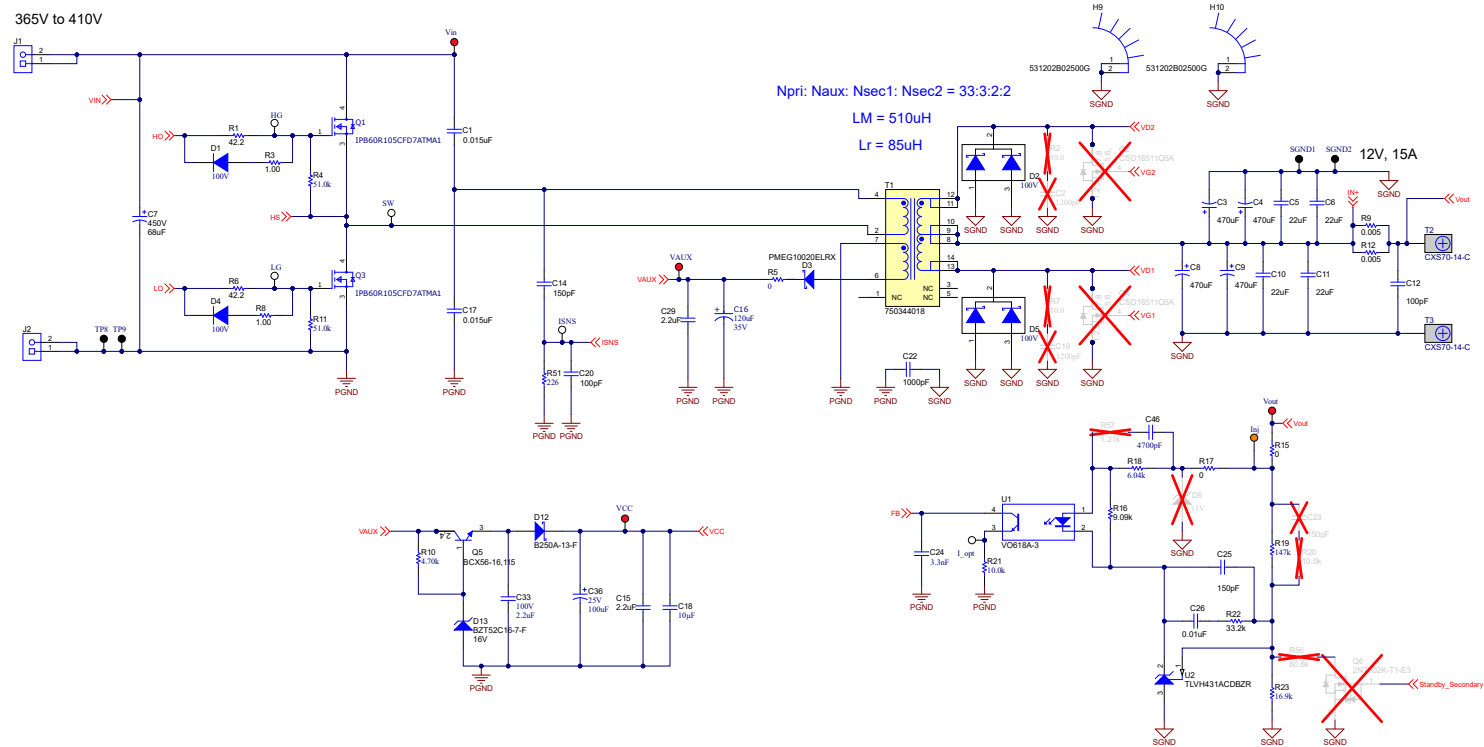


图 8-7. UCC25661EVM-128 功率级原理图

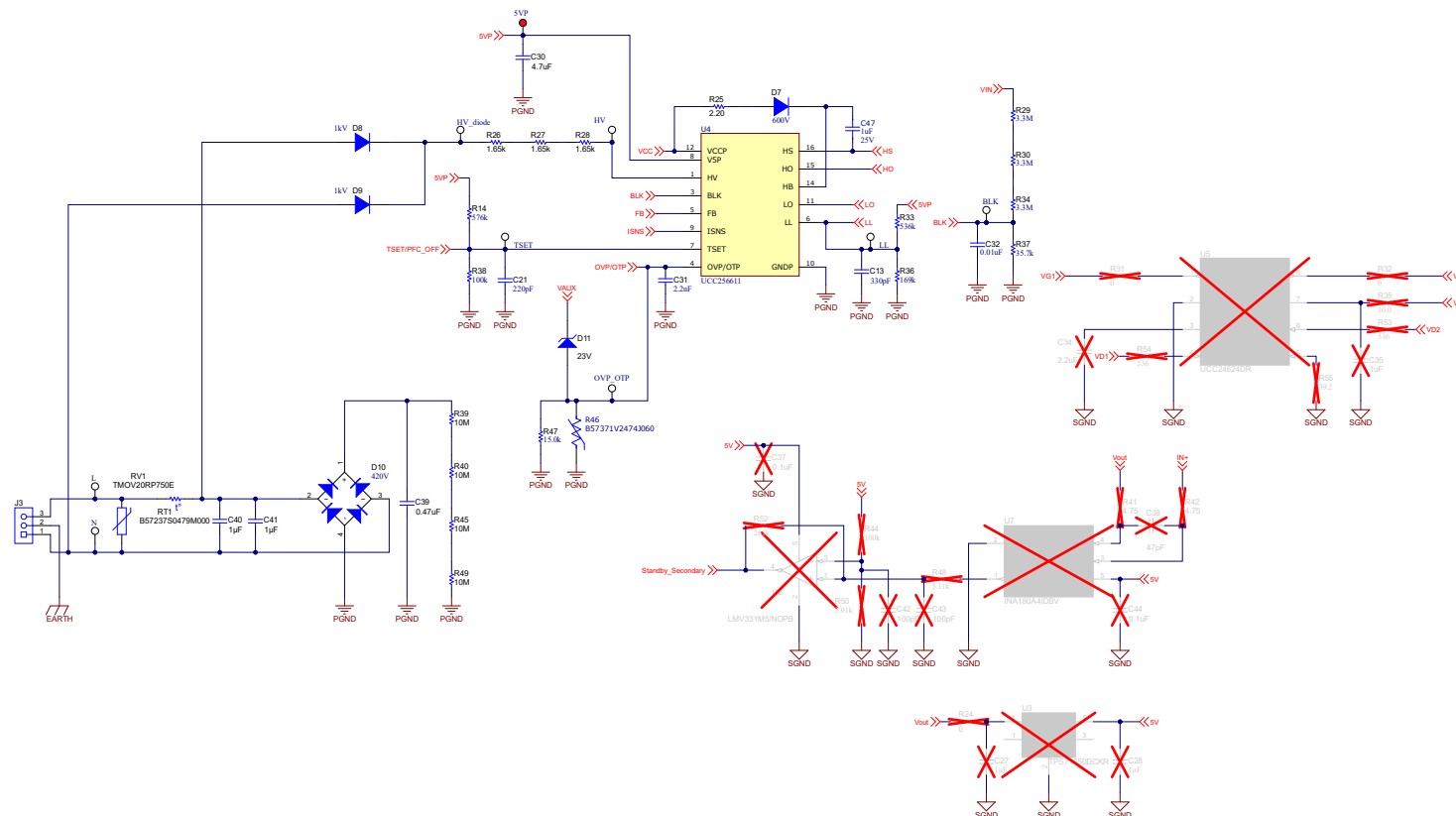


图 8-8. UCC25661EVM-128 控制原理图

9 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

9.1 文档支持

9.1.1 相关文档

- TDK Electronics、[用于温度测量的 NTC 热敏电阻](#)
- 德州仪器 (TI)、[UCC29950 的 LLC 设计应用手册](#)

9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision B (January 2026) to Revision C (August 2026)	Page
• 将扩展增益范围器件从 UCC256611 更新为 UCC256610.....	1
• 更新了 器件比较表	3
• 已将 TSET 编程 部分为拆分 表 7-1	21

Changes from Revision A (September 2025) to Revision B (January 2026)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图、公式和交叉引用的编号格式.....	1
• 在特性章节中添加 X 电容器放电和扩展增益范围	1
• 将 UCC25661 改为：全文档统一为 UCC25661x 系列.....	1
• 更新了 器件比较表	3
• 向规格表中添加了 UCC256611、UCC256612、UCC256613、UCC256614 和 UCC256616 可订购选项.....	6
• 在详细说明概述中添加了 扩展增益范围 (EGR) 的优点	16
• 添加了“VCR 合成器”部分中的 EGR 信息	20

• 添加了 UCC256616 的 TSET 编程部分.....	22
• 添加了突发模式下的 TSET 引脚交替功能、PFC 开关、TSET 强制低可闻噪声待机模式、X 电容器放电 和仅通过 HV 引脚检测部分.....	37

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

封装选项附录

封装信息

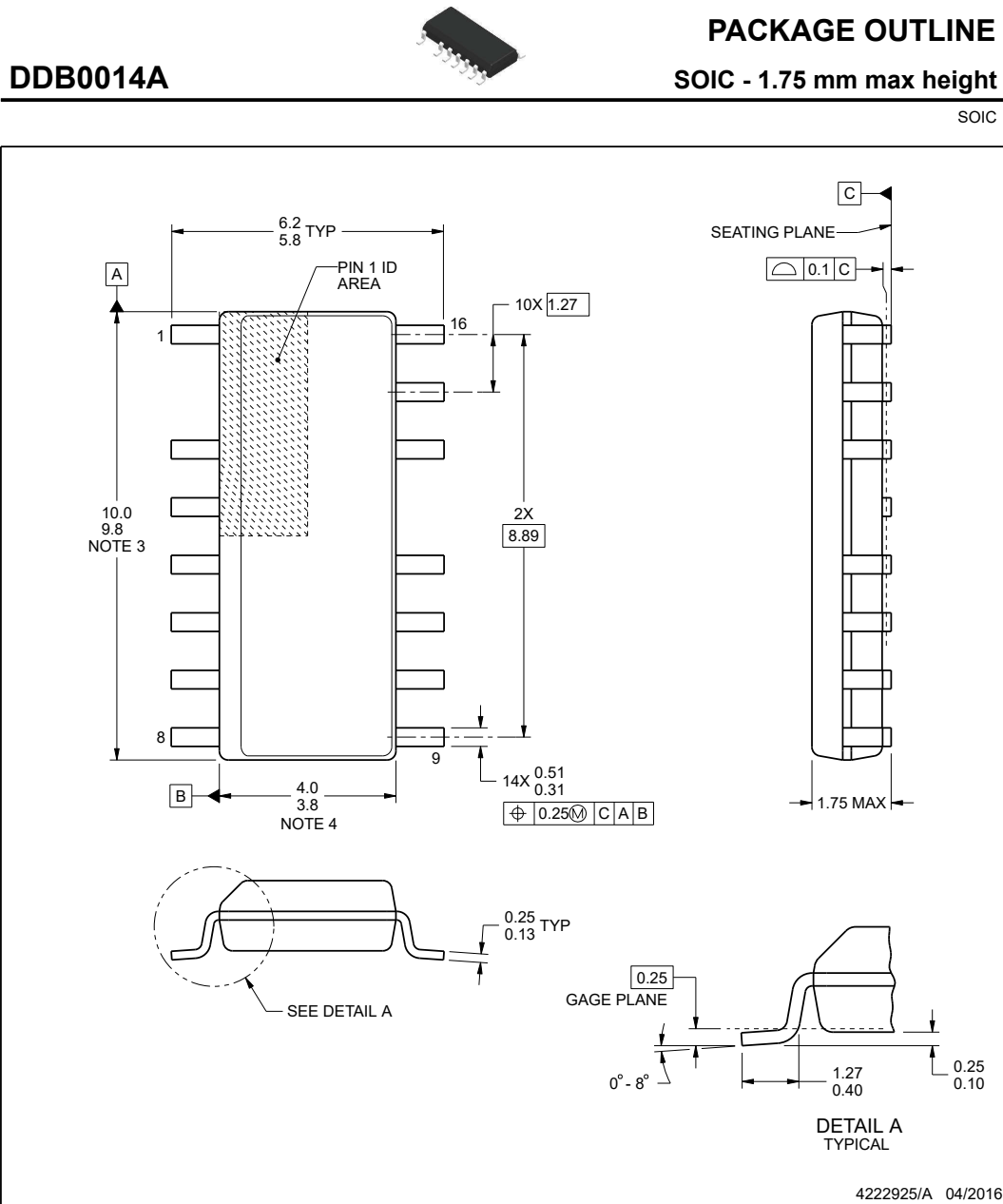
可订购器件型号	状态 (1)	材料 类型 (2)	封装 引脚	包装数量 包装	RoHS (3)	引脚镀层/焊球材料 (4)	MSL 等级/回流焊峰值 温度 (5)	工作温度 (°C)	器件标识 (6)
UCC256610DDBR	有效	量产	SOIC (DDB) 14	2500 LARGE T&R	是	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 至 125	UCC256610
UCC256611DDBR	有效	量产	SOIC (DDB) 14	2500 LARGE T&R	是	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 至 125	UCC256611
UCC256612DDBR	有效	量产	SOIC (DDB) 14	2500 LARGE T&R	是	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 至 125	UCC256612
UCC256613DDBR	有效	量产	SOIC (DDB) 14	2500 LARGE T&R	是	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 至 125	UCC256613
UCC256614DDBR	有效	量产	SOIC (DDB) 14	2500 LARGE T&R	是	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 至 125	UCC256614
UCC256616DDBR	有效	量产	SOIC (DDB) 14	2500 LARGE T&R	是	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 至 125	UCC256616

- (1) **状态**：有关状态的详细信息，请参阅我们的 [产品生命周期](#)。
- (2) **材料类型**：指定时，预量产器件是原型/试验器件，尚未获批或发布以进行全面生产。测试和最终工艺（包括但不限于质量保证、可靠性测试以及/或工艺鉴定）可能尚未完成，并且本器件可能会进一步更改，也可能中断研发。即使可供订购，所购器件仍将可能在结算时被取消，并且所购器件仅可用于早期内部评估。这些器件一经售出，概不提供任何保修。
- (3) **RoHS 值**：是、否、RoHS 豁免。有关更多信息和值定义，请参阅“[TI RoHS 声明](#)”。
- (4) **引脚镀层/焊球材料**：器件可能有多种材料镀层选项。各镀层选项用垂直线隔开。如果铅镀层/焊球值超出最大列宽，则会折为两行。
- (5) **MSL 等级/回流焊峰值温度**：湿敏等级等级和峰值焊接（回流焊）温度。如果器件具有多个湿敏等级，则仅显示符合 JEDEC 标准的最低等级。有关将器件安装到印刷电路板上时采用的实际回流焊温度，请参阅装运标签。
- (6) **器件标识**：器件上可能还有与徽标、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标识。
如有多个器件标识，将用括号括起来。不过，器件上仅显示括号中以“~”隔开的其中一个器件标识。如果某一行缩进，说明该行续接上一行，这两行合在一起表示该器件的完整器件标识。

重要信息和免责声明：本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息，TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息，但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息，因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。

在任何情况下，TI 因此类信息产生的责任决不超过 TI 每年向客户销售的本文档所述 TI 器件的总购买价。

11.1 机械数据

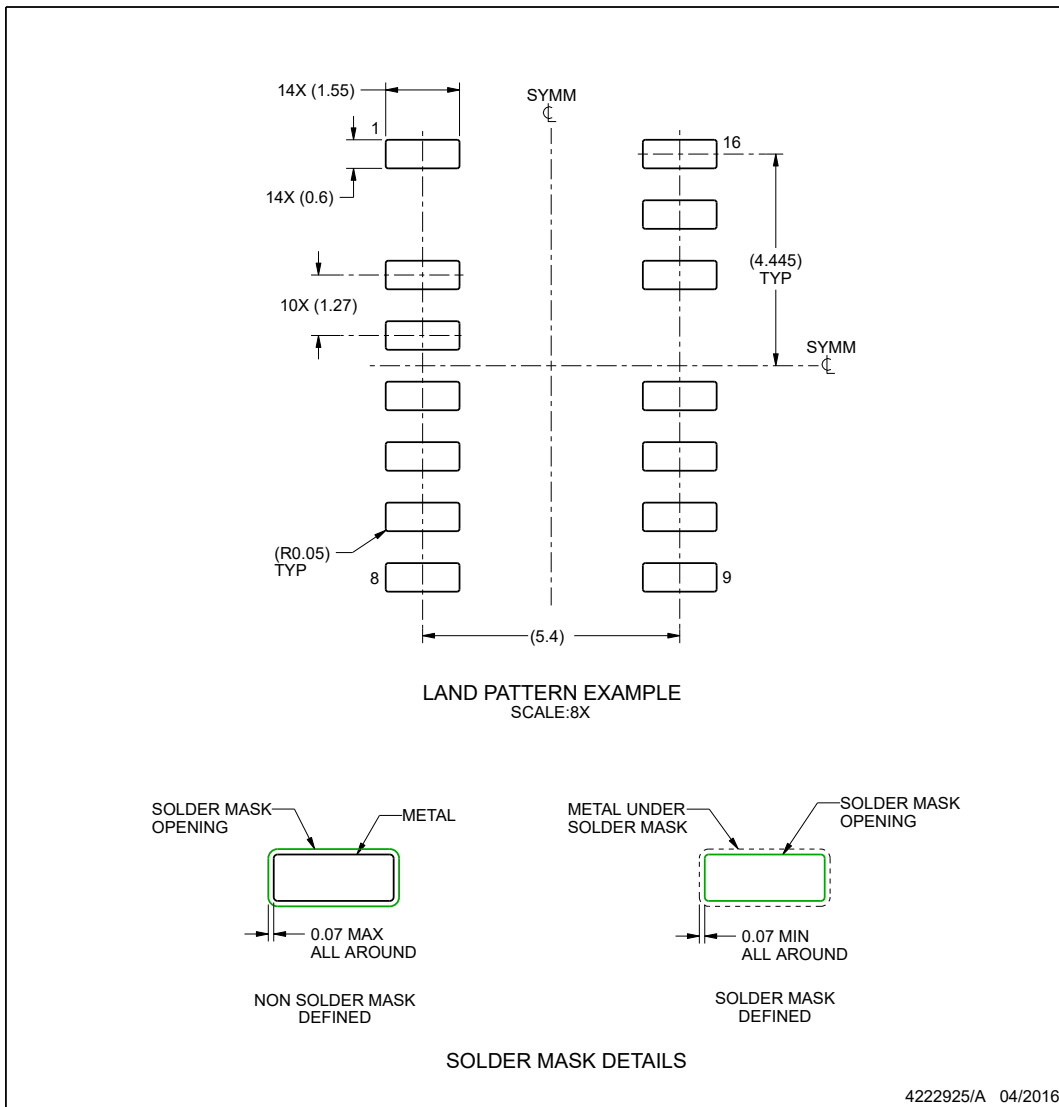


EXAMPLE BOARD LAYOUT

DDB0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SOIC

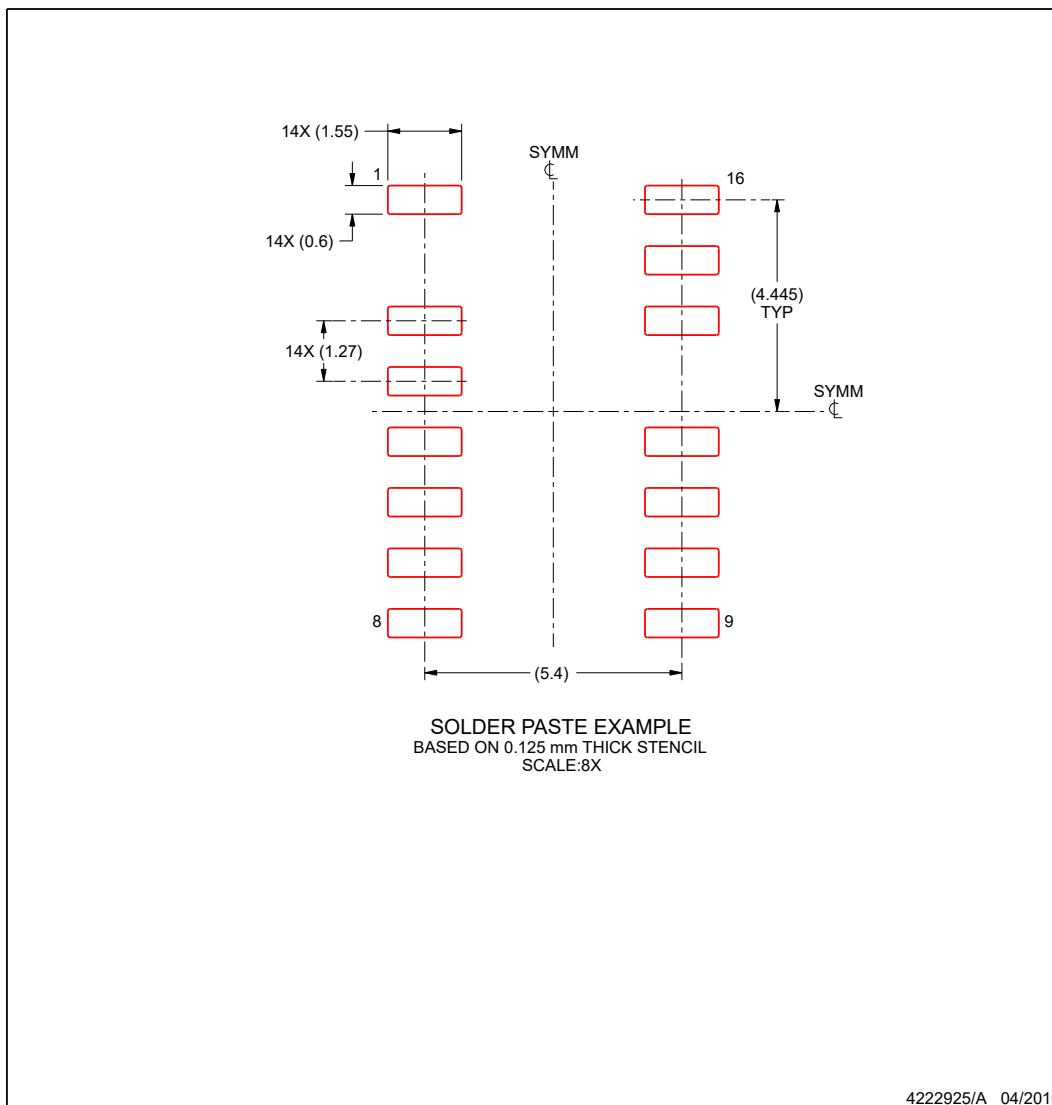


NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN**DDB0014A****SOIC - 1.75 mm max height**

SOIC



NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
UCC256610DDBR	Active	Production	SOIC (DDB) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	UCC256610
UCC256611DDBR	Active	Production	SOIC (DDB) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	UCC256611
UCC256612DDBR	Active	Production	SOIC (DDB) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	UCC256612
UCC256613DDBR	Active	Production	SOIC (DDB) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	UCC256613
UCC256614DDBR	Active	Production	SOIC (DDB) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	UCC256614
UCC256616DDBR	Active	Production	SOIC (DDB) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	UCC256616

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF UCC25661 :

- Automotive : [UCC25661-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

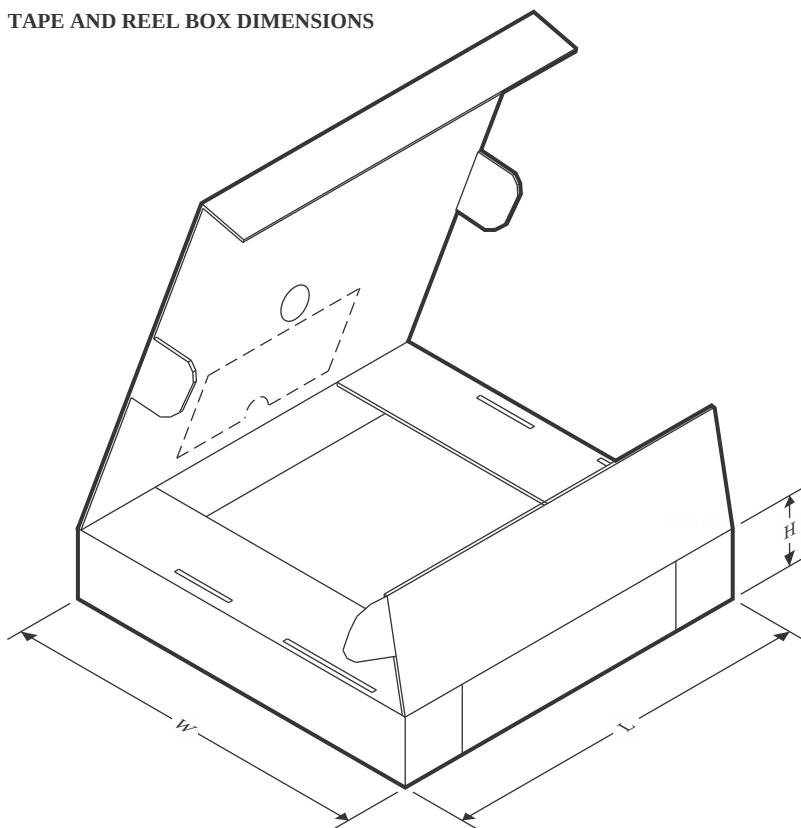
TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

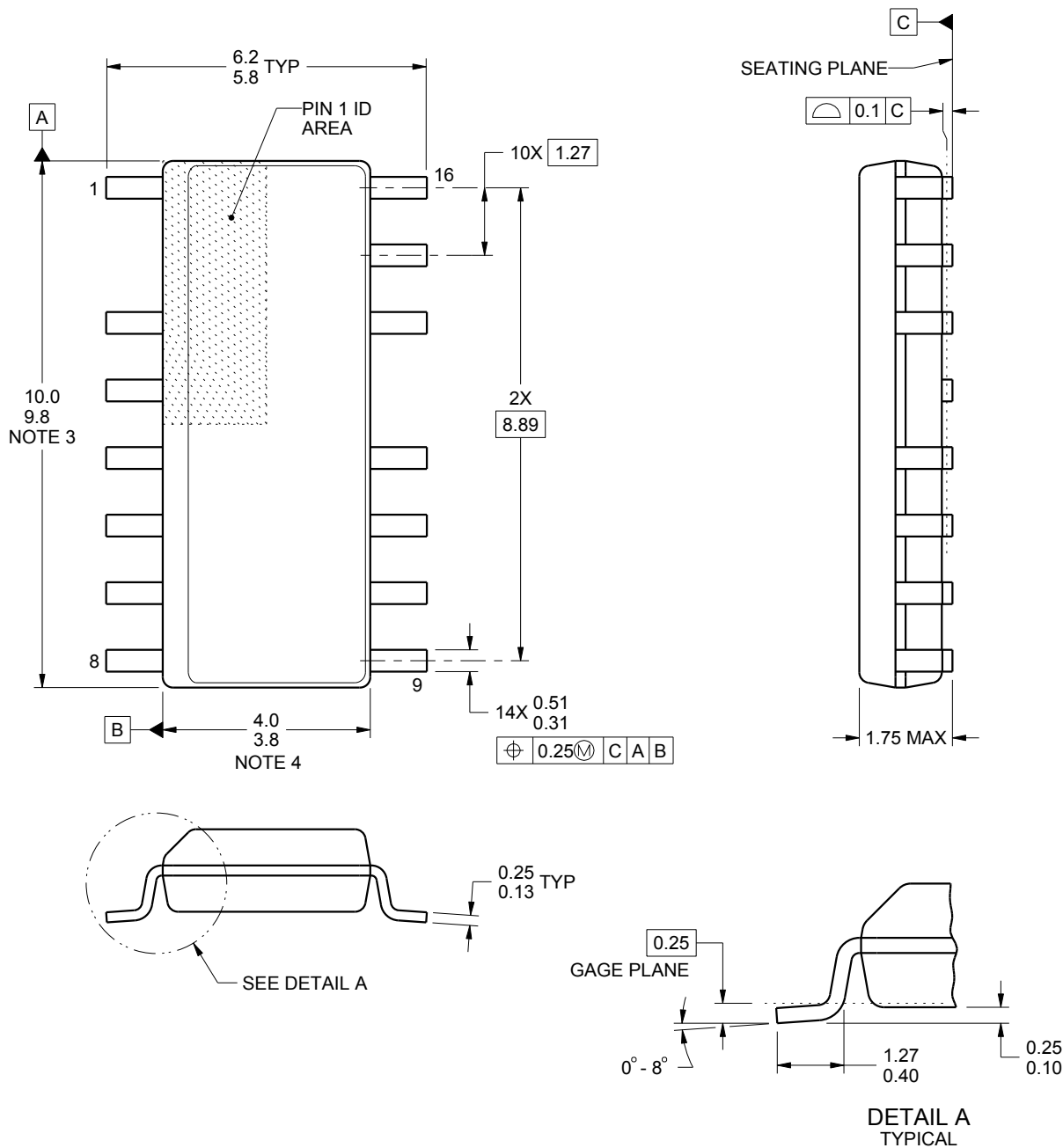
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
UCC256610DDBR	SOIC	DDB	14	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1
UCC256611DDBR	SOIC	DDB	14	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1
UCC256612DDBR	SOIC	DDB	14	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1
UCC256613DDBR	SOIC	DDB	14	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1
UCC256614DDBR	SOIC	DDB	14	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1
UCC256616DDBR	SOIC	DDB	14	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
UCC256610DDBR	SOIC	DDB	14	2500	353.0	353.0	32.0
UCC256611DDBR	SOIC	DDB	14	2500	353.0	353.0	32.0
UCC256612DDBR	SOIC	DDB	14	2500	353.0	353.0	32.0
UCC256613DDBR	SOIC	DDB	14	2500	353.0	353.0	32.0
UCC256614DDBR	SOIC	DDB	14	2500	353.0	353.0	32.0
UCC256616DDBR	SOIC	DDB	14	2500	353.0	353.0	32.0



4222925/A 04/2016

NOTES:

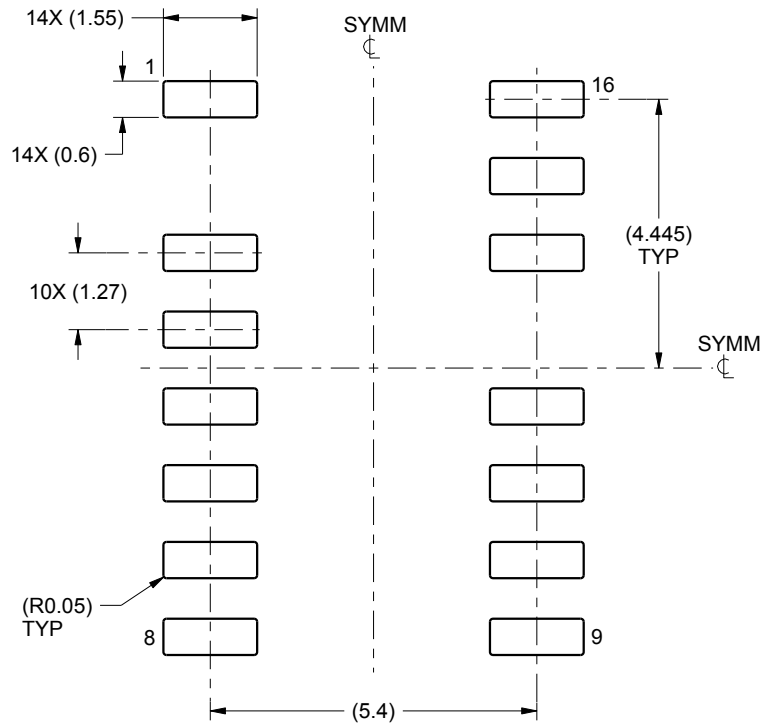
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AC.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

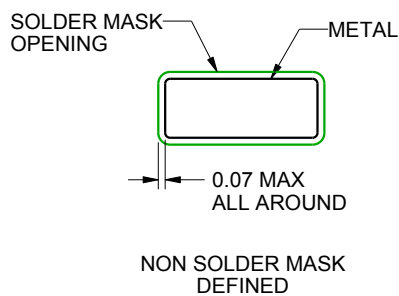
DDB0014A

SOIC - 1.75 mm max height

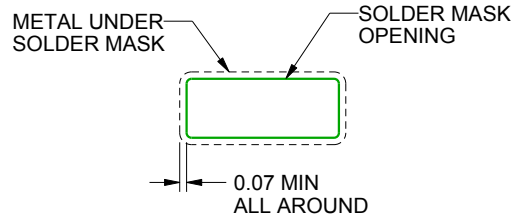
SOIC



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



NON SOLDER MASK
DEFINED



SOLDER MASK
DEFINED

SOLDER MASK DETAILS

4222925/A 04/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

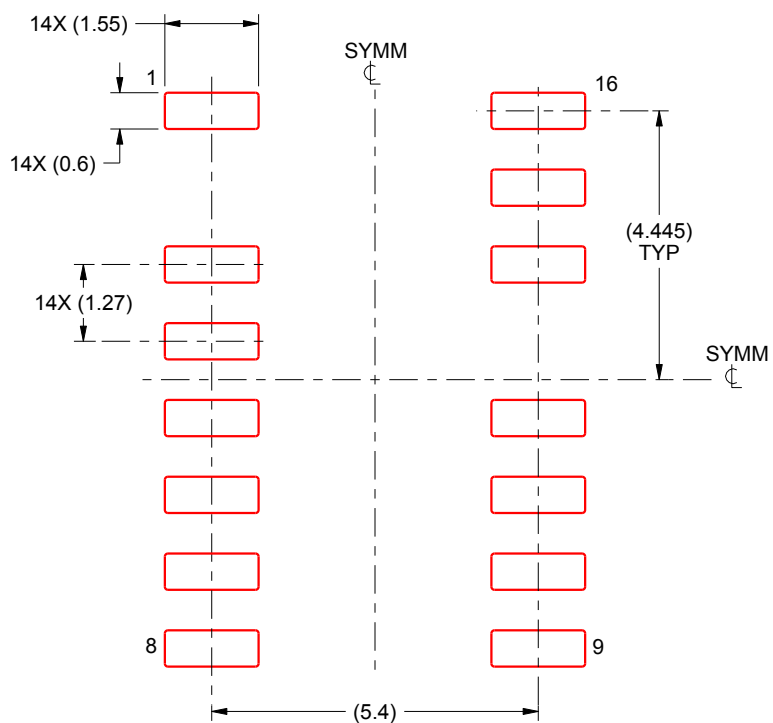
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DDB0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SOIC



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4222925/A 04/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月